



AI가 다시 불 붙인 반도체 슈퍼사이클!

진짜 승자는 “누구”인가?

Semiconductor Industry

핀릿 리서치센터 | 2026년 7월 6일

finlit@finlit.co.kr 6953-5579

핵심결론

글로벌 반도체 산업은 AI 인프라의 폭발적인 확산과 첨단 패키징 기술 혁신을 기점으로 장기적인 구조적 대호황(슈퍼사이클)에 진입했다. 전 세계 반도체 시장 규모는 2025년 7,956억 달러에서 2026년 1조 5,112억 달러를 거쳐, 오는 2029년에는 2조 790억 달러 체급으로 급팽창하며 연평균 10.6%의 강력한 성장을 이어갈 전망이다.

국내 반도체 생태계 역시 삼성전자와 SK하이닉스의 독보적인 메모리 기술력을 중심으로 소재, 전공정 장비, 후공정 검사 밸류체인 전반으로 막강한 실적 개선 효과가 확산되는 구조를 보여준다.

따라서 투자 전략은 단순한 업황 반등에 기대기보다, 기술적 진입 장벽과 글로벌 고객사 인증을 완벽히 선점한 리더 기업들로 포트폴리오를 선별 압축하는 정교한 접근이 필요하다

CONTENTS

Summary	3
[산업분석]	
Ⅰ. 글로벌 반도체 산업 정의 및 시장 전망	5
Ⅱ-1. 글로벌 메모리 반도체 시장 현황 및 전망	14
Ⅱ-2. 글로벌 반도체 장비 시장 현황 및 전망	22
Ⅲ. 글로벌 반도체 산업 밸류체인 및 주요 종목	29
[기업분석]	
• 삼성전자(005930) : 범용 공급 부족과 HBM4 독주, 펀더멘털은 완벽하다	44
• SK하이닉스(000660) : AI 메모리 반도체 슈퍼사이클의 중심에 서다!	47
• 솔브레인(357780) : 반도체 소재에서 유리기판까지 성장판이 열린다	50
• 한솔케미칼(014680) : 반도체 소재 성장 모드가 다시 커졌다	51
• HPSP(403870) : AI·메모리 미세화가 키우는 고압 어닐링 수요	52
• 원익 IPS(240810) : 전공정 장비 슈퍼사이클, 진짜 성장은 이제 시작	53
• 주성엔지니어링(036930) : ALD 기술 하나로 반도체·태양광·유리기판까지 간다	54
• 피에스케이(319660) : 전공정 CAPEX 슈퍼사이클, 넓은 고객 저변 강점	55
• 티시케이(064760) : NAND 고단화가 부르는 SiC Ring 슈퍼사이클	56
• 파크시스템스(140860) : 선단공정 계측, 수율을 좌우하는 숨은 병목 기술	57
• 이오테크닉스(039030) : 마킹·어닐링·커팅, 세 공정이 동시에 열린다	58
• 한미반도체(042700) : HBM 고단화가 만든 TC 본더 장기 성장 공식	59
• 하나마이크론(067310) : 풀턴키 OSAT, AI 후공정 성장의 본격 수혜 구간	60
• 테크윙(089030) : 메모리 핸들러 1위에서 HBM 검사 플랫폼으로	61
• 리노공업(058470) : AI 반도체 시대, 테스트 소켓이 숨은 병목이다	62

[글로벌 반도체 시장 전망 및 주요 관심 종목 Summary]

메모리 및 독점 기술을
확보한 기업 중심으로
선별 압축 투자

글로벌 반도체 시장은 생성형 AI 인프라 구축과 첨단 패키징 기술 리더십에 힘입어 구조적 대호황에 진입했다. 시장 규모는 2025년 7,956억 달러에서 2026년 1조 5,112억 달러, 2029년 2조 790억 달러로 가파르게 확대되며 중장기적으로 연평균 10.6%의 안정적인 우상향 궤도를 그려갈 것이다. 반도체 산업의 핵심 동력은 AI 인프라와 데이터센터 확장, 전기차 및 자율주행 시장의 성장이며, 핵심 축은 설계부터 파운드리, 후공정(OSAT), 소부장으로 이어지는 고도의 분업화 경쟁이다.

투자자들은 단기적인 시장 흔들림에 아랑곳하지 말고, 반도체 대형 메모리 및 독점적 원천 기술을 선점한 글로벌 최상위 탑티어 종목군에 집중하는 압축 선별 전략을 지향해야 한다.



대형 메모리에서 소재,
전공정 장비,
후공정·검사까지
이어지는 밸류체인
전체의 실적 레버리지에
주목

국내 반도체 관심 종목은 AI 메모리 슈퍼사이클, 선단공정 전환, 첨단 패키징 확대, 소재·부품·장비 국산화 흐름을 기준으로 선별할 필요가 있다.

삼성전자와 SK 하이닉스는 범용 메모리 가격 상승과 HBM 고도화의 직접 수혜주이며, 솔브레인과 한솔케미칼은 세정·프리커서 등 핵심 소재 수요 회복을 반영하는 소재 축이다. HPSP, 원익 IPS, 주성엔지니어링, 피에스케이 등 고압 어닐링, 증착, ALD, Dry Strip 등 전공정 투자 확대의 핵심 장비주로 분류된다.

티씨케이 NAND 고도화 SiC Ring 대표주이며, 파크시스템스와 이오테크닉스는 계측·레이저 공정 고도화 수혜주이다. 한미반도체는 HBM TC 본더, 하나마이크론은 풀턴키 OSAT, 테크윙과 리노공업은 HBM 검사와 테스트 소켓 병목을 담당하는 후공정 핵심주이다.

반도체 투자전략은 대형 메모리에서 소재, 전공정 장비, 후공정·검사까지 이어지는 밸류체인 전체의 실적 레버리지에 주목하는 접근이다

종목	투자포인트	종목	투자포인트
1 삼성전자 (005930)	범용 공급 부족과 HBM4 독주, 핀더멘털은 완벽하다	9 티씨케이 (064760)	NAND 고도화가 부르는 SiC Ring 슈퍼사이클
2 SK하이닉스 (000660)	AI 메모리 반도체 슈퍼사이클의 중심에 서다!	10 파크시스템스 (140860)	선단공정 계측, 수율을 좌우하는 숨은 병목 기술
3 솔브레인 (357780)	반도체 소재에서 유리기관까지 성장판이 열린다	11 이오테크닉스 (039030)	마킹 · 어닐링 · 커팅, 세 공정이 동시에 열린다
4 한솔케미칼 (014680)	반도체 소재 성장 모드가 다시 켜졌다	12 한미반도체 (042700)	HBM 고도화가 만든 TC 본더 장기 성장 공식
5 HPSP (403870)	AI·메모리 미세화가 키우는 고압 어닐링 수요	13 하나마이크론 (067310)	풀턴키 OSAT, AI 후공정 성장의 본격 수혜 구간
6 원익IPS (240810)	전공정 장비 슈퍼사이클, 진짜 성장은 이제 시작	14 테크윙 (089030)	메모리 핸들러 1위에서 HBM 검사 플랫폼으로
7 주성엔지니어링 (036930)	ALD 기술 하나로 반도체·태양광·유리기관까지 간다	15 리노공업 (058470)	AI 반도체 시대, 테스트 소켓이 숨은 병목이다
8 피에스케이 (319660)	전공정 CAPEX 슈퍼사이클, 넓은 고객 저변 강점		

[한 장으로 이해하는 반도체 산업]

디지털 세상의 심장

반도체 산업

반도체는 전기를 제어하여 데이터를 처리하고 저장하는 핵심 부품으로, 현대 산업과 우리의 일상을 움직이는 필수 기반 기술입니다.



고성능·저전력
더 빠르고 효율적인
연산과 데이터 처리



지속 성장 산업
AI, 데이터센터, 전기차 등
수요 확대 지속



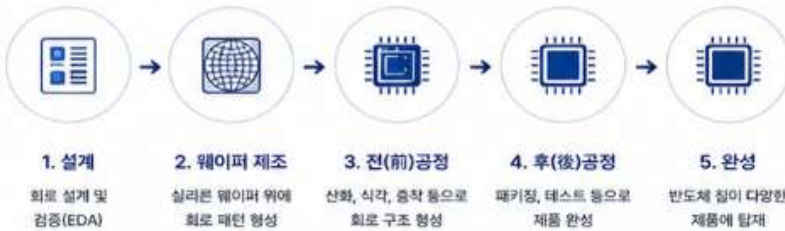
글로벌 경쟁력
첨단 기술력과 공급망
경쟁력 핵심



미래 혁신 기반
다양한 산업의 디지털
전환을 견인



반도체는 어떻게 만들어질까? | 설계부터 완제품까지



설계 - 제조 - 패키징 - 테스트로 이어지는 고도화된 공정과 기술이 집약됩니다.

반도체의 주요 종류



메모리 반도체
데이터를 저장하는 칩
(DRAM, NAND Flash 등)



비메모리 반도체
데이터를 처리·연산하는 칩
(CPU, GPU, AP, MCU 등)



아날로그 반도체
전압, 전류, 신호를 변환·제어
(전원관리칩, 센서 등)



파워 반도체
전력을 효율적으로 변환·제어
(MOSFET, IGBT, SiC, GaN 등)

우리 생활 속 반도체



스마트폰
빠른 연산과 통신,
카메라, 디스플레이 구동



PC / 노트북
데이터 처리, 그래픽,
저장장치 제어



데이터센터 / AI
대량의 데이터 처리와
AI 학습·추론 수행



전기차
배터리 관리, 인버터 제어,
자율주행 시스템



산업 / IoT
센서, 제어, 통신을 통한
스마트 공장 구현



가전제품
전력 제어, 모터 구동,
사용자 경험 향상

글로벌 반도체 시장 규모



출처: WSTS, 2026년 4월



AI, 고성능 컴퓨팅, 전기차, 사물인터넷 등 성장 산업의 확대
반도체 시장은 지속적으로 확대될 전망입니다.

성장을 이끄는 핵심 동력



AI / 빅데이터
확산



데이터센터
투자 확대



전기차 / 자율주행
수요 증가



5G / 6G, IoT
연결 기기 확대



친환경 / 에너지
효율화

미래 전망

반도체는 모든 산업의 디지털 전환을 뒷받침하는 핵심 기술로,
더 작고, 더 빠르고, 더 효율적인 혁신은 계속될 것입니다.



첨단 공정 기술
고도화



글로벌 공급망
안정화



인재 육성 및
생태계 강화

반도체, 오늘의 기술을 넘어 내일의 가능성을 만듭니다.

[1. 글로벌 반도체 산업 정의 및 시장 전망]

반도체 산업은
소재, 자본, 기술,
규모의 경제 산업으로
2025년 7,956억달러
(YoY +26.2%) 성장

반도체는 도체와 절연체의 중간 특성을 지닌 소재 기반 산업이다. 소자와 집적회로를 설계·제조·검사·패키징·판매하며, 연산·저장·증폭·변환·제어·감지 기능을 수행하는 부품 산업이다. 반도체는 스마트폰, PC, 서버, 데이터센터, 자동차, 통신장비, 산업, 국방, 의료, 에너지에 탑재되며, 디지털 경제와 국가 기술안보를 좌우하는 전략산업이다.

반도체 밸류체인은 설계, 제조, 후공정, 소재·장비, 유통·응용으로 이어지는 구조이다. 설계는 IP, EDA, 팹리스가 중심이고, 제조는 파운드리와 IDM 이 담당하는 영역이다. 제조 공정은 산화, 포토, 식각, 증착, 이온주입, 세정, CMP, 금속배선 등으로 구성된다. 후공정은 웨이퍼 테스트, 절단, 패키징, 최종 테스트로 구분되며, 경쟁요소는 2.5D·3D 패키징, 칩렛, HBM 적층, 인터포저, 고성능 기판이다.

반도체의 주요 수요처는 데이터 처리, 네트워킹·커뮤니케이션, 소비자 가전, 자동차, 산업, 정부·국방이다. 데이터 처리는 CPU, GPU, AI ASIC, HBM, DDR, SSD 가 결합된 최대 성장 시장이다. 네트워킹·커뮤니케이션은 이더넷 컨트롤러, 스위치, 라우터, RF 칩, 모뎀이 중심이다. 소비자 가전은 스마트폰, PC, TV, 웨어러블 중심의 경기민감 시장이다. 자동차는 전동화, ADAS, 인포테인먼트, BMS, 파워트레인 확대로 탑재량이 증가하는 영역이다. 산업은 공장 자동화, 로봇, 전력 제어, 모터 구동이 수요처이다.

2025년 반도체 시장 규모는 WSTS 기준 7,956억 달러, Gartner 기준 7,934억 달러로 추정되며, 전년 대비 성장률은 26.2%이다. 이러한 성장 배경은 AI 데이터센터, 고성능 연산, 메모리 가격 회복, 네트워크 인프라 확대이다.

[그림 1] 반도체 산업의 정의 및 글로벌 밸류체인 구조



자료: 세계반도체무역통계기구(WSTS, 2026년 4월), 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5로 재구성

반도체 산업의 경제적 성격 및 시사점

반도체가 범용 부품이 아니라 응용처별 최적화 기술 플랫폼 시장

반도체 산업은 자본집약, 기술집약, 규모의 경제가 모두 높은 산업이다. 첨단 팹에는 수백억 달러의 투자가 필요하며, EUV, 고순도 소재, 초정밀 계측, 엔지니어가 생산요소이다. 제품 수명주기는 짧고 기술 전환 속도는 빨라 지속적인 R&D와 CAPEX가 필수인 구조이다. 고객 인증, 공정 노하우, 수율, 생태계 라인이 진입장벽을 높이며, 구조적 성장과 단기 사이클이 함께 존재하는 산업이다.

반도체 산업의 분석 포인트는 가격 사이클, 응용처 수요, 지역별 정책, 공급망 병목이다. 마이클 포터의 5가지 경쟁요인 모델로 살펴보면 기존 경쟁강도는 높고, 메모리, 파운드리, 팹리스, 아날로그별 경쟁 방식은 다르다. 신규 진입 위험은 낮으며, 자본, 기술, 고객 인증 장벽이 높지만 RISC-V와 칩렛은 일부 진입장벽을 낮추는 요소이다. 공급자 교섭력은 EUV, EDA, 웨이퍼, 특수가스, 포토레지스트, 기판의 공급 제한으로 높다. 구매자 교섭력은 하이퍼스케일러(Hyperscaler), 스마트폰 제조사, 자동차 OEM의 영향력이 커 높은 편이다. 대체재 위험은 낮지만 일부 GPU는 ASIC으로, x86은 Arm 또는 RISC-V로 이동할 수 있다.

핵심 시사점은 반도체가 범용 부품이 아니라 응용처별 최적화 기술 플랫폼 시장이라는 점이다. 메모리는 가격 탄력성과 공급 조절이 실적에 직접 반영되고, 로직은 설계 생태계와 고객 플랫폼 라인이 중요하다. Analog-MCU는 제품 수명과 고객 다변화가 강점이고, Power는 에너지 효율과 전동화가 성장 동력이다. Sensor는 스마트폰, 자동차, 로봇, 산업 자동화로 확장되는 영역이다.

그리고 2025년 이후 향후 성장 축은 AI 데이터센터이며, 산업 전체는 데이터 처리, 통신, 자동차, 산업, 공공 인프라가 결합된 시장으로 발전하고 있다.

[그림 2] 반도체 산업의 경제적 성격 및 시사점



자료: 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5로 재구성

반도체 분류, 메모리 vs 비메모리/시스템 반도체

반도체는
메모리 vs 비메모리
특히 메모리 반도체는
세계적인 경쟁력 확보

반도체는 일반적으로 메모리와 비메모리/시스템 반도체로 나뉘며, 두 영역은 용도와 시장 구조가 다른 산업이다. **메모리 반도체**는 기억·저장을 담당하는 **데이터 저장용 반도체**이며, 대용량과 고속화가 핵심인 분야이다. 대표 제품은 DRAM과 NAND 플래시이다. DRAM은 휘발성 메모리로 주기억장치에 사용되며 PC, 서버, 모바일 기기의 핵심 부품이고 전원이 꺼지면 저장 내용이 사라지지만 속도가 빠른 제품이다. 국내 주요 메이커는 삼성전자와 SK하이닉스이며, 해외 주요 메이커는 마이크론이다. NAND 플래시는 비휘발성 메모리로 전원이 꺼져도 데이터가 유지되는 저장용 반도체이다. SSD와 스마트폰 저장장치에 사용되며 DRAM보다 속도는 느린 제품이다. 국내 주요 메이커는 삼성전자와 SK하이닉스(솔리디엄)이며, 해외 주요 메이커는 키옥시아, 웨스턴디지털, 마이크론이다.

비메모리/시스템 반도체는 연산·제어·처리를 담당하는 **기능 특화 반도체**이다. CPU는 범용 연산·제어 칩이며 PC, 서버, 산업기기에 쓰이고 고성능과 저전력이 중요하다. MCU는 제어 중심 소형 프로세서로 전자, 자동차, IoT에 사용되며 안정성과 저전력이 핵심이다. MODEM은 통신 신호의 송수신과 변환을 담당하고 스마트폰과 통신장비 연결, 5G·6G 대응이 중요하다. GPU는 병렬 연산 특화 제품으로 AI, 게임, 그래픽 렌더링에 쓰이며 고대역폭과 연산 처리 능력이 핵심이다. DDI는 디스플레이 구동 칩, CIS는 빛을 전기 신호로 바꾸는 카메라용 센서, AP는 모바일 기기용 통합 칩이다.

반도체 산업의 핵심 포인트는 메모리 분야에서는 한국 경쟁력이 강하고, 시스템 반도체는 품목이 다양하며 응용 시장이 넓다는 점이다.

[그림 3] 반도체는 메모리 vs 비메모리/시스템 반도체로 분류



자료: 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5 로 재구성

반도체 산업의 사업모델 및 적용 기술

반도체 산업은
종합반도체, 팹리스,
파운드리, OSAT,
장비·소재의 사업모델

반도체 산업의 사업모델은 설계·제조·후공정·소재·장비로 분업화된 구조이다. IDM(Integrated Device Manufacturer)은 설계부터 제조, 조립, 테스트, 판매까지 반도체 개발·생산 전 과정을 내부화한 종합 반도체 회사로 공정과 제품 최적화에 유리하지만 설비투자 부담이 큰 구조이다. 대표 기업은 삼성전자, SK 하이닉스, Intel, Micron, Texas Instruments, Infineon 이다.

팹리스는 설계 중심 모델로 고객 응용처 이해가 핵심이며, 생산은 외부 파운드리에 위탁하는 방식이다. 대표 기업은 NVIDIA, Qualcomm, AMD, MediaTek, Broadcom 이다.

파운드리는 고객 설계를 웨이퍼 제품으로 구현하는 생산 파트너로 선단공정에서 미세화와 수율, 전력 효율, 패키징 연계가 중요하고, 성숙공정에서는 가격, 품질, 장기 공급 안정성이 중요하다. 대표 생산 파트너는 TSMC 와 삼성전자이다.

OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly & Test)는 패키징과 테스트를 담당하며, AI 반도체 확산 이후 단순 후공정이 아닌 핵심 공급자로 위상이 높아진 영역이다. 장비·소재는 노광, 식각, 증착, 검사, 세정, CMP 와 포토레지스트, 특수가스, 웨이퍼, 기판을 공급하는 제조 기반 산업이다.

또한 기술 관점에서 선단공정은 7nm 이하, 5nm, 3nm, 2nm 영역으로 고성능과 저전력 구현이 핵심이다. 주요 수요는 AI GPU, 모바일 AP, 고성능 CPU, 네트워크 프로세서이며, 경쟁은 TSMC, 삼성전자, Intel 중심이다. 성숙공정은 28nm 이상 공정으로 안정성과 장기 공급이 핵심이다. 주요 용도는 MCU, PMIC, 디스플레이 구동칩, 전력반도체, 센서, 자동차·산업용 아날로그 칩이다.

따라서 반도체 산업은 선단 로직·HBM 과 성숙공정이 함께 성장하는 이중 구조이며, 공급망 리스크 분석도 중요한 기준이 된다.

[그림 4] 반도체 산업의 사업모델 및 적용 기술



반도체 산업의 주요 트렌드 및 각국의 지원정책

글로벌 반도체 산업의
핵심 흐름은 시스템
통합 경쟁, AI 반도체
확장, 메모리
전략자산화, 산업용
안정 성장, 공급망
지역화로 요약

반도체 산업의 핵심 흐름은 시스템 통합 경쟁, AI 반도체 확장, 메모리 전략자산화, 자동차·산업용 안정 성장, 공급망 지역화로 요약된다. 시스템 통합 경쟁은 단순 미세화에서 벗어나 메모리 대역폭, 패키징, 전력, 열, 네트워크를 함께 최적화하는 방향으로 전환되고 있다. 또한 주요 기술은 칩렛, HBM, 인터포저, 2.5D·3D 패키징, CXL, 고속 이더넷, CPO 등이다.

AI 반도체는 NVIDIA GPU 중심 구조 속에서 AMD, Broadcom, Marvell 이 확대되고, Google, Amazon, Microsoft, Meta 의 맞춤형 ASIC 개발이 강화되는 추세다.

메모리는 범용 제품에서 전략 협력 중심으로 이동하며 HBM 경쟁, 고객 인증, 패키징 정합성, 전력 효율이 더욱 중요해지고 있다. 자동차·산업용 반도체는 선단공정 의존도는 낮지만 높은 신뢰성과 장기 공급, 기능안전 인증이 요구되는 시장이다.

최근 기술 발전은 로직, 메모리, 패키징, 전력반도체, 설계 자동화 전반에서 동시에 진행되고 있다. 로직은 3nm 에서 2nm, 1.4nm 로 진화하며 GAA 트랜지스터, 후면전력공급, 고 NA EUV 가 핵심이다. 메모리는 HBM3E 에서 HBM4·HBM4E 로 발전하며 적층 수, 대역폭, 전력 효율, 발열 관리가 경쟁력이다. 패키징은 2.5D 인터포저, 팬아웃, 하이브리드 본딩, 칩렛 통합, 고성능 기판 중심으로 발전한다. 전력반도체는 IGBT·MOSFET 에서 SiC·GaN 으로 확장되는 고효율 영역이다.

주요 국가들의 반도체 산업 정책은 자국 내 생산능력 확대와 후공정 분산을 추진하고 있으며, 각국 기업들은 고객 접근성, 규제 대응, 공급 안정성, 기술 보호, 다 지역 생산 전략을 함께 고려하고 있다.

[그림 5] 반도체 산업의 주요 트렌드 및 각국의 지원정책



자료: 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5 로 재구성

반도체 산업의 경쟁구도 및 주요 기업들의 사업 전략 및 방향

글로벌 반도체 산업의 경쟁구도는 AI 수요를 중심으로 재편

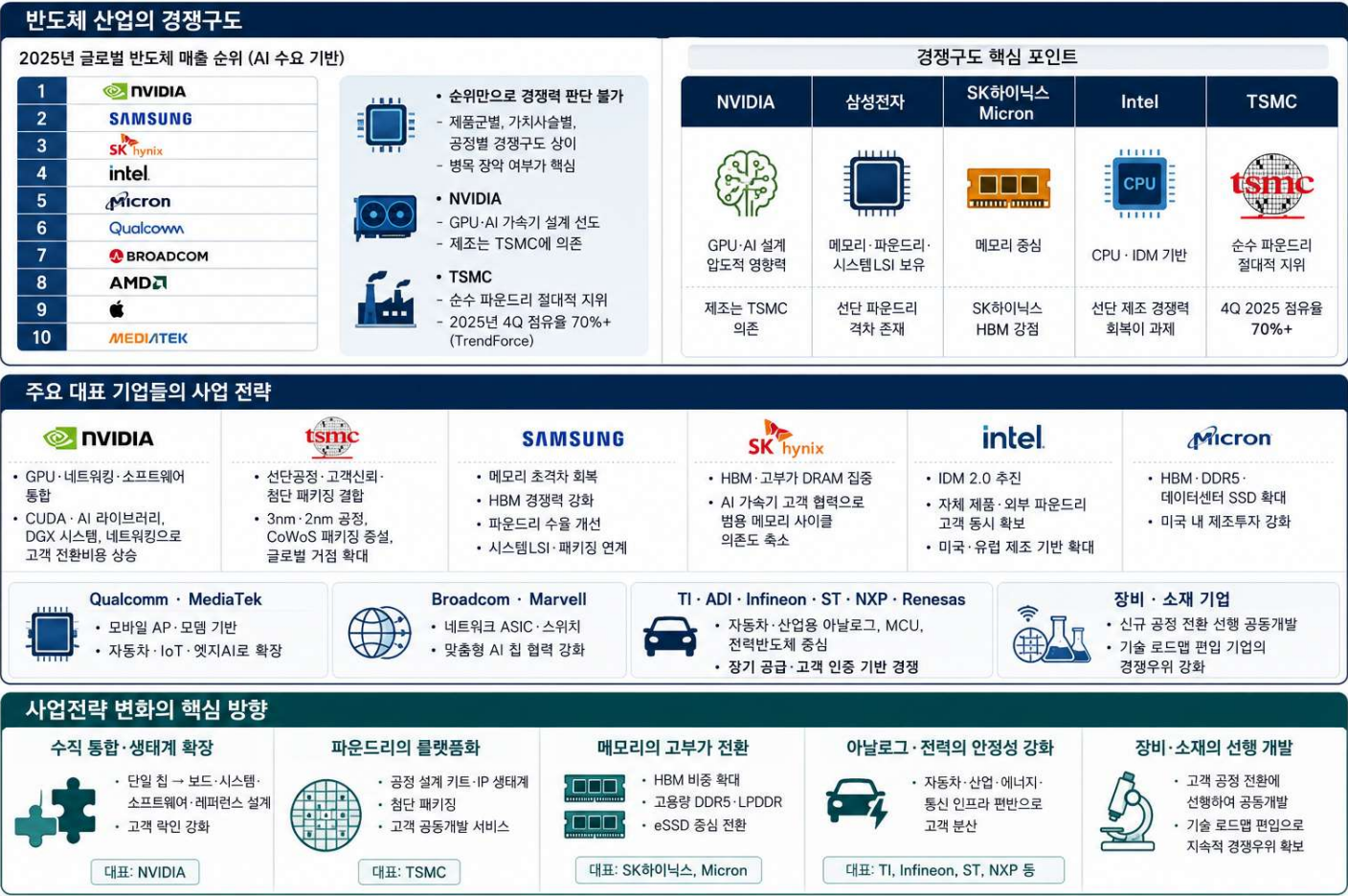
반도체 산업의 글로벌 경쟁구도는 2025 년 AI 수요를 중심으로 재편되는 구조이다. 글로벌 반도체 매출 순위는 NVIDIA, 삼성전자, SK 하이닉스, Intel, Micron, Qualcomm, Broadcom, AMD, Apple, MediaTek 순으로 제시된다. 다만 순위만으로 경쟁력을 판단하기는 어렵고, 제품군, 가치사슬, 공정별 경쟁구도와 병목 장악 여부가 핵심이다.

NVIDIA 는 GPU 와 AI 가속기 설계에서 가장 강한 영향력을 보유하고 있지만 제조는 TSMC 에 의존하는 구조이다. TSMC 는 순수 파운드리 분야에서 가장 강한 지위를 보유하고 있으며, 2025 년 4 분기 점유율은 70% 이상이다. 삼성전자는 메모리, 파운드리, 시스템 LSI 를 보유하나 선단 파운드리 격차가 존재하는 기업이다. SK 하이닉스와 Micron 은 메모리 중심이며, SK 하이닉스는 HBM 강점이 부각되는 구조이다. Intel 은 CPU 와 IDM 기반을 보유하고 있지만 선단 제조 경쟁력 회복이 과제이다.

반도체 기업들의 주요 사업 전략은 생태계 확장과 플랫폼화, 고부가 메모리 전환, 아날로그·전력의 안정성 강화, 장비·소재 선행 개발로 요약된다.

NVIDIA 는 GPU, 네트워킹, 소프트웨어를 통합하고, TSMC 는 선단공정과 첨단 패키징을 결합하는 전략 이다. 삼성전자는 HBM 경쟁력과 파운드리 수율 개선, SK 하이닉스는 HBM 고부가 DRAM 집중, Intel 은 IDM 2.0, Micron 은 HBM·DDR5·데이터센터 SSD 확대가 핵심이다. Qualcomm 과 MediaTek 은 모바일 AP·모뎀 기반으로 자동차, IoT, 엣지 AI 로 확장하는 방향이다. Broadcom 과 Marvell 은 네트워크 ASIC 과 스위치, 맞춤형 AI 칩 협력을 강화하는 기업이다.

[그림 6] 반도체 산업의 경쟁구도 및 주요 기업들의 사업 전략 및 방향



자료: 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5 로 재구성

글로벌 반도체 기업 경쟁 매트릭스 및 시사점

DRAM 점유율보다
HBM 경쟁력,
고객 인증,
패키징 연계, 수율,
장기 공급계약이
중요해진 구조

글로벌 반도체 산업의 경쟁 매트릭스는 성장성과 공급망 병목 지배력을 기준으로 구분되는 구조이다. **고성장·고지배력 영역**은 NVIDIA, TSMC, SK 하이닉스가 포함되며, GPU, 선단 파운드리, HBM 우위를 통해 AI 데이터센터의 핵심 병목을 장악한 그룹이다. **응용확장형 팹리스**는 Qualcomm, MediaTek, AMD, Broadcom, Marvell 이 해당되며, 모바일, PC, 네트워크 기반에서 맞춤형 AI ASIC 성장 기회를 보유한 영역이다. **안정수익형 그룹**은 TI, Analog Devices, Infineon, NXP, STMicroelectronics, Renesas 로 구성되며, 자동차와 산업용 장기 수요 및 고객 다변화가 강점인 영역이다. **전략자산형 턴어라운드 그룹**은 삼성전자와 Intel 이며, 대규모 제조 기반과 기술 포트폴리오를 보유했지만 선단 수율, HBM 고객 확보, 파운드리 수익성이 과제인 영역으로 핵심 경쟁 변수는 선단공정, HBM, 첨단 패키징, 소프트웨어 생태계, 대형 고객 관계이다.

국내 반도체 기업 관점에서는 **메모리 재평가가 핵심**이며, 삼성전자와 SK 하이닉스는 DRAM 점유율보다 HBM 경쟁력, 고객 인증, 패키징 연계, 수율, 장기 공급계약이 중요해진 구조이다.

삼성 파운드리는 TSMC 와 직접 경쟁하지만 단기적으로 특정 고객과 응용처 중심의 신뢰 회복이 필요한 영역이다. 소재·부품·장비 기업은 선단공정, HBM, 후공정, 전력반도체 투자 확대와 함께 국산화와 고객 다변화 기회를 갖는 영역이다. 따라서 반도체 산업의 분석 초점은 현재 매출보다 기술 병목 내 위치와 고객사 협력 구조이며, 평가 기준은 병목 지배력, 고객 집중도, 공급 확장 속도, 수율 개선 가능성, 정책 리스크 등을 종합적으로 고려해야 한다.

[그림 7] 글로벌 반도체 기업 경쟁 매트릭스 및 시사점



자료: 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5 로 재구성

글로벌 반도체 시장 규모 및 지역별 시장 전망

글로벌 반도체시장
2026년 1.5조 달러
(YoY 89.9%) 성장

향후 연평균 10.6%
꾸준한 성장세 전망

글로벌 반도체 시장은 2021~2022년 팬데믹 이후 공급부족과 전자제품 수요 확대로 성장한 뒤, 2023년에는 메모리 불황과 소비기기 둔화로 조정을 겪은 흐름이다. 2024년은 AI 서버 투자와 메모리 가격 회복이 시작된 회복기이고, 2025년은 AI 인프라 투자가 본격적으로 매출을 끌어올린 확장기이다.

글로벌 반도체 시장 규모는 2025년 7,956억 달러에서 2026년 1조 5,112억 달러로 급증하고, 2029년에는 2조 790억 달러까지 확대될 전망이다. 성장률은 2026년 89.9%로 급등한 뒤 2027년 26.6%, 2028년 5.6%, 2029년 2.9%로 정상화되는 구조이다. 향후 중,장기적으로는 연평균 10.6% 수준의 꾸준한 성장세가 예상된다.

성장의 중심은 메모리 확장세, AI 데이터센터 증설, HBM 공급 확대, 고속 데이터 처리, 네트워킹 및 통신 장비 수요이다. 부품별로는 메모리 장치가 시장을 주도하고, 라우터, 스위치, 이더넷 컨트롤러를 포함한 네트워킹 및 통신 분야도 강한 성장이 예상된다.

반도체 시장을 지역별로 살펴보면 아시아-태평양이 2026년 8,239억 달러, 점유율 54.5%로 최대 시장을 유지하는 구조이다. 북아메리카 등 미주 시장은 2025년 2,565억 달러에서 2026년 5,437억 달러, 2027년 7,014억 달러로 확대될 전망이다. 유럽은 2025년 547억 달러에서 2026년 866억 달러로 성장하고, 일본은 2026년 571억 달러 규모이다.

미주는 AI 반도체 수요와 클라우드 인프라 투자가 핵심 배경이고, 유럽은 통신 투자와 자동차 산업 수요가 주요 동력이다. 2026년 이후 상단은 AI 데이터센터와 HBM 이, 하단은 스마트폰·PC·자동차 재고조정과 설비투자 과잉 여부로 결정되면서 반도체 시장을 주도할 전망이다.

[그림 8] 글로벌 반도체 시장 및 지역별 시장 전망



자료: 세계반도체무역통계기구(WSTS, 2026년 4월), 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5로 재구성

글로벌 반도체 제품별 시장 규모 및 전망

메모리 반도체가 2025년 2,300억 달러에서 2026년 8,039억 달러, 2027년 1조 621억 달러로 확대되며 가장 큰 폭의 성장

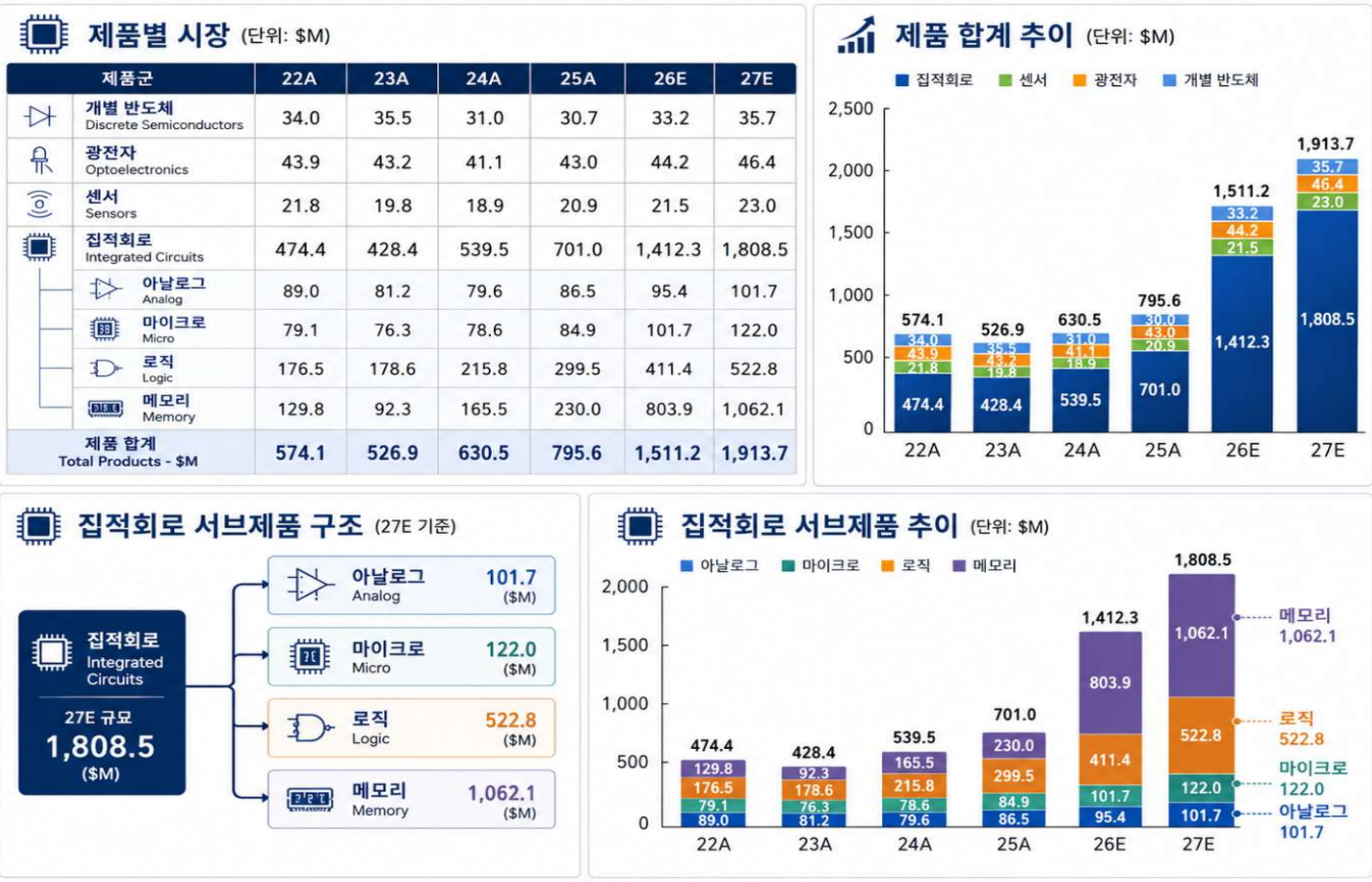
글로벌 반도체 제품별 시장은 집적회로가 전체 성장을 주도하는 구조이다. 반도체 제품 합계는 2022년 5,741억 달러에서 2023년 5,269억 달러로 감소했으나, 2024년 6,305억 달러, 2025년 7,956억 달러로 회복된 흐름이다. 이후 2026년 1조 5,112억 달러, 2027년 1조 9,137억 달러로 확대될 전망이다.

반도체 제품군은 개별 반도체, 광전자, 센서, 집적회로로 구분되며, 아날로그, 마이크로, 로직, 메모리는 집적회로의 하위 제품군이다. 개별 반도체는 2025년 307억 달러에서 2027년 357억 달러로 완만히 증가하고, 광전자는 430억 달러에서 464억 달러로 확대되는 구조이다. 센서는 209억 달러에서 230억 달러로 성장하는 흐름이다. 집적회로는 2025년 7,010억 달러에서 2026년 1조 4,123억 달러, 2027년 1조 8,085억 달러로 급증하는 핵심 영역이다.

집적회로 내부에서는 메모리가 2025년 2,300억 달러에서 2026년 8,039억 달러, 2027년 1조 621억 달러로 확대되며 가장 큰 성장 폭을 보이는 제품군이다. 로직은 2025년 2,995억 달러에서 2027년 5,228억 달러로 증가하며 AI 가속기, CPU, NPU, ASIC, AP, 네트워크 프로세서 수요를 반영하는 영역이다. 아날로그는 865억 달러에서 1,017억 달러로, 마이크로는 849억 달러에서 1,220억 달러로 성장하는 구조이다.

특히 메모리는 DRAM, NAND, HBM, eSSD가 중심이고, 로직과 메모리가 장기적으로 글로벌 반도체의 절반 이상을 차지하는 구조로 성장할 전망이다. 또한 아날로그, MCU, 전력소자, 센서용 반도체는 자동차, 산업, 통신, 로봇, 의료로 적용처가 확대되는 추세이다.

[그림 9] 글로벌 반도체 제품별 시장 규모 및 전망



자료: 세계반도체무역통계기구(WSTS, 2026년 4월), 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5로 재구성

[II-1. 글로벌 메모리 반도체 시장 현황 및 전망]

메모리 반도체 시장은 '26년 8,039억 달러 (약 1,165조원) 규모

글로벌 메모리 반도체 시장은 글로벌 빅테크 기업들의 공격적인 AI 인프라 투자에 힘입어 패러다임의 대전환을 맞이하고 있다. 과거 PC나 모바일 수요에 종속되던 단순 범용 부품의 한계를 완전히 탈피하여, 전 세계 인공지능 인프라의 연산 성능을 좌우하는 '전략적 핵심 자원'으로 위상이 격상되었다.

이에 따라 시장 규모는 2025년 2,300억 달러에서 2026년 전년 대비 무려 2.5배 폭증한 8,039억 달러(약 1,165조 원)로 수직 상승한 뒤, 2027년에는 1조 621억 달러라는 전례 없는 대기록을 달성할 전망이다. 전체 메모리 매출 내 서버용 제품 비중이 2025년 37%에서 2026년 56%로 급증하는 만큼, HBM과 고용량 eSSD 중심의 구조적 공급 부족은 내년 상반기까지 확고하게 지속될 수밖에 없다.

이러한 폭발적 성장의 배경에는 북미 빅테크 기업 중심의 공격적인 AI 인프라 투자와 클라우드 컴퓨팅, 고성능 워크로드의 확대가 자리한다. 특히 전체 메모리 시장에서 서버용 제품이 차지하는 매출 비중은 2025년 37%에서 2026년 56%로 수직 상승하며 시장의 주도권 이동을 증명하고 있다. 이에 따라 AI 가속기의 필수재인 HBM과 고용량 eSSD, 서버용 DRAM 등 고부가 가치 제품의 수요가 폭발중이고, 공급이 이를 충분히 따라가지 못할 경우 가격 상승 압력이 이어질 가능성이 있다.

더불어 데이터센터 확장과 비디오 스트리밍 수요에 맞물린 NAND의 성장, 그리고 3D NAND 및 차세대 DRAM으로의 기술 전환은 시장의 판도를 바꾸는 핵심 요소이다. 비록 공급 측면의 변동성 리스크가 공존하지만, 자동차 전장화와 산업 자동화, 엣지 컴퓨팅 등 전방 산업의 다변화는 과거 소비자 가전 주기에 흔들리던 메모리 산업의 고질적인 변동성을 상쇄하는 든든한 버팀목이 될 것으로 평가된다.

[그림 10] 글로벌 반도체 메모리 시장 트렌드 및 중장기 전망



자료: 세계반도체무역통계기구(WSTS, 2026년 4월), Fortune business insights, 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5로 재구성

글로벌 메모리 반도체 주요 업체 및 특징

메모리 반도체는 대형
종합 반도체사와 특수
메모리 및 임베디드
연계 기업들이 공존

글로벌 메모리 반도체 공급망은 국가와 사업 유형별로 정교하게 분산된 생태계를 형성하고 있다. 주
요 약 20 개 기업은 지역별 강점과 제품별 역할에 따라 명확히 구분되며, 이는 대형 종합 반도체사와
특수 메모리 및 임베디드 연계 기업들이 공존하는 구조이다.

먼저 **한국**은 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하며 DRAM, NAND 뿐만 아니라 AI 시대의 핵심인 HBM 까
지 아우르는 독보적인 종합 메모리 경쟁력을 보유하고 있다. **미국**은 마이크론(DRAM·NAND), 웨스턴디
지탈(스토리지), 킹스턴(모듈)을 비롯해 플랫폼 및 고성능 컴퓨팅 강자인 인텔과 AMD, 마이크로칩 등
총 6 개사가 포진하여 가장 다변화된 포트폴리오를 자랑한다.

일본의 경우 낸드 중심의 도시바를 필두로 르네사스, 후지쯔, ROHM 등이 자동차 전장 및 산업용 임
베디드 시스템 연계 시장에서 뚜렷한 두각을 나타내고 있다. 공급망의 또 다른 축인 대만은 파워칩,
이트론, 난야, 마크로닉스, 원본드 등 5 개사가 중심이다. 이들은 범용 DRAM 부터 틈새시장을 겨냥한
특수 메모리(NOR 플래시 등)와 파운드리 영역에서 탄탄한 입지를 구축했다.

이외에도 차량용 임베디드의 강자 **독일** 인피니언, 차세대 기술을 개척하는 **이스라엘** 위닛 나노, 생산
기반 중심의 **중국** HLMC 가 축을 이룬다.

결론적으로 메모리 시장은 단순한 제조 업종을 넘어, 각국의 기술적 강점이 융합된 고도의 글로벌 협
력 네트워크 체제이다.

[그림 10] 글로벌 메모리 반도체 주요 업체 및 특징



자료: 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5 로 재구성

글로벌 메모리 반도체 제품별(Dram, HBM, NAND) 주요 기업 M/S 현황

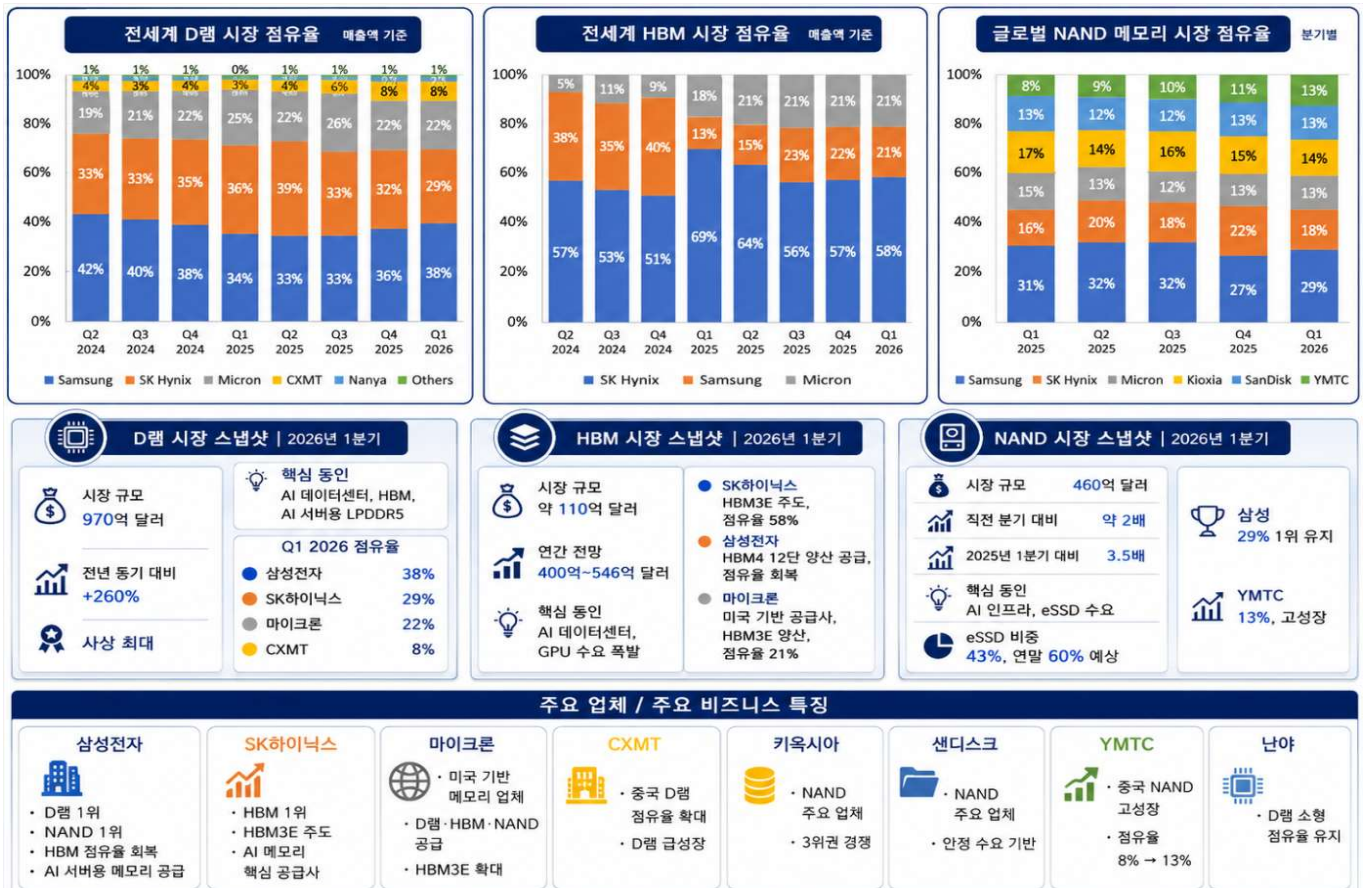
메모리 반도체 시장은
AI 인프라 확산에
힘입어 D램, HBM,
낸드(NAND) 전
영역에서 사상 최대
실적을 경신하는 구조적
호황기 진입

글로벌 메모리 반도체 시장은 AI 인프라 확산에 힘입어 D램, HBM, 낸드(NAND) 전 영역에서 사상 최대 실적을 경신하는 구조적 호황기에 진입한 상태이다. 먼저 2026년 1분기 전 세계 D램 시장 규모는 전년 동기 대비 260% 급증한 970억 달러를 기록했다. 업계 1위 삼성전자는 공급망 다변화 속에 38%의 점유율로 선두를 지켰으며, SK하이닉스가 29%로 뒤를 이었다. 미국 마이크론은 22%의 안정적인 점유율을 기록한 가운데, 중국의 CXMT가 8%까지 무섭게 치고 올라오며 업계의 새로운 변수로 부각되는 흐름이다.

2026년 1분기 전 세계 D램 시장(970억 달러)은 전년 동기 대비 260% 폭증하며 사상 최대치를 경신했다. 특히 AI 가속기의 필수재인 HBM 시장(1분기 110억 달러)은 SK하이닉스가 HBM3E 독주 체제를 굳히며 58%의 압도적 점유율로 판을 주도하고 있으며, 삼성전자와 마이크론이 각각 21%의 점유율로 그 뒤를 맹렬히 추격하고 있다. 한편 낸드(NAND) 시장 또한 서버용 eSSD 수요 폭발로 1분기 460억 달러 매출을 기록했다. 업계 1위 삼성전자(29%)의 견고한 지배력 속에 중국 YMTC가 내수 시장을 등에 업고 13%의 점유율로 3위권에 진입하는 등 치열한 치각변동이 진행 중이다

한편, 낸드 플래시 시장 역시 1분기 460억 달러의 사상 최고 수준의 매출을 달성하며 직전 분기 대비 2배 가까운 가파른 성장세를 증명했다. 특히 서버용 eSSD 매출 비중이 43%까지 확대되며 질적 성장을 주도하고 있다. 기업별로는 삼성전자가 29%로 독보적 1위를 유지한 가운데, SK하이닉스(18%), 키옥시아(14%), 마이크론(13%), 샌디스크(13%)가 치열한 순위 싸움을 전개 중이다. 주목할 점은 중국 YMTC가 내수 수요를 무기로 전년 대비 445% 성장하며 13%의 점유율로 3위권 진입을 본격화했다는 사실이다.

[그림 11] 글로벌 메모리 반도체 제품별(Dram, HBM, NAND) 주요 기업 M/S 현황



자료: Counterpointresearch, 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5 로 재구성

메모리 반도체 제품별(Dram, NAND) 가격 추이

AI 인프라 투자 확대와
제조사들의 고부가 제품
중심 웨이퍼 배정으로
인해 전례 없는 공급
부족과 가격 상승 국면

글로벌 메모리 반도체 시장은 AI 인프라 투자 확대와 제조사들의 고부가 제품 중심 웨이퍼 배정으로 인해 전례 없는 공급 부족과 가격 상승 국면을 마주하고 있다.

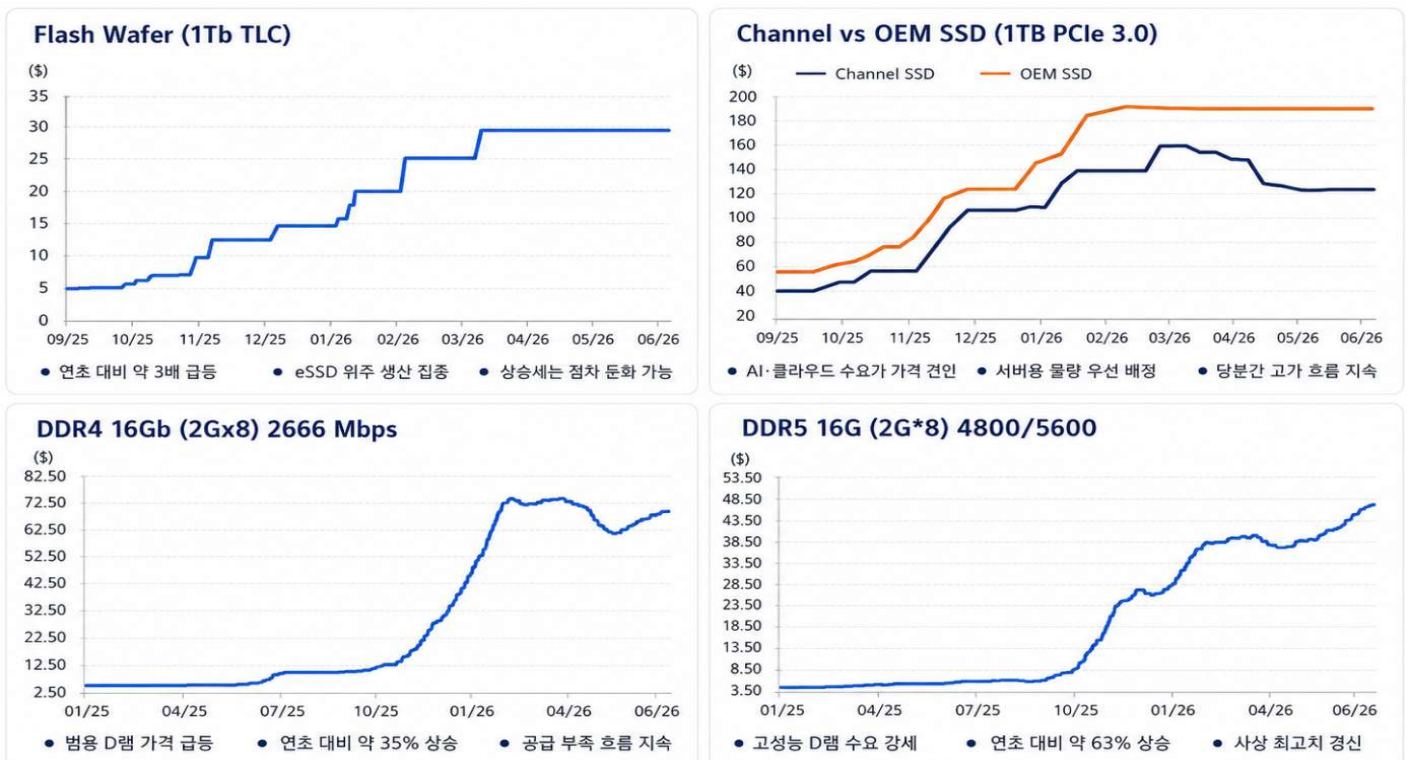
먼저 **D램 시장**은 차세대 서버에 모바일 D램(LPDDR)이 필수재로 대거 채택되면서 가격이 기록적으로 치솟았다. 범용 PC 제품인 DDR4 16Gb 가격은 연초 대비 약 35% 상승한 71.5 달러 선에 도달했으며, LPDDR 공급 부족 심화로 DDR5 16Gb 가격은 무려 63% 상승하며 사상 최고치를 경신하고 있다. 이러한 신형 제품의 품귀 현상은 구형 레거시 시장으로까지 번져 DDR3 가격이 연초 대비 70% 상승하는 기현상으로 이어지는 구조이다.

낸드플래시와 SSD 시장 역시 고성능 데이터센터 수요 급증에 직격탄을 맞으며 시세가 고공행진 중이다. 특히 서버용 SSD 가격은 1년 새 5배 가까이 급등했으며, 소비자용 SSD도 저점 대비 2~3배 이상 올라 투자자와 소비자 모두의 비용 부담을 가중시키고 있다.

SSD 제품의 핵심 원자재인 1Tb TLC **낸드 웨이퍼** 가격 또한 AI 서버 수요 폭발과 제조사들의 선별적 생산 전략 속에 연초 대비 약 3배 상승한 25~30 달러 선을 기록하고 있다.

향후 메모리 시장은 대형 제조사들이 HBM 과 기업용 eSSD 등 고수익 제품에 역량을 집중함에 따라 구조적인 수급 타이트 현상이 당분간 지속될 전망이다. 다만 지속적인 가격 급등에 따른 전방 세트 업체들의 저항과 단말기 수요 둔화로 인해 하반기 이후 가격 상승 폭은 점차 완만해지는 고점 정체기에 진입할 가능성이 높다. 따라서 제조사들은 고단수 적층 및 QLC 기반 대용량 제품 확대를 통해 수익성 다변화를 꾀할 것으로 예상된다.

[그림 12] 메모리 반도체 제품별(Dram, NAND) 가격 추이 등



핵심 포인트



HBM·서버 D램
우선 배정



낸드·SSD
공급 타이트



AI 인프라가
가격 급등 주도



하반기 상승 폭은
완만 가능

자료: Memorymarket, 쿼티와이즈, 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5 로 재구성

글로벌 메모리 반도체 지역별 특징 및 분석

전 세계적인 디지털
주권 확보 경쟁은
메모리 시장의 장기적
호황을 지탱하는 버팀목

글로벌 메모리 반도체 시장은 첨단 인프라 투자와 산업별 디지털 전환에 힘입어 대륙별로 뚜렷한 성장세를 나타내는 구조이다. 먼저 전 세계 최대의 생산 및 소비 기지인 **아시아·태평양 지역**은 2025 년 40.5%의 점유율로 932 억 달러의 매출을 기록한 데 이어, 2026년에는 3,247 억 달러 규모로 급팽창할 전망이다. 이는 싱가포르, 인도 등지의 데이터센터 투자가 수요를 견인하는 가운데, 일본은 전장·소재 분야의 강점을, 중국은 정부의 전폭적인 지원을 바탕으로 제조 자급률을 높이며 영향력을 확대하는 흐름이다.

북미 시장 역시 하이퍼스케일 클라우드 기업들의 폭발적인 AI 인프라 투자에 힘입어 독보적인 전략적 요충지로 부상했다. 2025 년 31.2%의 점유율인 718 억 달러에서 2026 년 2,542 억 달러로 급성장이 예견된다. 미국을 중심으로 고성능 컴퓨팅 수요가 집중되며 연방 인센티브를 통한 공급망 다변화가 진행 중이다. **유럽**은 전기차와 5G, 산업 자동화 열풍 속에 2025 년 17.3% 비중인 398 억 달러에서 2026 년 1,388 억 달러로 성장할 것으로 보인다. 독일의 전장 산업과 영국의 설계 혁신이 돋보이나, 높은 수입 의존도는 여전히 한계로 작용될 전망이다.

그 외 신흥 지역의 잠재력도 주목할 만하다. **중동·아프리카**는 걸프 국가 중심의 데이터센터 확충으로 2025 년 7.2%인 166 억 달러에서 2026 년 565 억 달러로의 도약이 기대된다. 라틴 아메리카 또한 통신망 확장에 힘입어 2025 년 3.8%인 87 억 달러에서 2026 년 297 억 달러로 외연을 넓히고 있다. 비록 일부 지역의 인프라 제약과 공급망 편중 리스크가 상존하지만, 전 세계적인 디지털 주권 확보 경쟁은 메모리 시장의 장기적 호황을 지탱하는 버팀목이다.

[그림 13] 글로벌 메모리 반도체 지역별 특징 및 분석



자료: 세계반도체무역통계기구(WSTS, 2026 년 4 월), Fortune Business Insights, 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5 로 재구성

글로벌 메모리 반도체 산업, 사용자/수요처 시장 분석

전방 산업의 고도화와
데이터 요구량 증가에
맞물려 다변화된 성장

글로벌 메모리 반도체 시장은 소비자 가전, IT·통신, 자동차, 의료, 방산 등 전방 산업의 고도화와 데이터 요구량 증가에 맞물려 다변화된 성장을 구가하는 구조로 성장하고 있다. 가장 거대한 축은 스마트폰, 노트북, 게임 콘솔 등을 아우르는 소비자 가전 부문이다. 이 분야는 기술 성숙기에 접어들며 성장 속도는 다소 완만해졌으나, 고밀도 칩과 향상된 아키텍처 개발에 힘입어 2026 년 기준 전체 시장의 27.7%라는 압도적인 점유율로 여전히 주도적인 위치를 차지하고 있다.

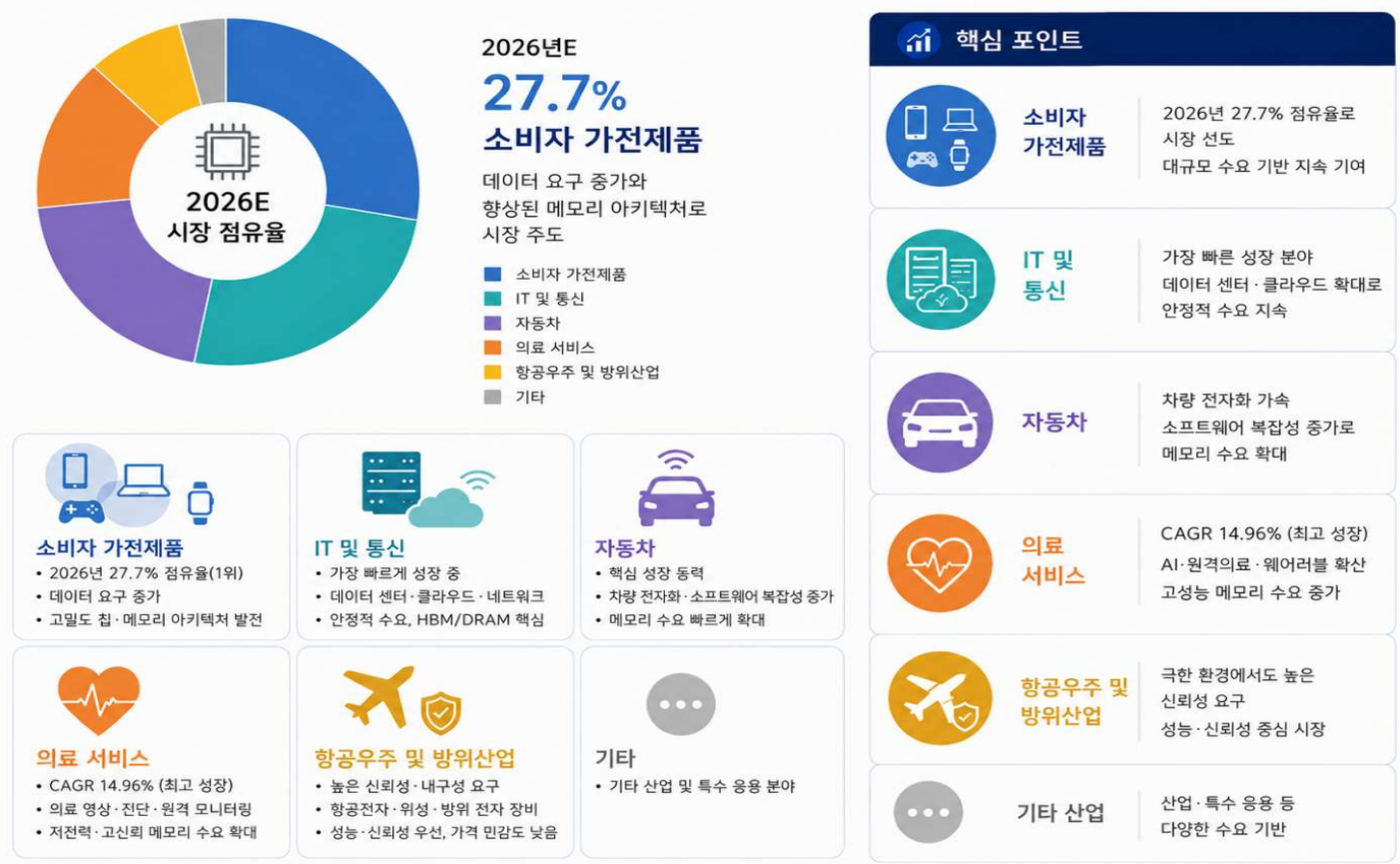
반면 IT 및 통신 부문은 클라우드 인프라와 하이퍼스케일 데이터센터 확충의 핵심 동력으로서 가장 가파른 성장세를 나타내는 영역이다. 가전 부문과 달리 경기 변동이나 소비 주기의 영향이 적어 안정성이 높으며, 고대역폭 메모리(HBM)와 고성능 DRAM 솔루션을 흡수하는 블랙홀 역할을 하고 있다.

아울러 차량의 소프트웨어 중심화(SDV)와 첨단 전자장비 탑재가 가속화되는 자동차 부문 역시 가전 의존도를 낮추고 메모리 산업의 장기적 우상향을 뒷받침하는 차세대 핵심 성장 동력으로 명확히 안착했다.

특히 주목할 틈새 영역은 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)인 15.0%를 예고한 의료 서비스 부문이다. AI 기반 진단, 고해상도 의료 영상, 원격 모니터링 확산으로 인해 고속·대용량 메모리 수요가 폭발하고 있으며, 웨어러블 기기의 대중화로 저전력·고신뢰성 제품의 도입이 급증하는 추세이다.

극한의 환경에서 무결성을 유지해야 하는 항공우주 및 방위산업 또한 가격 민감도보다 독보적인 성능과 내구성을 최우선으로 요구하며, 메모리 시장의 고부가가치 다변화를 이끄는 또 다른 축을 담당하고 있다.

[그림 14] 글로벌 메모리 반도체 산업, 사용자/수요처 시장 분석



자료: Fortune Business Insights, 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5 로 재구성

글로벌 메모리 반도체 산업의 성장과 기회, 제약 요건

메모리 시장은
하이라스크·하이리턴
전형이며, 기술
리더십을 선점한 소수
기업 중심의 압축
성장이 지속

글로벌 메모리 반도체 시장은 AI 인프라 확산과 하이퍼스케일 데이터센터의 폭발적 성장에 힘입어 구조적 고성장 국면에 진입한 상태이다. 빅데이터 처리와 클라우드 컴퓨팅 워크로드의 심화는 고성능 DRAM 및 비휘발성 메모리 수요를 가공할 수준으로 견인하고 있다. 여기에 스마트폰, 게임기 등 전통 전자기기의 대용량화와 국내외 제조업 육성을 위한 지정학적 투자 붐이 더해지며 시장의 장기적 성장 기반을 더욱 탄탄하게 뒷받침하는 구조이다.

동시에 미래를 바꿀 파괴적 시장 기회도 공존한다. 특히 연산 효율을 극대화하는 고대역폭 메모리(HBM)는 AI 프로세서의 필수재로 안착하며 독점적 지위를 누리고 있다. 아울러 차량의 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환에 따른 전장 메모리 수요 급증은 가전 주기에 흔들리던 업황의 안정성을 높이는 요인이다. 전력 소모 없이 초고속 연산이 가능한 MRAM, ReRAM 등 차세대 비휘발성 메모리(NVM) 기술의 본격 도입 역시 향후 판도를 바꿀 새로운 기회 요인으로 평가된다.

다만 투자자가 주시해야 할 구조적 제약 조건과 리스크도 명확하다. 미세화 공정이 한계에 다다름에 따라 누설 전류 증가와 데이터 유지 시간 단축 같은 물리적 기술 장벽이 수율 관리를 위협하고 있다. 또한 막대한 시설 투자가 필수적인 자본 집약적 특성 탓에 승자독식 구조가 심화되는 한편, 공급과잉에 따른 고질적인 가격 주기성(사이클)과 미·중 갈등을 비롯한 지정학적 수출 규제는 공급망 변동성을 높이는 부담이다.

결국 메모리 시장은 하이라스크·하이리턴의 전형이며, 기술 리더십을 선점한 소수 기업 중심의 압축 성장이 지속될 전망이다.

[그림 15] 글로벌 메모리 반도체 산업의 성장과 기회, 제약 요건



자료: 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5 로 재구성

글로벌 메모리 반도체 산업의 경쟁 환경 및 투자 기회 분석

소수의 최상위 빅테크
기업들이 독보적인
기술력과 대규모 생산
능력을 독점하는 고도의
과점형 경쟁 구조

글로벌 메모리 반도체 시장은 소수의 최상위 빅테크 기업들이 독보적인 기술력과 대규모 생산 능력을 독점하는 고도의 과점형 경쟁 구조를 띠고 있다. 천문학적인 시설 투자 비용과 미세화 공정의 지적재산권, 극도로 복잡한 제조 공정 자체가 강력한 진입 장벽으로 작용하여 선도 업체들의 승자독식 체제를 공고히 지탱하는 실정이다. 특히 D 램과 낸드플래시 부문은 고질적인 업황 주기(사이클)에 따른 가격 변동성이 극심하기 때문에, 상위 리더 기업들은 하이퍼스케일 클라우드사와의 장기 공급 계약을 체결하고 생산량을 정교하게 제어하며 수익성 방어에 집중하고 있다.

이러한 치열한 대기업 간의 전면전 속에서 틈새시장을 공략하는 전문 기업들의 행보도 주목할 만하다. 이들은 당장의 점유율 확장보다는 저전력과 고내구성을 무기로 삼아 차세대 비휘발성 메모리인 MRAM, ReRAM 등 특수 목적형 솔루션 개발에 사력을 다하고 있다. 아울러 최근의 경쟁 패러다임은 단순한 칩 제조를 넘어 프로세서 설계사, 시스템 통합업체들과의 전략적 파트너십을 통해 컴퓨팅 아키텍처 자체를 최적화하는 생태계 연합 전선 구축으로 급격히 진화하는 추세이다.

투자 관점에서 메모리 산업은 AI, 클라우드, 전기차 등의 구조적 우상향에 탑승한 거대한 투자 기회의 장이다. 비록 막대한 자본 조달 압박과 공급망을 둘러싼 지정학적 리스크가 상존하지만, 장기적 안목의 투자자들은 3D 적층 아키텍처와 첨단 미세 노드 선점 기업의 독점적 이익에 주목하고 있다.

결국 중소·지역 기업과의 인수합병이나 기술 제휴를 통한 외연 확장이 가속화되는 흐름 속에서, 독보적인 기술 혁신과 자본력을 증명한 리더 기업 중심의 압축 성장에 초점을 맞추는 전략이 유효하다.

[그림 16] 글로벌 메모리 반도체 산업의 경쟁 환경 및 투자 기회 분석



자료: 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5 로 재구성

[II-2. 글로벌 반도체 장비 시장 현황 및 전망]

반도체 제조 장비는
글로벌 공급망 확장을
실질적으로 주도하는
핵심 기반 산업이자,
전방 산업의 생산능력
확대를 가능하는
절대적인 선행 지표

반도체 제조 장비 산업은 반도체 웨이퍼와 집적회로(IC), 메모리 및 로직 칩 등 첨단 칩을 생산하기 위해 쓰이는 고정밀 핵심 산업 장비를 다루는 영역이다. 통상적으로 반도체 생산 프로세스는 원재료인 웨이퍼 제조를 시작으로 회로 형성, 식각, 증착, 세정 등 칩의 골격을 만드는 전공정과 검사, 패키징, 테스트를 거쳐 완제품을 만드는 후공정까지 극도로 복잡한 단계를 거친다.

나노 단위의 미세공정이 고도화될수록 빛으로 회로를 그리는 포토리소그래피(노광) 장비를 비롯하여 불필요한 부분을 깎아내는 식각 장비, 화학기상증착(CVD) 등의 박막 형성 장비, 그리고 칩의 무결성을 검증하는 측정·공정 제어 및 품질 관리 검사 장비의 중요성이 한층 부각되는 구조이다.

그리고 투자 관점에서 장비 산업을 완제품 시장의 움직임에 단순히 뒤따라가는 후행 구조로 오인해서는 안 된다. 반도체 제조 장비는 글로벌 공급망 확장을 실질적으로 주도하는 핵심 기반 산업이자, 전방 산업의 생산능력 확대를 가능하는 절대적인 선행 지표이기 때문이다.

아무리 전 세계적으로 반도체 수요가 폭발하더라도, 물리적인 제조 장비의 적기 투입과 고도의 기술적 뒷받침이 선행되지 않는다면 생산량 증대 자체가 불가능하다.

결국 패키징과 테스트를 포함한 전방위적 장비 고도화는 반도체 기업들의 미래 경쟁력을 좌우하는 척도이며, 장비 산업의 투자 추이를 정밀하게 분석하는 것이야말로 반도체 산업 전체의 사이클과 호황 규모를 가장 정확하게 예측하는 척도라 할 수 있다.

[그림 17] 반도체 제조 장비 시장의 정의



자료: 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5 로 재구성

글로벌 반도체 장비 시장 규모 및 성장 전망

반도체 제조 장비 시장은 전방 산업의 기술 고도화와 맞물려 단순한 경기 회복을 넘어선 장기 구조적 고성장 국면에 진입

글로벌 반도체 제조 장비 시장은 전방 산업의 기술 고도화와 맞물려 단순한 경기 회복을 넘어선 장기 구조적 고성장 국면에 진입한 상태이다. 포춘비즈니스인사이드 자료에 따르면, 전 세계 반도체 제조 장비 시장 규모는 2025년 1,328억 달러에서 2026년 1,460억 달러로 견조한 확장을 예고하고 있다.

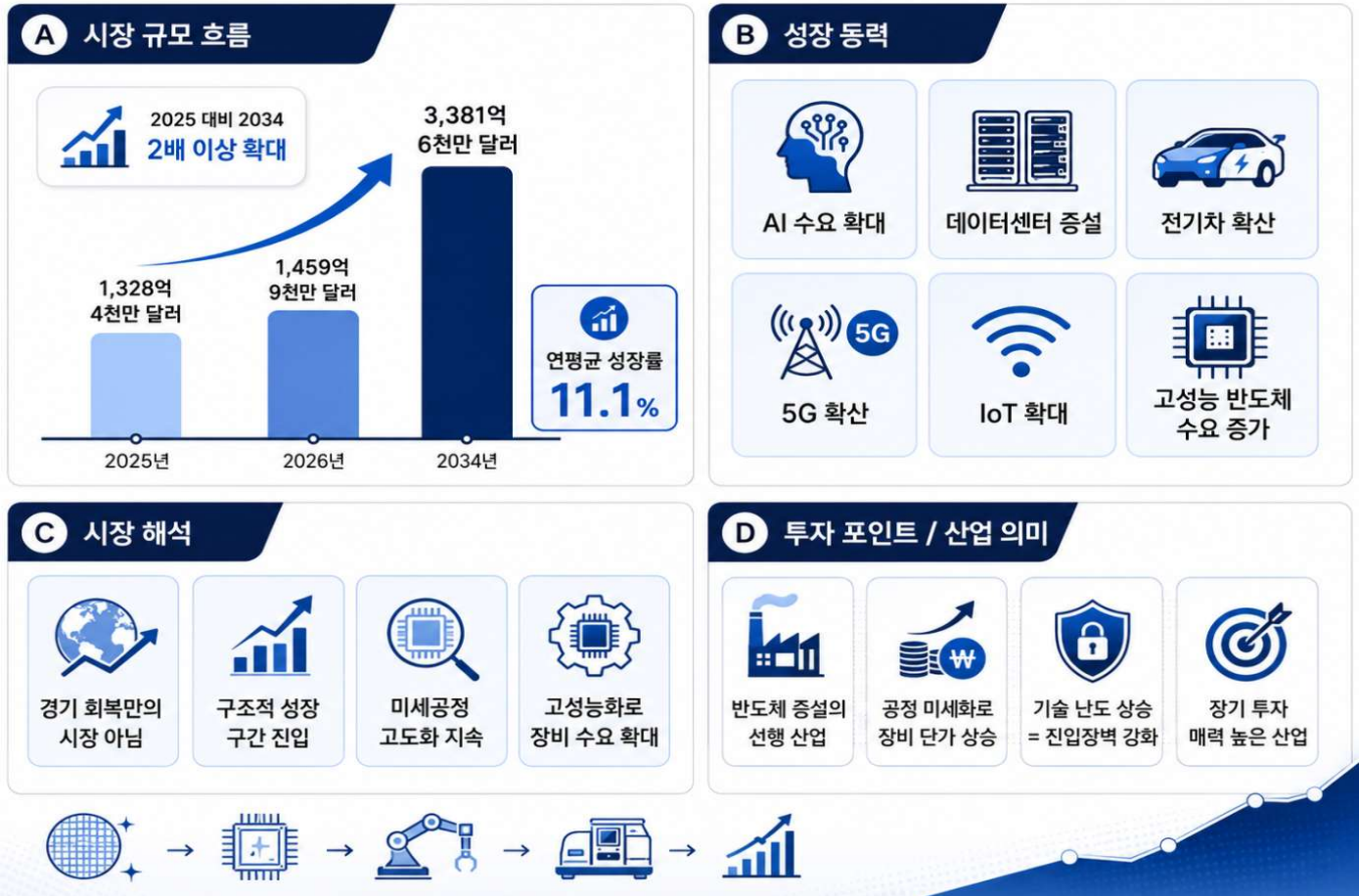
더 나아가 오는 2034년에는 3,321억 달러라는 상당한 수준까지 시장 규모가 팽창할 것으로 전망된다. 이로써 2026년부터 2034년까지 예측 기간 동안 글로벌 장비 시장이 보여줄 것으로 기대되는 **예상 연평균 성장률(CAGR)은 무려 11.1%라는 대단히 인상적인 수치**로 귀결된다.

이러한 폭발적인 시장 성장의 배경에는 인공지능(AI) 인프라 확산을 필두로 한 하이퍼스케일 데이터센터 구축, 전기차 전환 가속화, 5G 및 사물인터넷(IoT)의 대중화가 자리한다. 이러한 고성능 반도체 수요의 복합적인 확대는 장비 업황의 중장기 우상향을 견인하는 든든한 동력이다. 특히 주목할 시사점은 2034년의 시장 규모가 2025년과 비교했을 때 2배 이상으로 확대된다는 점이며, 이는 반도체 제조 장비 산업이 글로벌 자본시장에서 장기적으로 매우 매력적인 투자처임을 입증하는 증거가 된다.

결론적으로 반도체 생산 공정이 나노 단위로 미세화되고 고성능화될수록 해당 장비 단가와 기술적 진입 장벽은 기하급수적으로 상승하게 된다. 이는 장비 제조사들의 고부가가치 매출 확대로 이어져 전체 시장 규모를 더욱 키우는 선순환 효과를 낳을 핵심 요인이다.

따라서 투자자들은 단기적인 업황 리스크에 흔들리기보다는 고성능 반도체 공정 진화의 필수재인 첨단 장비 공급망의 장기 성장에 초점을 맞추는 해안이 필요하다.

[그림 18] 글로벌 반도체 장비 시장 규모 및 성장 전망



자료: Fortune Business Insights(2026년 6월), 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5로 재구성

글로벌 반도체 장비 시장 성장 동인

강력한 성장 동인은
생성형 AI 확산에 따른
하이퍼스케일
데이터센터의 투자 확대

글로벌 반도체 제조 장비 시장의 성장은 AI 데이터센터, 자동차 전장화, 5G 인프라라는 삼각 편대가 견인하는 구조이다. 가장 강력한 동인은 AI 기술 확산에 따른 하이퍼스케일 데이터센터의 투자 확대이다. AI 학습에 필수적인 고성능 GPU와 HBM을 생산하려면 첨단 공정이 선행되어야 하므로 EUV 노광 장비, 고정밀 증착, 식각, 결함 검사 장비 수요가 폭발하고 있다. 이는 장비의 단가와 정밀도를 함께 끌어올리며 장비 산업 전체의 부가가치를 높이는 핵심 배경이다.

두 번째 축은 전기차와 자율주행차로 대변되는 자동차 전장화 흐름이다. 배터리 관리와 고전압 제어가 핵심인 전기차 시장에서는 탄화규소(SiC) 웨이퍼 기반 전력 반도체 수요가 가속화되는 중이다. 이에 따라 SiC 가공 장비 영역이 넓어지고 있으며, 차량용 반도체의 엄격한 신뢰성 기준을 충족하기 위한 후공정 검사 및 테스트 장비 매출도 강력히 지탱된다. 이는 과거 가진 주기에만 의존하던 업황의 불확실성을 낮추고, 전후공정 장비 전반에 걸쳐 장기 안정성을 부여하는 버팀목 역할을 한다.

마지막으로 5G 통신망 고도화와 사물인터넷(IoT)의 확산은 장비 시장의 견고한 하방 지지선을 형성한다. 고주파(RF) 부품, 광전자 장치, 마이크로컨트롤러 등의 수요가 폭증하면서 이를 대량 생산하기 위한 장비 산업의 기초 체력이 탄탄해지고 있다. 기기들이 소형화될수록 단일 칩 내의 집적도가 올라가므로 정밀 제조와 검사 장비의 역할은 더욱 막중해진다.

따라서 반도체 장비 산업은 디지털 전환과 궤를 같이하는 기술 집약체이며, 전방 수요의 다변화 덕분에 구조적 우상향의 발판을 완벽히 다진 상태이다.

[그림 19] 글로벌 반도체 장비 시장 성장 동인



자료: 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5 로 재구성

글로벌 반도체 장비 산업의 기술 트렌드 분석

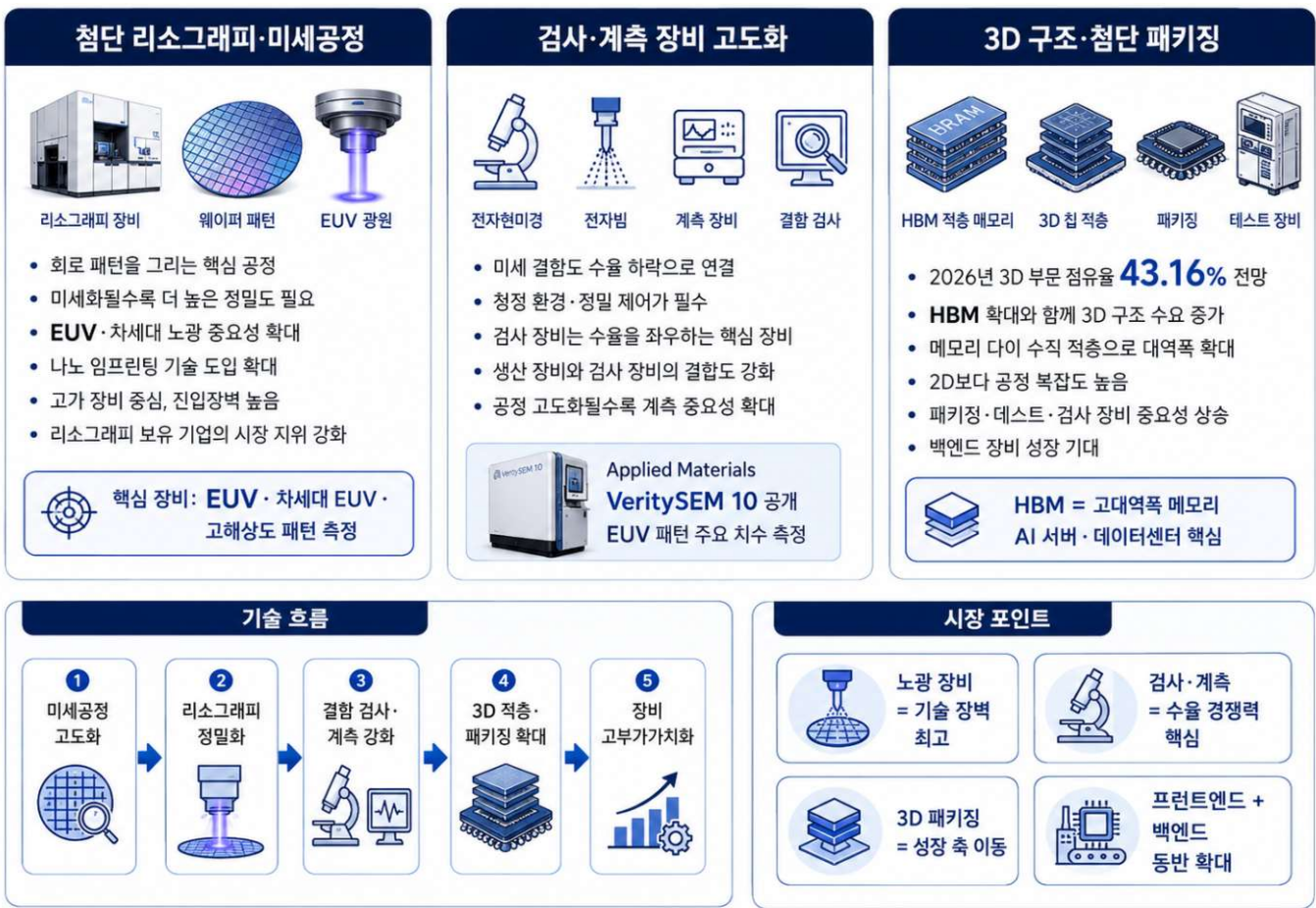
미세공정 극대화,
검사 장비 고도화, 3D
적층 중심의 첨단
패키징이라는 세 가지
축으로 대전환

글로벌 반도체 제조 장비 시장의 기술 패러다임은 미세공정 극대화, 검사 장비 고도화, 3D 적층 중심의 첨단 패키징이라는 세 가지 축으로 대전환을 맞이하고 있다. 첫째, 첨단 리소그래피(노광) 기술은 웨이퍼에 초미세 회로 패턴을 그리는 핵심 공정이다. 한계를 극복하기 위해 주요 기업들은 나노 임프린팅과 최첨단 리소그래피 도입에 사력을 다하고 있다. 특히 기술 진입 장벽이 극도로 높은 EUV와 차세대 EUV, 고해상도 패턴 측정 장비 영역을 선점한 공급사는 고가 장비의 특성상 향후 글로벌 장비 시장에서 독점적 지위를 누릴 가능성이 매우 크다.

둘째, 선풍이 나노 단위로 좁아지면서 수율을 결정짓는 검사·계측 장비의 위상이 보조 장비에서 핵심 장비로 격상되고 있다. 미세먼지나 미시적 공정 결함이 초래하는 치명적인 손실을 막기 위해 장비의 고정밀 제어가 필수적이다. 실례로 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 2023년 공개한 전자빔 측정 시스템 'VeritySEM 10'은 차세대 고해상도 EUV로 패턴화된 소자의 주요 치수를 정밀 측정하는 기술력을 증명했다. 이는 공정 난도가 올라갈수록 생산과 검사 장비의 결합이 더욱 강력해짐을 시사한다.

셋째, 반도체 구조가 평면에서 입체로 진화함에 따라 2026년 기준 3D 부문이 43.2%의 시장 점유율로 업황을 주도할 전망이다. 복잡한 수직 적층 구조를 가진 HBM 등 고성능 메모리 수요 폭발이 이를 견인하고 있다. 더불어 자동차와 가전 산업을 겨냥한 혁신적 패키징 솔루션이 연이어 도입되면서, 백엔드 후공정 장비 부문 역시 상당한 성장률을 예고하고 있다. 이는 프론트엔드 전공정에 치우쳤던 과거 장비 시장에서 패키징과 테스트, 검사 기술이 기업의 핵심 전략 무기로 완벽히 안착했음을 입증한다.

[그림 20] 글로벌 반도체 장비 산업의 기술 트렌드



자료: Fortune Business Insights(2026년 6월), 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5로 재구성

글로벌 반도체 장비 유형별/구조별/응용 분야별 분석

반도체 장비 시장은
장비 유형, 차원의
구조, 응용 분야별로
세분화

글로벌 반도체 제조 장비 시장은 장비 유형, 차원의 구조, 응용 분야별로 세분화되어 첨단 산업의 수요를 체계적으로 흡수하는 구조이다. 우선 **장비 유형별**로는 웨이퍼에 회로를 형성하는 전공정 단계인 프론트엔드 부문이 2026 년 기준 84.6%라는 압도적인 점유율로 시장을 선도할 전망이다. 리소그래피, 식각, 증착 등을 아우르는 이 영역은 로직 회로 수요 증가와 함께 대형 장비사들의 핵심 전장으로 꼽힌다. 반면 칩을 절단·패키징하고 검사하는 후공정인 백엔드 장비는 전통적인 프론트엔드에 비해 규모는 작으나, 자동차 및 가전 산업의 혁신적 패키징 솔루션 도입과 HBM 수요 폭발에 힘입어 전략적 중요성이 급격히 커지는 흐름이다.

차원 구조별 분석에서는 평면형 2D 구조가 비용 효율성을 무기로 기존 인프라 수요를 유지하는 가운데, 여러 칩을 인터포저로 연결해 배선 시간과 비용을 줄이는 2.5D 구조의 채택이 고성능 제품군에서 늘고 있다. 특히 칩을 수직으로 쌓아 올리는 3D 구조 세그먼트는 HBM 과 고성능 메모리 수요 확대에 힘입어 2026 년 43.2%의 점유율로 업향을 주도할 것으로 관측된다. 최종적으로 AI 반도체와 고성능 컴퓨팅 시장이 확장될수록 이러한 2.5D 및 3D 입체 구조를 완벽히 구현해 낼 수 있는 가공 장비의 전략적 가치는 자본시장에서 한층 더 높게 평가받을 가능성이 크다.

마지막으로 **응용 분야**를 살펴보면 반도체 제조 공장 및 파운드리 부문이 의료, 자동차, 전자제품 등 전방 산업의 전방위적 수요 증폭 덕택에 2026 년까지 58.1%의 점유율을 기록하며 성장을 견인할 것으로 예상된다. 아울러 반도체 전자제품 제조 부문은 제품 검사와 품질 관리의 중요성 대두 및 정부의 안전 규제 강화 흐름 속에 장비 수요를 파생시키고 있다. 결함과 불량률 최종 검증하는 테스트 센터 역시 완제품이 자동차, 의료 등 고신뢰성을 요하는 영역으로 침투할수록 필수 인프라로 안착하며 장비 시장의 외연을 넓히는 핵심 축으로 작동 중이다.

[그림 21] 글로벌 반도체 장비 유형별 / 구조별 / 응용 분야별



자료: Fortune Business Insights(2026 년 6 월), 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5 로 재구성

글로벌 반도체 장비 지역별 시장 분석

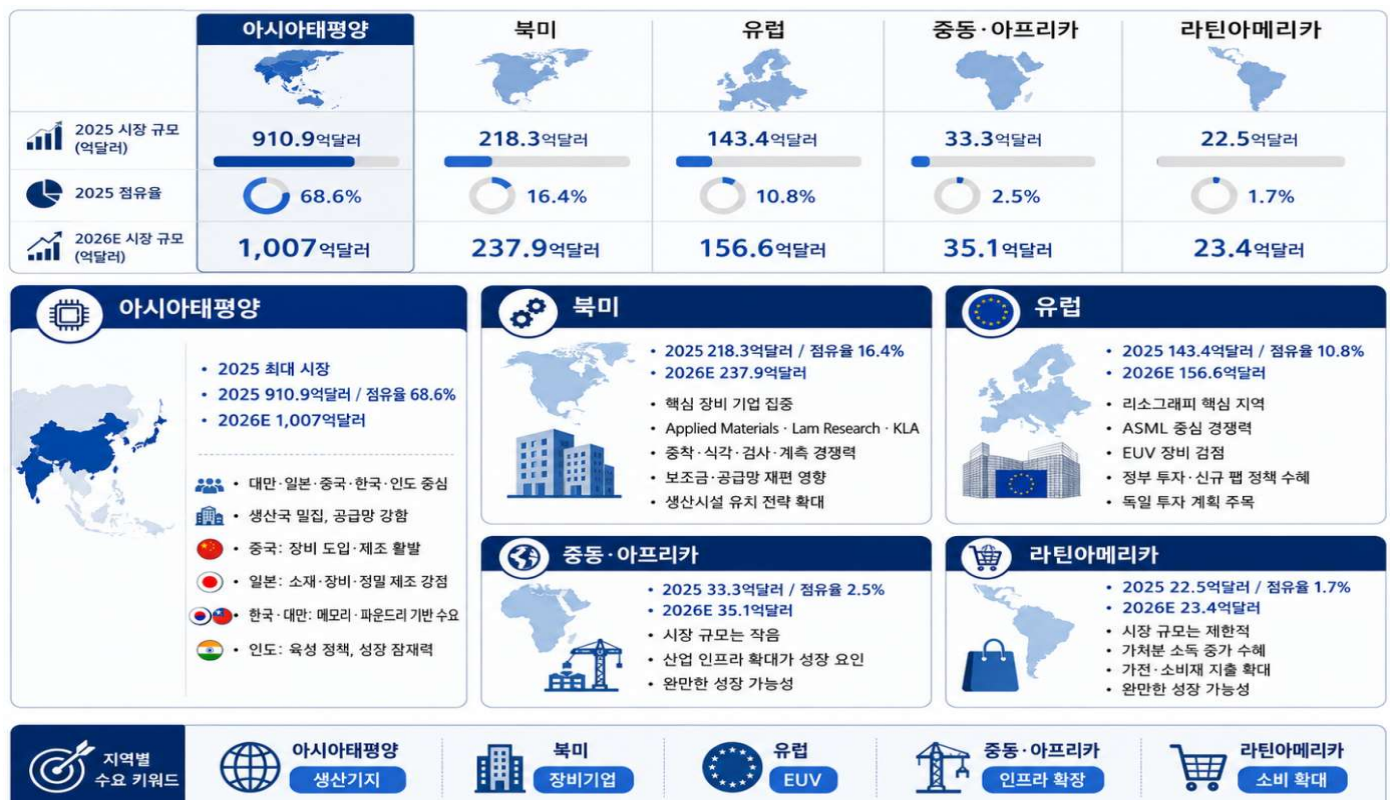
글로벌 장비 업황은
미·중·유럽의 자국 중심
보조금 정책과 원천
기술 독점력이 맞물리며
지각변동 중

글로벌 반도체 제조 장비 시장은 아시아·태평양, 북미, 유럽이 성장을 삼분하는 가운데 각 권역의 정책적 인센티브와 공급망 특성에 따라 뚜렷한 권역별 역학 관계를 형성하고 있다. 먼저 전 세계 최대의 생산 기지인 아시아·태평양 지역은 2025년 910.9억 달러로 무려 68.6%의 독보적인 점유율을 기록했으며, 2026년에는 1,007억 달러 규모로 영토를 확장할 전망이다. 다만, 한국, 일본, 중국의 탄탄한 칩 공급망을 기초 체력으로 삼아 장비 수요를 무섭게 흡수하고 있으며, 소재·부품 기술력을 선점한 일본과 파운드리 및 메모리 양대 축인 한국·대만, 기술 자급률을 높이는 중국에 이어 인도의 정책적 육성 기반까지 가세하며 시장 리더십을 공고히 굳히는 구조이다.

반면 핵심 원천 기술을 쥔 북미 지역은 2025년 16.4%의 비중인 218.3억 달러에서 2026년 237.9억 달러로의 견조한 확장이 예견된다. 이 지역은 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT), 램리서치, KLA 등 증착·식각·계측 전반을 장악한 글로벌 장비 거두들의 본거지이다. 최근에는 정부 보조금과 공급망 재편 기조에 발맞춰 주요 장비 공급사들이 보조금 수혜 지역에 신규 생산 시설을 적극 구축하는 전략을 구사하고 있다. 2025년 10.8% 점유율(143.4억 달러)에서 2026년 156.6억 달러로 크는 유럽은 독보적인 EUV 노광 장비 기업 ASML을 보유하여 첨단 리소그래피 시장의 통제권을 쥐고 있으며, 독일 등 각국 정부의 대규모 신규 공장 투자책이 성장을 촉진한다.

그 외 중동·아프리카 시장은 2025년 2.5% 비중인 33.3억 달러에서 2026년 35.1억 달러로, 라틴아메리카는 2025년 1.7%인 22.5억 달러에서 2026년 23.4억 달러로 각각 완만하게 성장할 것으로 관측된다. 3대 핵심 권역에 비하면 물리적인 장비 매입 규모 자체는 다소 제한적인 수준이지만, 역대 가처분 소득 증대와 가전·소비재 지출 확대, 그리고 전반적인 산업 인프라 확장이 장기적인 수요 파생을 뒷받침하는 버팀목이다. 결론적으로 글로벌 장비 업황은 미·중·유럽의 자국 중심 보조금 정책과 원천 기술 독점력이 맞물리며 지각변동 중이다.

[그림 22] 글로벌 반도체 장비 지역별 시장 분석



자료: Fortune Business Insights(2026년 6월), 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5로 재구성

글로벌 반도체 장비 산업의 경쟁 구도 및 주요 기업

메모리 시장은
하이리스크·하이리턴
전형이며, 기술
리더십을 선점한 소수
기업 중심의 압축
성장이 지속

글로벌 반도체 제조 장비 시장은 기술 장벽을 선점한 5대 선점기업들이 전공정과 후공정 전반의 지배력을 양분하는 고도의 과점 구도를 형성하고 있다.

먼저 미국 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 증착, 공정 제어, 측정 전반을 아우르는 1 위 기업으로, 2023 년 패턴 치수를 정밀 측정하는 전자빔 시스템 'VeritySEM 10'을 공개하며 기술 리더십을 증명했다. 일본의 도쿄일렉트론(TEL)은 식각, 증착, 세정 포트폴리오가 강점이며, 2022 년 'CELLESTA MS2' 웨이퍼 세정 시스템을 출시해 입지를 굳혔다. 미국 램리서치(는 초미세화와 3D 적층 구조의 필수재인 식각·증착 분야의 절대강자이며, 네덜란드 ASML은 첨단 칩 제조의 독점재인 EUV 노광 장비를 공급해 전 세계 반도체 생산라인의 생사여탈권을 쥐 핵심 축이다. 마지막으로 미국 KLA 는 수율을 결정짓는 검사·계측 및 결함 제어 부문에서 독보적인 위상을 확보하고 있다.

이들 선도 기업이 구사하는 핵심 경쟁 전략은 정밀도와 생산성을 극대화한 신제품 출시, 인수합병(M&A), 그리고 전 세계적인 생산 거점 확대로 요약된다. 미세공정과 첨단 패키징, 웨이퍼 세정 영역의 기술 혁신이 활발한 가운데, 글로벌 테스트 장비사 어드밴테스트가 대만의 PCB 제조 및 조립 전문 공급사인 '신푸 테크놀로지(Shin Puu Technology)'를 인수한 사례는 포트폴리오 다각화와 공급망 강화의 대표적 단면이다.

아울러 각국 정부의 반도체 보조금 및 공급망 재편 기조에 발맞춰 장비 기업들은 생산 시설과 서비스 거점을 공격적으로 넓히고 있다. 이는 단순 판로 개척을 넘어 주요 고객사와의 물리적 근접성을 확보하고 정책 수혜를 극대화해 공급 안정성을 달성하려는 고도의 전략적 포석이다.

[그림 23] 글로벌 반도체 장비 산업의 경쟁 구도 및 주요 기업



[Ⅲ. 글로벌 반도체 산업 밸류체인 및 주요 종목]

글로벌 반도체 산업은 설계부터 전공정, 후공정에 이르기까지 정교하게 세분화된 밸류체인을 형성하며 성장을 거듭하고 있으며, 주요 글로벌 반도체 기업은 아래와 같다.

우선 밸류체인의 최상단인 **설계 및 칩메이커 단계**는 종합반도체사(IDM), 파운드리, 팹리스, IP 및 EDA 부문으로 구분된다. 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론은 DRAM과 NAND, HBM을 아우르는 글로벌 메모리 시장의 주역이며, 인텔과 AMD는 CPU 및 고성능 컴퓨팅 시장에서 경쟁하고 있다.

첨단 파운드리 영역은 대만 TSMC가 독보적인 입지를 점한 가운데 UMC, 글로벌파운드리스, 중국 HLMC가 공존하는 구조이다.

칩을 직접 생산하지 않고 설계만 전담하는 **팹리스 영역**에서는 GPU와 AI 가속기 시장을 장악한 엔비디아와 통신 및 ASIC 강자인 브로드컴, 퀄컴, 미디어텍이 시장을 주도하고 있다.

이들의 기반이 되는 **IP 및 EDA 영역**은 ARM, 케이던스, 시놉시스가 진입 장벽을 형성하고 있으며, 국내 시장에서는 디자인하우스인 가온칩스, 에이디테크놀로지, 팹리스인 LX세미콘, 제주반도체 등이 생태계를 뒷받침하고 있다.

웨이퍼 위에 미세한 회로를 형성하는 **전공정 단계**는 반도체의 성능을 결정짓는 핵심 밸류체인이다. 원재료인 **웨이퍼 제조 영역**은 일본의 신에츠와 섬코가 주도하며, 국내에서는 SK실트론이 소재 국산화의 축을 담당한다.

공정의 시작인 **포토공정**은 빛으로 회로를 그리는 리소그래피 장비의 ASML이 EUV 시장을 독점하는 가운데 니콘과 캐논이 경쟁 중이다. 포토 소재인 레지스트와 마스크는 호야, 도쿄오카공업이 강세이며 국내의 에스앤에스텍, 동진세미켐이 추격하고 있다.

불필요한 회로를 깎아내는 **식각 공정**은 램리서치와 도쿄일렉트론이, 박막을 입히는 **증착 공정**은 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)와 ASM이 글로벌 시장을 장악하고 있다. 국내 장비사인 주성엔지니어링과 원익IPS는 증착 영역에서, 피에스케이와 원익QnC는 식각 및 소모품 부문에서 국산화 장비와 소재를 공급하며 경쟁력을 키우고 있다.

또한 전공정의 수율을 결정하는 **검사·계측 영역**은 미국 KLA가 독점적 지위를 누리는 가운데 고영, 벅스틴, 파크시스템 등 국내 검사 장비사들이 웨이퍼 검사 및 3D 측정 시장에서 기술력을 다투고 있다.

칩의 제조를 마무리하고 **최종 완제품으로 패키징하는 후공정(OSAT) 단계**는 최근 HBM 수요 폭발에 따라 전략적 중요성이 급격히 부상한 밸류체인이다.

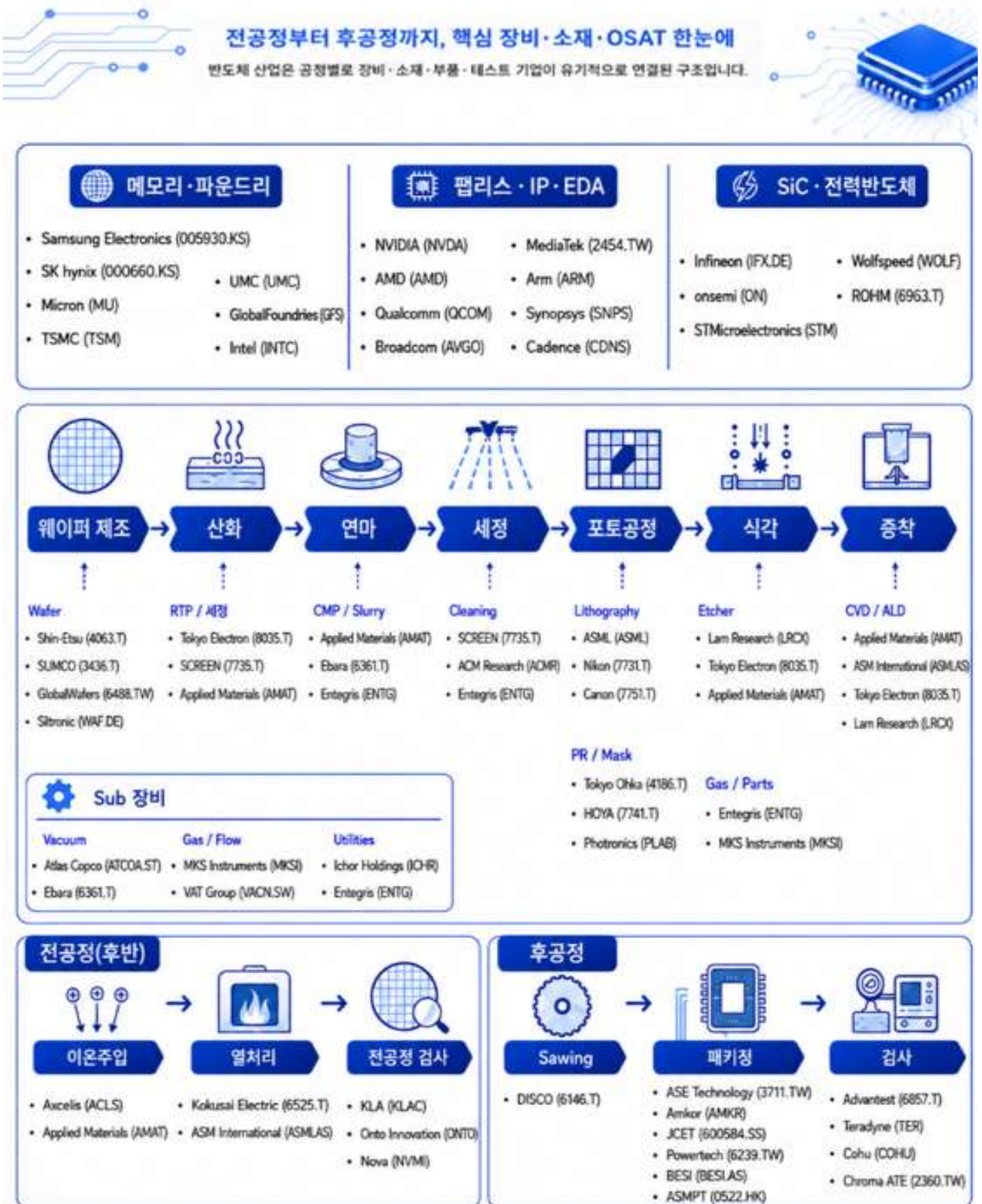
전통적인 2D 구조를 넘어 칩을 수직으로 적층하는 3D 구조와 첨단 패키징 기술이 핵심 경쟁력으로 안착했다. 글로벌 시장에서는 대만의 ASE를 필두로 중국 JCET, 미국 앰코가 대형 OSAT 시장을 과점하고 있으며, 국내에서는 하나마이크론, SFA반도체, 네패스가 패키징 생태계를 구성한다.

특히 AI반도체의 필수재인 **HBM 본딩 장비 영역**에서는 한미반도체가 다이아티와 함께 시장의 이목을 끌고 있으며, 패키징 기판 분야에서는 심텍과 해성디에스가 경쟁력을 발휘하고 있다.

마지막으로 불량 여부를 검증하는 **검사 및 테스트 단계**는 일본 아드반테스트와 미국 테라다인이 글로벌 장비 시장을 양분한 가운데, 국내의 와이씨, 디아이, 테크윙이 웨이퍼 테스터와 HBM 관련 핸들러 장비를 공급하며 국산화에 앞장서고 있다.

이처럼 반도체 밸류체인은 각 단계별 글로벌 리더들의 독점적 기술력과 국내 소부장 기업들의 국산화 노력이 유기적으로 맞물린 거대한 협력 체제이다.

[그림 24] 한장으로 읽는 글로벌 반도체 산업 밸류체인



글로벌 반도체 기업 밸류에이션 비교

독점적 기술력과 AI 수혜 여부에 따라 밸류에이션 양극화

글로벌 반도체 산업의 생태계는 독점적 기술력과 AI 수혜 여부에 따라 밸류에이션 양극화가 뚜렷한 구조이다. 파운드리 거두 TSMC 와 HBM 주도권을 쥔 SK 하이닉스, 마이크론은 압도적인 자본 효율성 (ROE)을 증명하며 시장을 리드하고 있다.

팹리스 영역의 엔비디아는 폭발적인 실적으로 고평가 우려를 불식시켰으며, 원천 IP 를 보유한 Arm Holdings 는 독점력을 무기로 높은 프리미엄을 누리는 중이다. 전공정의 ASML, 램리서치, KLA 및 후공정의 디스코, 아드반테스트 등 핵심 장비사들 역시 미세공정과 3D 적층 전환의 필수재로서 견고한 고 밸류에이션 체제를 공고히 유지하고 있다.

[표 1] 글로벌 반도체 기업 밸류에이션 비교

부 문	구 분	종목	시가총액 (십억 \$)	12개월 선행 (Fwd 12m)			
				PER	PBR	PSR	ROE
메모리 파운드리 팹리스 등	메모리 파운드리	Micron Tech.	1,101.8	6.6	4.0	6.6	71.6
		Kioxia Holdings	282.7	8.0	5.9	8.0	145.8
		Sandisk	258.4	9.0	5.9	9.0	76.0
		SK하이닉스	1,112.1	6.2	3.2	6.2	78.0
		삼성전자	1,164.3	5.5	2.2	5.5	49.9
		Intel Corp.	604.9	89.1	5.1	89.1	5.6
		TSMC	2,251.8	23.4	7.4	23.4	36.1
		United Micro Elec.	61.7	35.2	4.6	35.2	14.0
	팹리스 IP-EDA	NVIDIA	4,714.9	18.0	11.1	18.0	75.7
		Broadcom	1,714.9	20.8	10.9	20.8	55.8
		AMD	844.4	48.1	10.7	48.1	21.9
		Arm Holdings	336.7	128.2	29.5	128.2	20.9
		Marvell Tech.	214.6	48.1	11.1	48.1	20.6
		QUALCOMM	185.8	16.1	7.6	16.1	44.7
		Mediatek	210.6	41.9	13.7	41.9	35.2
		Cadence Design	102.9	42.4	13.2	42.4	27.9
		Synopsys	83.7	26.2	2.5	26.2	8.1
	SiC 전력반도체	Texas Instrument	266.7	34.2	14.3	34.2	41.2
		Analog Devices	183.7	26.5	5.3	26.5	22.3
		Infineon Tech.	115.5	31.1	4.9	31.1	15.5
		STMicroelectronics	60.8	35.3	3.1	35.3	8.7
전공정 (WFE) Wafer Fab Equipment	웨이퍼 제조	Shin Etsu Chem.	85.7	21.4	2.8	21.4	13.2
	포토공정	ASML Holding	681.9	40.5	22.6	40.5	57.0
		Hoya	53.8	31.4	8.2	31.4	27.1
		Entegris	22.4	34.8	4.6	34.8	13.3
	식각 공정	Applied Material	478.8	39.0	15.5	39.0	42.6
		Lam Research	439.5	43.5	24.8	43.5	71.2
		Tokyo Electron	212.5	41.2	12.8	41.2	34.8
	증착 공정	ASM International	55.0	38.6	8.7	38.6	24.4
	세정 공정	Screen Holdings	22.4	28.8	6.2	28.8	23.1
	전공정 검사	KLA	307.7	45.0	39.4	45.0	97.0
후공정 (OSAT)	OSAT	ASE Techn.	91.9	26.0	0.0	26.0	0.0
	패키징	Disco	51.5	43.4	11.2	43.4	27.3
	검사	Advantest	133.2	37.5	16.7	37.5	51.1

자료: FnGuide(Quantiwise), 핀릿 리서치센터, 7/3 종가 기준

**글로벌 반도체 투자
지형은 독점적 원천
기술을 확보했거나 3D
패키징 등 차세대 병목
공정을 해결해 줄 수
있는 핵심 공급망 구조**

현재 글로벌 반도체 밸류체인은 메모리·파운드리, 팹리스·IP, 전공정 장비, 후공정(OSAT) 체제로 다변화 되어 성장을 지속하는 구조이다.

주요 반도체 기업의 밸류에이션을 살펴보면 압도적 시가총액을 자랑하는 대만 TSMC 와 엔비디아가 중심축을 담당하고 있다. 고대역폭 메모리(HBM) 주도권을 확보한 SK 하이닉스와 마이크론은 독보적인 ROE 수준을 기록하며 강세를 나타내고 있다. 리소그래피 독점 기업인 ASML 을 필두로 램리서치, KLA 등 첨단 장비사들은 높은 진입 장벽 속에서 고밸류에이션을 형성하고 있다.

글로벌 반도체 생태계의 밸류에이션은 각 기업이 보유한 독점적 기술력과 시장 지배력을 정밀하게 반영하는 구조이다. 12 개월 선행(Fwd 12m) 밸류에이션 지표를 살펴보면 **최상단 밸류체인인 메모리 및 파운드리 부문에서는** 업황 회복과 AI 수요에 힘입어 뚜렷한 실적 개선세가 관측된다.

대만 파운드리 거두인 TSMC 는 시가총액 2 조 2,518 달러, PER 23.4 배, ROE 36.1%로 견조한 기초 체력을 과시하고 있다. 메모리 업계의 경우 차세대 고부가 시장을 선점한 SK 하이닉스가 PER 6.2 배, ROE 78.0%라는 매우 높은 자본효율성을 보여주고 있으며, 미국 마이크론 테크놀로지 역시 시가총액 1 조 1,018 억 달러에 ROE 71.6%를 달성해 전통적 강자인 삼성전자(PER 5.5 배, ROE 49.9%)와 비교해 자본 효율성 측면에서 우위를 선점하는 양상이다. 반면, 파운드리 재도전을 선언한 인텔은 PER 89.1 배에 ROE 5.6%로 다소 불안정한 가치 왜곡과 기술적 정체에 직면했음이 밸류에이션 지표에 나타나고 있다.

빅테크의 독점 무대인 **팹리스 및 IP·EDA 부문**은 가장 가파른 프리미엄을 부여받고 있는 지식 집약적 영역이다. AI 가속기 시장을 지배하는 엔비디아는 시가총액 4 조 7,149 억 달러에 달하는 거대한 덩치에도 불구하고 PER 18.0 배, ROE 75.7%라는 압도적 수익성을 보여주며 밸류에이션 부담을 실적으로 상쇄하고 있다. 통신 및 ASIC 강자 브로드컴(PER 20.8 배, ROE 55.8%) 역시 안정적인 가치를 인정받는 반면, AMD 는 PER 48.1 배로 상대적으로 높은 시장 기대감이 반영되어 있다.

설계 자산의 원천인 암 홀딩스(Arm)는 PER 128.2 배, PBR 29.5 배라는 극단적인 고평가 국면을 보여주는데, 이는 차세대 아키텍처 독점에 기반한 장기 지배력이 선반영된 결과라 할 수 있다. 시놉시스(PER 26.2 배)와 케이던스(PER 42.4 배) 등 EDA 소프트웨어사들도 대체 불가능한 도구로서 견고한 밸류에이션 안착에 성공했다. 전력 반도체 영역에서는 텍사스 인스트루먼트(PER 34.2 배)와 인피니언(PER 31.1 배)이 차량 및 인프라 전장화 추세를 타고 무난한 지표를 다지는 중이다.

공정 미세화의 열쇠를 쥔 전공정(WFE) 장비 군은 높은 진입 장벽을 무기로 자본시장의 강력한 신뢰를 반영하고 있다. 노광 공정 독점사인 네덜란드 ASML 은 시가총액 6,819 억 달러에 PER 40.5 배, ROE 57.0%로 시장을 리드하고 있으며, 미세화 공정의 파트너인 엔테그리스(PER 34.8 배)도 견조한 가격대를 다져가고 있다.

전공정의 핵심인 식각 및 증착 분야에서는 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 PER 39.0 배, ROE 42.6%로 균형 잡힌 실적을, 램리서치는 PER 43.5 배에 달하는 멀티플 속에서도 ROE 71.2%라는 초고수익 구조를 증명하며 장비 대장주의 위상을 굳건히 지키고 있다. 수율 관리의 독점적 지배자인 KLA 의 경우 PER 45.0 배, ROE 97.0%라는 경이적인 자본 효율성을 보여주며 전공정 장비 벨트의 핵심 보루임을 입증한다.

마지막으로 **패키징과 테스트를 아우르는 후공정(OSAT) 밸류체인**은 첨단 다이 적층 및 HBM 고도화에 힘입어 구조적 위상 격상을 일궈내는 단계이다. 글로벌 1 위 OSAT 사인 대만 ASE 테크놀로지는 시가총액 919 억 달러에 PER 26.0 배를 나타내며, 후공정 미세 절단 장비의 강자인 일본 디스코는 PER 41.4 배, ROE 27.3%로 전공정 수준의 프리미엄을 부여받고 있다. 최종 테스트 장비의 리더인 아드반테스트 역시 PER 37.5 배, ROE 51.1%로 가파른 성장 기대감을 숨기지 않고 있다.

결론적으로 **글로벌 반도체 투자 지형**은 단순한 대량 생산 능력을 넘어, 독점적 원천 기술을 확보했거나 3D 패키징 등 차세대 병목 공정을 해결해 줄 수 있는 핵심 공급망에 자본이 집중되는 압축 성장 구조를 명확히 보여준다.

글로벌 반도체 산업 주요 종목 최근 수익률 현황

기술 독점력과 AI 인프라 수혜 강도에 따라 주가 성과가 극명히 갈리는 구조

글로벌 반도체 밸류체인은 단기 숨고르기 속에서도 기술 독점력과 AI 인프라 수혜 강도에 따라 주가 성과가 극명히 갈리는 구조이다.

HBM과 고부가 메모리 시장을 선점한 마이크론, SK하이닉스, 키옥시아는 연초 대비 최대 3배에서 1년 전 대비 최고 8배 안팎의 기록적인 주가 상승을 연출하며 전체 생태계 상승을 견인하고 있다. 설계 영역의 엔비디아와 브로드컴이 단기 과열 해소 과정을 거치는 와중에 독점 IP를 쥐고 있는 애플 홀딩스와 AMD는 견고한 장기 랠리를 보존하는 중이다.

아울러 전공정의 핵심인 AMAT, 램리서치, ASML과 수율의 KLA, 그리고 첨단 패키징 및 테스트를 지배하는 ASE, 디스코, 아드반테스트 등 글로벌 탑티어 장비사들 역시 미세공정과 3D 적층 구조 전환의 대체 불가능한 필수재로서 구조적 우상향 상승 추세를 확고히 보여주고 있다.

[표 2] 글로벌 반도체 산업 주요 종목 최근 수익률

부 문	구 분	종 목	1주전	1개월전	3개월전	6개월전	1년전	연초대비
메모리 파운드리 팹리스 등	메모리 파운드리	Micron Tech.	-19.6	-8.3	166.4	209.3	701.4	241.8
		Kioxia Holdings	-9.6	6.7	281.2	698.3	3,169.2	698.3
		Sandisk	-25.3	1.7	148.7	534.0	3,676.2	635.1
		SK하이닉스	-9.3	2.8	176.8	258.2	770.7	272.5
		삼성전자	-8.8	-14.2	66.2	140.9	385.1	158.1
		Intel Corp.	-9.4	11.5	138.9	205.6	450.1	226.2
		TSMC	-0.2	-2.8	28.1	35.8	85.9	42.9
		United Micro Elec.	-11.5	9.3	183.0	213.0	212.2	212.2
	팹리스 IP-EDA	NVIDIA	-0.5	-12.6	9.8	3.2	23.9	4.5
		Broadcom	-4.9	-25.2	14.6	3.7	33.6	4.2
		AMD	-2.8	-0.7	138.1	131.7	273.8	141.8
		Arm Holdings	-9.3	-21.7	111.4	174.8	103.9	188.4
		Marvell Tech.	-12.8	-15.7	129.0	174.4	230.4	188.6
		QUALCOMM	-14.0	-26.8	39.0	1.9	8.6	3.0
		Mediatek	8.1	-7.7	186.4	185.4	230.3	193.4
		Cadence Design	1.3	-10.4	33.9	20.2	20.0	19.4
		Synopsys	-3.9	-14.0	10.4	-9.0	-16.4	-6.9
	SiC 전력반도체	Texas Instrument	-6.0	-4.9	50.4	65.1	35.9	68.9
		Analog Devices	-9.8	-10.9	18.5	37.8	53.9	39.1
		Infineon Tech.	-1.2	-12.1	98.6	102.2	109.6	105.1
		STMicroelectronics	-8.7	-14.0	99.2	149.7	115.6	163.5
전공정 (WFE) Wafer Fab Equipment	웨이퍼 제조	Shin Etsu Chem.	1.8	-10.9	7.9	42.8	44.3	42.8
	포토공정	ASML Holding	-3.9	3.8	34.3	52.0	121.3	65.4
		Hoya	1.4	-5.7	-6.0	9.5	53.2	9.5
		Entegris	-16.8	2.6	26.0	63.8	69.6	74.1
	식각 공정	Applied Material	-9.7	23.1	73.1	124.3	217.4	134.7
		Lam Research	-12.6	5.1	60.9	89.9	255.6	105.3
		Tokyo Electron	0.4	20.2	90.5	113.3	170.6	113.3
	증착 공정	ASM International	2.9	8.7	45.0	76.2	89.3	88.5
	세정 공정	Screen Holdings	14.5	41.9	106.1	148.6	224.7	148.6
	전공정 검사	KLA	-9.0	15.2	55.3	84.8	155.7	93.9
후공정 (OSAT)	OSAT	ASE Techn.	0.1	6.7	87.9	148.3	306.5	160.1
	패키징	Disco	-2.5	11.5	16.7	59.0	84.8	59.0
	검사	Advantest	-9.5	6.1	36.1	49.5	178.7	49.5

자료: FnGuide(Quantiwise), 핀릿 리서치센터, 7/3 종가 기준

AI 인프라 확산 기조 및 전방 산업의 수요 변화에 따른 기업별 모멘텀 강도를 투명

글로벌 반도체 생태계 전반의 주가 등락률은 최근 AI 인프라 확산 기조 및 전방 산업의 수요 변화에 따른 기업별 모멘텀 강도를 극명하게 투영하는 구조이다.

글로벌 주요 반도체 산업의 밸류체인 주가 변동율을 살펴보면 **최상단 밸류체인인 메모리 및 파운드리 부문에서는** 차세대 고성능 제품군의 수요 폭발 여부에 따라 주가 차별화가 극적으로 전개되었음이 확인될 수 있다.

특히 HBM 및 고부가 서버 제품 시장을 주도하고 있는 미국 마이크론 테크놀로지는 연초 대비 무려 241.8% 1년 전 대비 701.4%라는 경이로운 수익률을 기록하고 있으며, 키옥시아(연초 대비 698.3%)와 샌디스크(635.1%) 역시 강력한 낸드 업황 회복 세를 반영하며 폭발적인 주가 상승 랠리를 펼치고 있다.

한국의 SK하이닉스 역시 고부가 가치 HBM 메모리 리더십을 바탕으로 연초 대비 272.5%, 1년 전 대비 770.7% 상승하며 독보적인 장기 성과를 기록 중이다. 반면 상대적으로 가전 및 휴대폰 사업부문 등을 포함한 삼성전자는 연초 대비 158.1% 성장에 그치며 메모리 업체 대비 상대적인 탄력 둔화를 나타내고 있으며, 첨단 공정 지배자인 대만 TSMC는 연초 대비 42.9%, 1년 전 대비 85.90%의 상대적으로 완만한 우상향 흐름을 유지하며 대형주 특유의 견고한 시세를 형성하고 있다.

빅테크의 주 무대인 **팹리스 및 IP-EDA, 전력 반도체 부문**은 단기적인 숨고르기 양상 속에서도 핵심 설계 자산을 보유한 기업 위주로 장기 주가 상승 모멘텀이 압축되는 흐름이다.

AI 가속기 시장의 독점적 지배자인 엔비디아는 최근 1주 전(-0.5%), 1개월 전(-12.6%) 지표에서 보듯 단기 과열에 따른 차익실현 압박에 직면했으나, 연초 대비 4.5% 수준으로 고점에서 지지선을 다지는 중이다. 통신 및 ASIC 강자 브로드컴 역시 단기 조정세를 거치며 연초 대비 4.2% 수준을 나타내고 있다. 반면 후발 주자인 AMD는 고성능 컴퓨팅 기대감을 선 반영하면서 연초 대비 141.8%, 1년 전 대비 273.8%라는 높은 상승률을 보이고 있다.

설계 원천 자산(IP)의 거두인 암 홀딩스(Arm)는 독점적 생태계 장악력을 무기로 연초 대비 188.4%, 1년 전 대비 103.9% 상승하며 기술 프리미엄의 진가를 발휘하고 있다. 데이터센터 스토리지 칩의 마벨 테크놀로지 역시 연초 대비 188.6%의 가파른 시세를 보이고 있다. 한편 반도체 설계의 필수 소프트웨어인 시놉시스는 단기 조정 국면 속에 연초 대비 -6.9%로 다소 정체된 반면, 케이던스는 연초 대비 19.4%의 견조한 흐름을 지속하고 있다. SiC 전력 반도체 영역에서는 인피니언(연초 대비 105.1%)과 ST 마이크로일렉트로닉스(163.5%)가 차량용 전장화 파도를 타고 장기 우상향하는 모습을 보이고 있다.

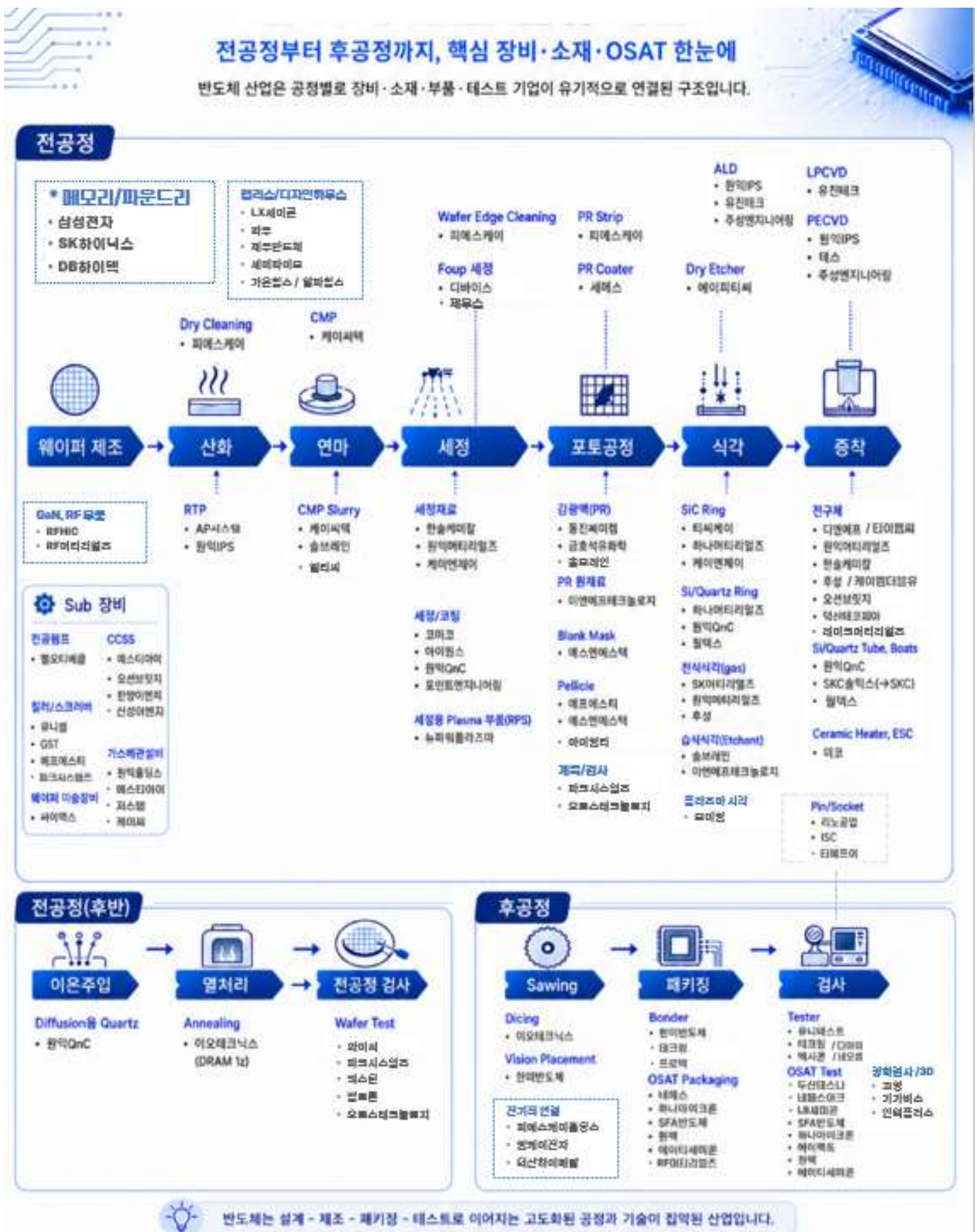
공정 미세화 및 적층 고도화의 수혜가 집중되는 전공정(WFE) 장비와 후공정(OSAT) 벨트는 전방 기업들의 인프라 투자 규모 확대에 힘입어 확고한 밸류에이션 리레이팅을 일궈내고 있다.

웨이퍼 제조 소재사인 신에츠화학이 연초 대비 42.8%의 완만한 흐름을 보이는 가운데, 전공정 장비의 핵심인 노광 공정 독점사 ASML은 1년 전 대비 121.3%, 연초 대비 65.4%라는 탄탄한 성장세를 유지 중이다. 특히 공정 난이도 상승의 직접적 수혜를 입는 식각 및 증착 분야의 리더들은 경이적인 성과를 보여준다.

어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 연초 대비 134.7%, 1년 전 대비 217.4% 상승했으며, 램리서치는 1년 전 대비 255.6%, 연초 대비 105.3% 상승해 후공정 적층 전환의 장비 대장주 위상을 공고히 했다. 도교일렉트론 역시 연초 대비 113.3%의 견조한 성과를 더했다. 아울러 수율 제어의 강자인 KLA는 연초 대비 93.9% 상승하며 전공정 생태계의 핵심 보루임을 재차 확인시켜 주었다.

마지막으로 후공정 밸류체인은 HBM 적층 및 패키징 중요성이 부각되며 위상이 완전히 격상되었다. 글로벌 OSAT 1위사인 대만 ASE 테크놀로지가 연초 대비 160.1%, 1년 전 대비 306.5%로 가파르게 치솟았으며, 미세 절단 장비사 대장주인 일본 디스코는 연초 대비 59.0%, 최종 불량 여부를 가려내는 테스트 장비 선도사 아드반테스트는 1년 전 대비 178.7%, 연초 대비 49.5% 상승해 장기 투자 매력도가 극대화된 구조이다.

[그림 25] 한장으로 읽는 한국 반도체 산업 밸류체인



자료: 핀릿 리서치센터, ChatGPT 5.5 로 재구성

한국 반도체 산업 밸류체인 분석

한국 반도체 산업 생태계는 칩메이커를 시발점으로 설계, 제조인프라, 전공정 장비 및 소재, 그리고 후 공정(OSAT) 부문까지 촘촘한 그물망을 형성하며 자본시장의 강력한 자금력을 흡수하는 구조이다.

한국 반도체 산업의 밸류체인의 최상단이자 기둥 역할을 수행하는 설계·칩메이커 단계는 메모리 파운드리, 디자인하우스, 팹리스, IP 부문으로 세분화되어 전방 생태계를 리드하고 있다.

특히 업계 양대 거두인 삼성전자와 SK 하이닉스가 독보적인 시가총액 규모로 시장의 기저 체력을 형성한 가운데, 팹리스와 파운드리를 연결하는 가온/알파칩스, 에이디테크놀로지 등 디자인하우스 연합군이 뒤를 받친다.

아울러 모바일 메모리와 SSD 컨트롤러 칩에 특화된 파두, 제주반도체 같은 팹리스 부문과 온디바이스 AI 자산을 보유한 오픈엠티테크놀로지 등 IP 부문이 지식집약적 고부가가치를 창출하며 투자 매력도를 키우는 양상이다.

반도체 칩 생산의 환경적 토대와 원자재를 책임지는 제조인프라 및 전공정(WFE) 장비·소재 부문은 공정 미세화 추세에 따라 자본의 집중 투자가 이어지는 영역이다.

제조인프라 중 클린룸 부문의 한양이엔지, 신성이엔지와 유틸리티·환경설비 영역의 원익홀딩스, 에스티아이, GST, 유니셈 등은 공장 증설의 직접적인 수혜를 입으며 견조한 체급을 형성하고 있다. 실질적인 제조가 일어나는 웨이퍼 Fab 장비 부문에서는 공정별 리더들의 입지가 뚜렷하다. 웨이퍼 기초소재의 SK 실트론을 선두로, 산화·열처리 공정의 HPSP가 고압 어닐링 독점력을 무기로 막강한 가치를 입증했으며 포토공정의 주성분인 PR 및 블랭크 마스크 부문의 동진세미켐과 에스앤에스텍이 소재 국산화의 주역으로 활약 중이다.

특히 증착·식각 공정은 장비 단가가 높고 기술 진입 장벽이 가파른 전공정의 핵심 전장이다. 증착 부문에서는 주성엔지니어링과 원익 IPS가 거대한 덩치를 자랑하며, 식각 부문에서는 브이엠이 플라스마 식각 영역에서 두각을 나타낸다. 식각 소모품인 SiC 링과 쿼츠를 공급하는 하나머티리얼즈와 원익 QnC 역시 전공정 생태계의 실질적인 현금창출원 역할을 수행하고 있다.

더불어 금속배선 공정의 케이씨텍, 세정장비 부문의 제우스와 디바이스, 세정·코팅·케미컬의 코미코와 퓨릿 등 조연들의 활약도 눈부시다.

최종 완제품의 성능과 신뢰성을 최종 결정짓는 후공정(OSAT) 밸류체인은 최근 고대역폭 메모리(HBM) 및 3D 적층 패키징 혁명과 맞물리며 전공정 장비 군을 능가하는 강력한 프리미엄 영역으로 격상되었다. 후공정은 크게 웨이퍼 테스트, 절단 및 본딩, 전기적 연결, 패키징 가공, 최종 패키지 검사 단계로 나뉜다.

이 중 본딩 및 HBM 적층 칩 접착 부문의 한미반도체는 독보적인 시가총액 규모를 달성하며 후공정 전체 생태계의 대장주 위상을 공고히 다졌다. 이와 함께 웨이퍼 테스트 장비의 와이씨, 테스트 핸들러의 테크윙, 테스트 소켓 부문의 리노공업과 ISC가 웨이퍼 테스트 시장의 고성능화를 주도하며 조 단위 몸값을 형성하고 있다.

프로브카드 부문의 티에스이, 리플로우 장비의 피에스케이홀딩스, 엠케이전자 역시 든든한 기술 축이다. 최종 조립 및 밀봉을 담당하는 OSAT 패키징 파트에서는 하나마이크론, SFA반도체, 네패스가 대규모 임가공 기지로서 허리를 지탱하며, 마지막 관문인 패키지 검사 영역에서 고영과 기가비스가 3D AOI 광학 검사 기술력을 무기로 가파른 밸류에이션 리레이팅을 이끌어내고 있다.

패키지 테스트 영역의 두산테스나, 네패스아크의 실적 가시성도 매우 높다. 결론적으로 한국 반도체 투자 지형은 단순 제조를 넘어 핵심 전·후공정 장비와 고부가 가치 소재를 국산화한 공급망 리더 기업 중심의 압축 성장이 지속되는 구조이다.

한국 주요 반도체 밸류체인 기업 밸류에이션 비교

독점적 원천 기술의 보유 여부와 AI 인프라 수혜 강도에 따라 밸류에이션 차별화

한국 반도체 생태계는 독점적 원천 기술의 보유 여부와 AI 인프라 수혜 강도에 따라 밸류에이션 차별화가 극명하게 전개되는 구조이다.

HBM 주도권을 쥔 SK 하이닉스, 후공정 대장주인 한미반도체는 압도적인 자본 효율성을 입증하며 시장 프리미엄을 독식하고 있다. 또한 전공정의 HPSP, 주성엔지니어링, 후공정의 리노공업, 기가비스 등 핵심 장비·소재사들 역시 미세공정 및 3D 적층 구조 전환의 대체 불가능한 필수재로서 견고한 밸류에이션 체제를 공고히 유지하고 있다.

[표 3] 한국 주요 반도체 밸류체인 기업 밸류에이션 비교

부 문	구 분	종 목	시가총액 (십억원)	12개월 선행 (Fwd 12m)				비 고
				PER	PBR	PSR	ROE	
설계 칩메이커 제조인프라	메모리 파운드리	삼성전자	1,809,423.2	5.5	2.2	2.0	49.9	파운드리
		SK하이닉스	1,728,303.2	6.2	3.2	3.5	78.0	
		DB하이텍	5,251.0	13.2	1.9	3.0	16.0	
	설계 디자인	파두	3,988.1	43.6	29.0	7.3	102.1	SSD 컨트롤러 디자인하우스 IP
		에이디테크놀로지	401.2	13.1	1.6	1.1	14.1	
		칩스앤미디어	268.4	25.5	3.1	7.6	12.7	
	화학물 반도체 등	RFHIC	1,534.8	27.9	3.7	4.6	14.2	RF부품
		RF머트리얼즈	420.5	25.8	5.7	3.1	24.3	
전공정 (WFE) Wafer Fab Equipment	장비부품	한솔아이원스	367.0	7.3	1.3	1.4	19.5	공정장비
	산화, 열처리	HPSP	3,991.6	29.9	9.0	13.3	34.1	고압어닐링
	프토소재 CMP 슬러리	솔브레인	2,508.6	14.3	1.9	2.0	14.4	
		한솔케미칼	2,890.9	15.0	2.1	2.6	15.8	
	프토공정	이엔에프테크놀로지	587.9	7.9	1.1	0.7	14.3	
	식각공정 Etching	브이엠	2,524.3	26.0	8.1	6.4	36.9	플라즈마 애싱, 스트립
		피에스케이	5,280.6	30.3	6.9	6.7	25.2	
		티씨케이	2,739.0	21.2	4.1	5.9	20.6	쿼츠, 세라믹
		하나머티리얼즈	1,141.2	12.2	1.9	2.6	16.9	
	증착공정 Deposition	원익QnC	820.2	10.9	1.4	0.7	13.4	ALD, PECVD PECVD LPCVD PECVD 증착 가스
		주성엔지니어링	8,952.3	87.5	12.1	16.0	14.9	
		원익IPS	6,533.1	31.7	5.1	4.3	17.6	
		유진테크	3,932.4	38.0	6.4	6.8	18.5	
	세정, 클리닝	테스	3,432.5	30.3	5.9	6.3	23.3	
		원익머트리얼즈	460.8	6.6	0.8	1.0	12.0	
	검사, 계측	코미코	1,616.9	20.8	4.3	1.9	23.1	
		파크시스템스	1,820.6	30.3	5.5	6.4	20.0	
후공정 (OSAT) Outsourced Semiconduct or Assembly & Test	웨이퍼 테스트	넥스틴	481.4	17.3	2.6	3.4	15.9	
		와이씨	988.7	23.7	2.3	2.3	10.1	장비
		디아이	699.0	15.9	3.2	1.0	22.3	메모리, SSD
		유니테스트	234.4	6.3	1.6	0.7	28.7	메모리, SSD
		리노공업	5,990.3	28.3	6.5	11.3	24.6	소켓
		ISC	3,539.9	32.1	5.3	9.0	17.7	소켓
	절단(Dicing)	티에스이	2,776.4	17.5	4.5	3.6	29.4	프로브카드
		이오테크닉스	4,835.4	33.1	5.5	8.0	17.9	레이저
		본딩/접착	22,160.1	49.7	18.4	21.2	43.6	HBM 본딩
		한미반도체	3,102.8	19.6	4.5	8.9	25.0	패키지 접합
	전기적연결 Interconnection	피에스케이홀딩스	488.5	19.0	2.0	1.3	11.1	솔더볼, 와이어
		덕산하이메탈	4,836.6	25.7	5.8	2.2	24.9	리드프레임
		심텍	1,031.9	11.8	1.5	1.1	13.8	리드프레임
		해성디에스	2,729.0	15.9	4.0	1.1	29.7	OSAT
	밀봉 Encapsulation	하나마이크론	888.1	30.4	1.7	1.4	5.8	OSAT
		SFA반도체	2,053.0	38.7	5.0	5.7	14.1	3D
패키지검사	고영	기가비스	2,116.9	51.8	8.4	13.5	16.7	FC-BGA
	패키지테스트	인텍플러스	667.1	33.4	9.4	4.7	31.9	
		두산테스나	2,077.7	27.9	3.9	4.4	14.7	신뢰성 평가
		네패스아크	412.4	16.2	2.0	2.7	13.1	

자료: FnGuide(Quantiwise), 핀릿 리서치센터, 7/3 일 종가 기준

**반도체 산업 생태계는
칩메이커를 시발점으로
설계, 제조인프라,
전공정 장비 및 소재,
그리고 후공정 부문까지
촘촘한 공급망**

한국 반도체 산업 생태계는 칩메이커를 시발점으로 설계, 제조인프라, 전공정 장비 및 소재, 그리고 후공정 부문까지 촘촘한 공급망 연쇄를 형성하며 자본시장의 거대한 자금을 흡수하는 구조이다.

한국 주요 반도체 밸류체인 12개월 선행 밸류에이션 지표를 분석하면, 밸류체인의 최상단인 설계·칩메이커 단계는 메모리 파운드리, 설계 디자인, 화합물 반도체 등으로 세분화되어 성장을 주도하고 있다.

삼성전자와 SK 하이닉스가 압도적인 자본 효율성(ROE 각각 49.9%, 78.0%)을 무기로 생태계의 견고한 기둥을 형성한 가운데, 파운드리 전문 기업인 DB하이텍이 PER 13.2 배로 균형을 맞추고 있다.

설계 디자인 영역에서는 SSD 컨트롤러 칩에 특화된 파두가 ROE 102.1%라는 가공할 수준의 고효율성을 증명하고 있으며, 디자인하우스인 에이디테크놀로지(PER 13.1 배)와 IP 전문인 칩스앤미디어가 지식 집약적 부가가치를 창출 중이다.

아울러 화합물 반도체의 RFHIC와 부품사인 RF 머트리얼즈, 공정장비 부품사인 한솔아이원스(PER 7.3 배), 그리고 고압 어닐링 장비 독점력을 보유한 HPSP가 PER 29.9 배, ROE 34.1%의 뛰어난 지표를 차지하며 제조인프라의 핵심 축으로 활약하고 있다.

실질적인 회로 형성이 이루어지는 **전공정 장비 및 소재 부문**은 공정 미세화 추세에 따라 자본의 집중 투자가 지속되는 영역이다.

포토소재와 CMP 슬러리 영역의 솔브레인과 한솔케미칼이 각각 PER 15.0 배로 안정적인 단가를 유지하는 가운데, 포토공정의 이엔에프테크놀로지(PER 7.9 배)가 가격 매력도를 확보하고 있다.

식각 공정은 진입 장벽이 높은 전공정의 핵심 전장이다. 플라즈마 기술의 브이엠, 애싱·스트립 장비의 피에스케이(ROE 25.2%), 소모품 군인 티씨케이, 하나머트리얼즈, 원익 QnC(PER 10.9 배) 등이 확고한 캐시카우 역할을 수행하고 있다.

증착 공정은 장비 단가가 높고 고도의 기술력이 집중된 분야로, ALD와 PECVD를 공급하는 주성엔지니어링(PER 87.5 배)을 비롯해 원익 IPS(PER 31.7 배), LPCVD의 유진테크, 테스, 증착 가스의 원익머트리얼즈(PER 6.6 배)가 치열한 기술 경합을 벌이고 있다.

여기에 **세정 부문의** 코미코(PER 20.8 배)와 **검사·계측 영역의** 파크시스템스(ROE 20.0%), 넥스틴이 전공정 수율의 보루 역할을 충실히 수행하고 있다.

최종 **칩의 부가가치를 결정하는 후공정 밸류체인**은 최근 HBM 및 첨단 패키징 혁명과 맞물려 전공정 못지않은 프리미엄 영역으로 격상되었다.

후공정은 웨이퍼 테스트, 절단, 본딩, 전기적 연결, 밀봉, 패키지 검사 및 테스트 단계로 유기적으로 연결된다. 특히 **HBM 본딩 장비 시장을 지배하는 한미반도체**는 독보적인 체급과 함께 PER 49.7 배, PBR 18.4 배라는 높은 멀티플을 부여받고 있다.

웨이퍼 테스트 마켓에서는 소켓 분야의 리노공업(ROE 24.4%)과 ISC, 프로브카드의 티에스이, 테스트 장비의 와이씨, 디아이, 유니테스트(PER 6.3 배)가 지배력을 다지고 있으며, 레이저 절단 장비의 이오텍크닉스(PER 33.1 배)가 뒤를 받친다.

전기적 연결재를 다루는 패키지 접합의 피에스케이홀딩스(ROE 25.0%), 덕산하이메탈, 리드프레임의 신텍과 해성디에스(PER 11.8 배)의 탄탄한 입지도 돋보인다.

마지막으로 조립·밀봉을 담당하는 하나마이크론(ROE 29.7%), SFA 반도체 등 OSAT 파트와 패키지 검사의 고영, 기가비스(PER 51.8 배), 인텍플러스, 그리고 최종 신뢰성을 검증하는 두산테스나와 네패스아크가 후공정 고도화를 완벽히 지탱하고 있다.

따라서 자본수익률(ROE) 지표가 증명하는 압도적 독점력과 AI 가속기 시장의 수혜 강도를 정밀하게 비교하여 핵심 종목을 선별, 압축해 나가는 전략이 중요하다.

한국 주요 반도체 밸류체인 기업 수익률 비교

생성형 AI 인프라 확산
기조와 핵심 반도체
소부장 국산화 진척도에
따라 기업별 모멘텀
강도가 극명하게 갈리는
차별화 양상

한국 반도체 산업 생태계는 칩메이커를 시발점으로 설계, 제조인프라, 전공정 장비 및 소재, 그리고 후 공정 부문까지 유기적으로 맞물린 촘촘한 공급망 연쇄를 형성하며 자본시장의 거대한 자금을 흡수하는 구조이다.

또한 국내 반도체 전방 산업의 생성형 AI 인프라 확산 기조와 핵심 소부장(소재·부품·장비) 국산화 진척도에 따라 기업별 모멘텀 강도가 극명하게 갈리는 차별화 양상이 전개되고 있다.

밸류체인의 최상단이자 허리 역할을 담당하는 설계 및 칩메이커 부문에서는 고부가가치 가속기 메모리 시장의 주도권을 확보한 대형 제조사와 특화된 팹리스 기업 중심으로 압도적인 자본 집중 현상이 관측된다. 업계 대장주인 SK하이닉스가 연초 대비 272.5%, 1년 전 대비 770.7%라는 경이적인 주가 폭등을 기록하며 반도체 생태계 우상향을 견인하는 가운데, SSD 컨트롤러 마켓에 특화된 파두(연초 대비 274.6%)와 모바일 및 저전력 메모리의 제주반도체(247.3%)가 폭발적인 가치 성장을 증명하고 있다.

반면 스마트폰이나 범용 소비자 가전 주기 의존도가 높은 아날로그, 차량용 센서, 디스플레이 구동칩 기반의 팹리스 군과 IP, 디자인하우스 부문은 전방 수요의 단기 숨고르기와 맞물려 연초 대비 마이너스 수익률을 기록하는 등 완연한 조정 국면을 지나고 있다. 그리고 제조의 물리적 토대를 이루는 **제조인프라 및 전공정(WFE) 장비·소재 부문**은 나노 단위의 공정 미세화 한계 돌파를 위한 핵심 전장으로서 기술 리더십을 갖춘 공급사들의 밸류에이션 리레이팅이 돋보인다.

원자재인 웨이퍼 제조를 담당하는 SK(실트론, 비상장 자회사)가 SK하이닉스 지분법 증가와 비상장 자회사 SK실트론의 호 실적에 기인하여 연초 대비 169.0%의 견조한 주가 랠리를 펼치며 공급망의 든든한 버팀목이 된 상황에서, 유틸리티 및 환경설비 부문의 진공펌프 제조사 저스텝(연초 대비 108.4%), 케이씨(22.8%) 등도 공장 증설 기조에 힘입어 견고한 지지선을 형성했다.

실질적인 회로 형성이 이루어지는 **전공정 핵심 장비 부문에서는** 독점적 지위를 확보한 핵심 장비 기업 중심의 강세가 이어지고 있다. 산화·열처리 공정에서 고압 어닐링 원천 기술을 쥔 HPSP가 연초 대비 44.8% 상승했으며, 증착 공정의 대장주인 주성엔지니어링은 무려 595.3%, 원익 IPS는 96.0% 폭등하여 전공정 생태계의 자본 확장을 주도하고 있다.

아울러 식각 공정의 브이엠(237.4%)과 피에스케이(394.0%), 그리고 식각 필수 소모품인 SiC 포커스 링을 다루는 티씨케이(72.3%)와 하나머티리얼즈(33.9%), 쿼츠·세라믹 부문의 원익 QnC(45.5%) 역시 견고한 현금창출원(캐시카우)으로서의 매력을 과시 중이다. 반면 전공정 검사·계측 부문의 파크시스템스(연초 대비 24.4%)와 넥스틴(-36.1%)은 일시적인 탄력 둔화를 보였다.

최종 칩의 성능과 부가가치를 결정짓는 **후공정(OSAT) 밸류체인**은 최근 HBM 및 첨단 패키징 혁명과 정면으로 맞물리며 전공정 장비 군을 가볍게 능가하는 가파른 프리미엄 영역으로 격상되었다. 후공정 부문은 웨이퍼 테스트, 절단, 본딩, 패키징 가공, 최종 신뢰성 검증 단계로 촘촘히 세분화되어 전방 빅테크 수요를 흡수한다. 이 중 본더 및 HBM 적층 칩 접착 부문의 독보적 1위사인 한미반도체는 연초 대비 82.5%, 1년 전 대비 144.0% 급등하며 후공정 전체 생태계 내 핵심 종목으로서 위상을 강화했다.

웨이퍼 테스트 마켓에서는 프로브카드의 티에스이(연초 대비 335.8%) 그리고 패키지 접합 소재를 다루는 피에스케이홀딩스(210.8%)가 기록적인 수익률을 달성해 자본시장에서 강한 수급 유입이 나타나는 양상이다.

리드프레임 및 패키지 기판 부문의 심택(연초 대비 161.6%)과 해성디에스(9.0%) 역시 탄탄한 입지를 자랑하며, 조립·밀봉을 담당하는 OSAT 파트의 하나마이크론(59.4%)이 허리를 견고히 지탱하고 있다.

마지막 관문인 패키지 검사 영역에서는 기가비스(연초 대비 430.2%)와 고영(31.4%)이 3D AOI 광학 기술력을 무기로 랠리를 펼치고 있으며 신뢰성 평가 부문의 두산테스나(연초 대비 102.1%)와 네패스아크(99.1%)가 후공정 고도화의 마침표를 찍고 있다.

[표 4] 한국 주요 반도체 칩메이커, 설계, 제조 인프라 기업 수익률 비교

대분류	중분류	소분류	주요내용	종목	시가총액 (십억원)	1주	1개월	3개월	6개월	1년	연초이후
 설계 /칩메이커 제조인프라	칩메이커	메모리 파운드리	DRAM, NAND, HBM 등 메모리 핵심 제조사	삼성전자	1,809,423.2	-8.8	-14.2	66.2	140.9	385.1	158.1
				SK하이닉스	1,728,303.2	-9.3	2.8	176.8	258.2	770.7	272.5
			8인치 기반 파운드리 중심	DB하이텍	5,251.0	-23.8	-29.0	33.2	63.8	161.0	78.6
	설계	디자인 하우스	팹리스와 파운드리 사이 설계·검증·양산 연계	세미파이브	697.5	-1.2	-48.1	-12.0	-31.0	-	-22.6
				가온칩스	443.4	1.1	-29.7	-39.7	-29.1	-21.5	-27.6
				에이디테크놀로지	401.2	10.4	-23.0	-47.1	-10.6	44.7	-12.0
				에이직랜드	223.4	-1.7	-34.8	-24.0	-30.1	-37.8	-28.5
				알파칩스	66.4	10.2	-25.2	-40.6	15.6	4.0	15.8
		팹리스 Fabless	디스플레이 구동칩	LX세미콘	638.4	2.8	-26.9	-20.4	-22.0	-41.1	-20.1
				아나패스	184.9	-0.3	-13.7	-10.8	-11.3	-15.2	-12.1
			모바일 메모리 SSD 컨트롤러 등	파두	3,988.1	-4.1	-25.7	57.6	274.6	475.6	274.6
				제주반도체	3,151.5	-7.8	-9.4	137.7	198.5	469.0	247.3
		IP Semiconductor	온디바이스 AI, 영상처리, 인터넷 IP	피델릭스	167.3	12.7	-10.1	369.8	339.5	314.3	357.4
				오픈엠티테크놀로지	293.0	4.7	-26.6	-23.0	-28.5	-22.6	-22.5
				칩스앤미디어	268.4	12.0	-15.8	-18.6	-32.2	-27.1	-30.4
				퀄리카스반도체	130.4	-9.6	-37.7	-35.2	-40.3	-39.3	-38.9
		차량용 센서 팹리스	차량용 반도체 이미지센서, 터치·RF 칩	동운아나텍	661.8	5.7	-20.0	9.1	10.7	71.2	10.3
				텔레칩스	157.2	5.0	-24.1	-12.5	-36.0	-25.7	-35.0
				넥스트칩	79.8	-4.5	-39.4	-34.5	-40.4	-45.4	-40.3
 제조 인프라	클린룸 Cleanroom	클린룸 공조 환경 제어		한양이엔지	609.0	28.4	16.0	20.4	54.0	89.2	63.0
				신성이엔지	365.9	4.0	-17.2	-47.7	11.2	16.7	13.4
				케이엔솔	122.3	14.3	-19.4	-9.6	-23.9	-26.3	-20.9
				성도이엔지	147.7	10.2	12.5	4.0	51.7	102.3	61.6
	유틸리티 / 환경설비	진공펌프 케미컬 중앙공급장치 N2 퍼지		원익홀딩스	1,469.1	-5.4	-25.9	-29.2	-60.1	213.3	-60.9
				에스티아이	445.1	15.0	6.3	-2.1	-13.8	49.9	-5.8
				저스팀	277.0	-9.9	-18.6	97.6	117.0	233.7	108.4
				케이씨	344.9	8.1	2.8	4.3	17.9	24.7	22.8
				엘오티베콤	175.8	6.8	-12.0	-18.4	-25.9	-2.8	-20.4
				씨엔지하이테크	128.1	5.4	-10.8	-17.7	-22.9	3.1	-17.1
	Abatement Chiller	스크러버·칠러, 배기 가스 처리 온도제어		GST	911.4	4.8	2.6	91.3	62.7	147.4	71.4
				유니셈	291.0	7.5	-6.0	8.1	-8.4	49.2	-1.8
유통 디스크리트	반도체 유통 개별소자	반도체 유통 개별소자	반도체 유통 전력·디스크리트 소자	미래반도체	257.4	-3.1	-32.5	9.1	3.9	0.9	9.5
				KEC	138.9	-1.6	-27.5	-56.2	-4.3	-15.9	-0.6
 화합물·RF	GaN RF 패키징	GaN RF, 통신·방산용 RF 부품		RFHIC	1,534.8	-4.6	-29.9	-35.1	64.9	123.2	77.0
				RF머트리얼즈	420.5	-4.8	-34.3	-34.2	96.8	746.4	120.0
 배관·피팅 정밀부품	배관·피팅 정밀부품	공정장비, 부품 배관·피팅		한솔아이원스	367.0	0.9	5.3	2.4	4.8	37.7	8.9
				아스플로	254.0	-0.3	13.3	230.7	272.8	379.3	299.8

자료: FnGuide(Quantwise), 핀릿 리서치센터, 7/3 일 종가 기준

[표 5] 한국 주요 반도체 전공정(산화, 포토, 식각, 증착, 금속배선, 세정, 검사) 기업 수익률 비교

대분류	중분류	소분류	주요내용	종목	시가총액 (십억원)	1주	1개월	3개월	6개월	1년	연초이후
전공정 WFE / Wafer Fab Equipment	웨이퍼제조	웨이퍼·기초소재	Chem/Wafer/Holding	SK(실트론)	50,026.9	-15.3	3.3	120.8	166.4	234.1	169.0
	산화·열처리 Oxidation- Annealing	고압 어닐링	고압수소 어닐링 장비	HPSP	3,991.6	-8.0	9.9	15.5	40.8	73.8	44.8
		히터·열처리 부품	히터, 세라믹 부품 / 열처리 장비 부품	미코	575.8	-0.8	-25.7	31.0	25.5	20.0	28.8
				메카로	390.9	-9.6	3.0	0.9	60.5	247.1	66.7
	전공정 소재	증착 케미칼·슬러리	식각, 세정CMP / 포토 전반	솔브레인	2,508.6	-3.2	-10.9	-14.3	15.6	71.9	23.1
				한솔케미칼	2,890.9	1.0	5.0	-0.8	9.4	53.9	15.4
	포토공정 Photolithography	포토 케미컬	PR, 현상액, 세정액, 식각액 등	동진세미랩	2,579.1	-8.0	-2.3	10.0	27.6	53.3	38.1
				아이에프테크놀로지	587.9	-5.2	-0.4	-9.9	-16.8	5.8	-12.5
				와이씨켄	215.2	5.6	-23.2	-8.1	0.6	-15.9	5.4
				경인양행	139.4	0.2	-25.4	-16.3	-33.1	-0.7	-31.3
		EUV 마스크·렐리클	블랭크마스크, 랙리클, EUV 마스크 베이킹	에스엔에스텍	1,061.4	-3.0	-22.4	-35.7	-3.0	7.6	3.0
				에프에스티	518.5	-1.2	-20.2	-35.3	-24.5	13.9	-21.9
				아이엘티	85.4	-8.2	-10.7	-7.1	5.7	7.4	12.8
				오로스테크놀로지	180.9	-1.4	-19.4	-34.5	-27.4	-5.6	-24.0
				브이엠	2,524.3	-5.3	88.0	145.8	234.1	713.3	237.4
				뉴파워프라이즈	369.6	19.7	-4.0	65.9	48.4	62.7	63.6
	식각공정 Etching	식각 장비	플라즈마 식각 장비	피에스케이	5,280.6	-3.1	101.2	139.9	368.6	825.4	394.0
				티씨케이	2,739.0	-2.6	-2.4	15.3	67.7	129.0	72.3
				하나머티리얼즈	1,141.2	-1.7	-1.0	4.9	27.2	117.7	33.9
				웰덱스	475.5	5.7	17.1	3.2	29.7	23.6	33.6
		식각 소모품	SiC 포커스링, 쿼츠, 실리콘 부품	케이엔제이	226.7	0.5	-5.0	-11.0	22.0	62.2	30.8
				비씨엔씨	147.8	-2.0	-13.0	-10.3	-19.7	27.1	-14.9
				원익QnC	820.2	-4.3	3.3	5.6	36.8	66.6	45.5
				샘씨엔에스	734.7	2.6	-2.6	32.6	75.0	148.0	81.3
		쿼츠·세라믹	쿼츠웨어, 세라믹 STF	주성엔지니어링	8,952.3	16.3	-2.2	209.7	532.5	510.5	595.3
				원익IPS	6,533.1	-18.7	36.0	17.3	66.4	359.8	96.0
	증착공정 Deposition	CVD·ALD· LPCVD 장비	박막 형성 장비	유진테크	3,932.4	-0.6	43.2	43.2	100.5	298.6	128.8
				테스	3,432.5	-3.3	69.5	196.0	233.3	561.6	298.0
				후성	1,554.1	-11.7	37.0	62.4	95.8	191.8	92.4
				레이크머티리얼즈	906.4	1.9	-20.5	-27.3	-3.8	8.6	-6.5
		전구체·특수가스	증착용 전구체, 특수가스	원익머티리얼즈	460.8	-2.9	-10.4	-8.9	6.4	62.1	18.3
				티아엠씨	224.1	-11.5	-48.6	-22.2	22.3	38.3	33.6
				덕산테크피아	229.3	1.3	-31.3	-37.5	-32.5	-31.6	-33.8
				디엔에프	166.3	6.4	-19.7	-25.7	-15.5	17.8	-8.0
				제이아이테크	108.0	2.7	-1.6	-25.9	-1.1	-8.3	4.6
				케이엔더블유	724.0	-5.0	-51.0	-39.8	8.5	30.3	19.2
	금속배선 공정 Metallization	CMP·슬러리	평탄화 장비, 슬러리·케미컬	케이씨텍	2,150.1	31.3	81.9	153.2	158.9	283.8	173.9
				엘티씨	571.5	32.1	30.5	80.3	165.2	340.2	181.9
		세정 장비	웨이퍼·디스플레이 세정 장비	제우스	308.0	5.6	-11.3	-31.9	-34.2	-23.6	-32.7
				디바이스	190.4	1.7	-37.3	27.6	86.6	142.6	95.6
	세정공정 Cleaning	세정·코팅·케미컬	부품 세정·코팅, 세정액	코미코	1,616.9	-11.0	-13.4	35.8	63.0	114.9	74.8
				퓨릿	138.5	2.7	-12.9	-0.6	-16.1	22.5	-8.3
	검사·계측	웨이퍼 검사	웨이퍼 결함, 검사, 계측, 3D 검사	파크시스템스	1,820.6	7.7	-5.5	10.4	16.1	-11.6	24.4
				넥스틴	481.4	4.9	-26.4	-30.4	-37.5	-9.4	-36.1
				팜트론	407.5	2.5	-0.1	-5.7	17.9	35.2	23.3

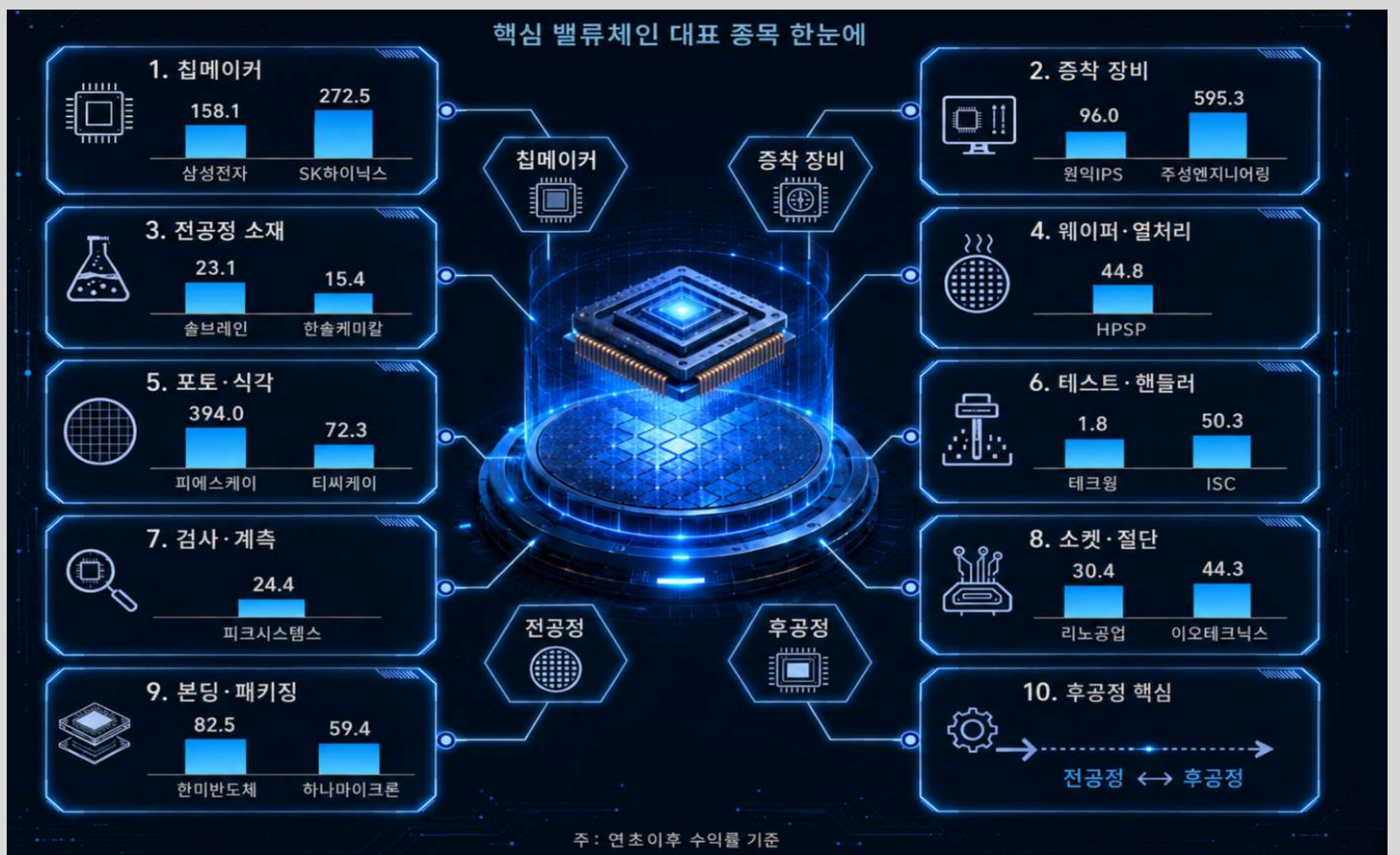
자료: FnGuide(Quantwise), 핀릿 리서치센터, 7/3 일 종가 기준

[표 6] 한국 주요 반도체 후공정(웨이퍼 테스트, 절단, 본딩, 연결, 밀봉, 패키징 검사 & 테스트) 기업 수익률 비교

대분류	중분류	소분류	주요내용	종목	시가총액 (십억원)	1주	1개월	3개월	6개월	1년	연초이후
후공정 OSAT Outsourced Semiconductor Assembly & Test	웨이퍼테스트 Wafer Test	웨이퍼 테스터	메모리 테스트 장비	와이씨	988.7	-3.9	-21.2	-29.6	-23.3	13.5	-16.8
		테스트 장비	메모리 SSD·패키지 테스트 장비	디아이	699.0	3.8	-1.6	-12.7	2.5	57.3	15.7
				코세스	529.1	14.3	-14.9	41.2	39.3	325.3	46.7
				네오셈	467.2	-3.0	-20.6	-27.4	-4.7	12.6	-2.8
				유니테스트	234.4	-3.5	-19.8	-31.1	-22.1	-2.7	-18.3
				엑시콘	240.7	-1.1	-34.1	-28.4	14.3	72.3	22.0
		테스트 핸들러	HBM 관련 장비	테크윙	1,726.7	-10.0	-4.7	-0.2	-8.5	43.8	1.8
		소켓 Test Socket	테스트 소켓 인터페이스 부품	리노공업	5,990.3	-6.8	-15.3	-28.8	21.1	52.6	30.4
				ISC	3,539.9	-9.2	-21.0	-29.5	39.2	172.4	50.3
				티에프이	474.1	-7.8	-17.2	-35.1	2.0	31.5	5.5
				오킨스전자	313.4	8.9	-10.5	-21.0	43.2	135.1	44.3
				마이크로컨텍솔	199.5	5.5	-14.4	-12.1	36.4	14.8	42.2
		프로브카드 Probe Card	프로브카드 프로브카드용 PCB	티에스이	2,776.4	12.3	22.7	130.7	295.9	525.9	335.8
				타이거일렉	423.1	15.5	34.5	144.1	180.9	446.5	201.8
	절단 / Dicing	레이저 마킹·가공	레이저 마킹, 레이저 기반 후공정 장비	이오테크닉스	4,835.4	-19.1	-9.1	-0.9	35.8	107.8	44.3
	본딩 칩 접착 Die Attach	본더 / HBM Bonding	TC / 다이 / 레이저	프로텍	633.6	-5.4	-6.1	34.1	93.7	177.7	106.2
				디아이티	358.2	5.9	-5.2	3.5	20.8	41.0	30.1
		HBM 적층 본딩		한미반도체	22,160.1	-9.7	-15.6	-10.6	60.9	144.0	82.5
	전기적 연결 Interconnection	리플로우 / Reflow	패키지 접합	피에스케이홀딩스	3,102.8	6.3	43.0	53.9	186.1	287.9	210.8
		솔더볼 골드와이어	패키지 접합 소재	엠케이전자	387.4	-24.3	-36.3	-11.6	88.8	97.7	90.6
				덕산하이메탈	488.5	4.9	-6.9	-1.5	68.8	152.4	76.5
		리드프레임·기판	패키지 기판 리드프레임	심텍	4,836.6	3.5	23.7	160.5	154.1	449.4	161.6
				해성디에스	1,031.9	-11.4	-20.2	15.4	10.8	104.4	9.0
				하나마이크론	2,729.0	-15.5	-0.9	42.0	54.0	225.0	59.4
	밀봉 Encapsulation	패키징 Packaging	OSAT 패키징 메모리 비메모리 패키지	SFA반도체	888.1	-6.1	-29.0	-15.9	10.9	65.6	18.0
				네팩스	510.8	-11.0	-40.6	16.5	35.2	92.6	42.0
				한양디지텍	332.3	3.8	-22.1	-20.6	1.6	128.5	1.2
				LB세미콘	251.5	5.2	-8.9	14.7	1.5	23.2	4.2
				아이텍	150.2	-14.6	-28.1	-4.1	-6.3	-11.4	1.6
	패키지검사 Package Inspection	광학검사 Optical Inspection	3D AOI FC-BGA-HBM 검사 패키지 검사	고영	2,053.0	1.9	-6.8	13.8	10.9	87.5	31.4
				기가비스	2,116.9	0.2	33.2	100.7	426.8	537.4	430.2
				인텍플러스	667.1	21.7	31.6	140.9	273.5	457.6	299.1
	패키지테스트 Package Test	OSAT Test 패키지 테스트	최종 테스트 신뢰성 평가	두산테스나	2,077.7	-7.1	-28.1	13.5	98.7	298.9	102.1
				네팩스아크	412.4	-8.1	-6.1	29.5	87.4	148.5	99.1
				에이팩트	265.6	-23.2	-23.5	-7.7	-10.9	168.0	-7.7
				큐알티	144.9	-3.6	-29.2	-21.9	-33.6	-14.0	-25.9
				에이엘티	84.6	0.6	-26.1	-11.1	-27.9	20.3	-27.0

자료: FnGuide(Quantiwise), 핀릿 리서치센터, 7/3 일 종가 기준

핵심 밸류체인 대표 종목 한눈에



1. **삼성전자(005930)**: 범용 공급 부족과 HBM4 독주, 펀더멘털은 완벽하다
2. **SK 하이닉스(000660)**: AI 메모리 반도체 슈퍼사이클의 중심에 서다!
3. **솔브레인(357780)**: 반도체 소재에서 유리기판까지 성장판이 열린다
4. **한솔케미칼(014680)**: 반도체 소재 성장 모드가 다시 켜졌다
5. **HPSP(403870)**: AI·메모리 미세화가 키우는 고압 어닐링 수요
6. **원익 IPS(240810)**: 전공정 장비 슈퍼사이클, 진짜 성장은 이제 시작
7. **주성엔지니어링(036930)**: ALD 기술 하나로 반도체·태양광·유리기판까지 간다
8. **피에스케이(319660)**: 전공정 CAPEX 슈퍼사이클, 넓은 고객 저변 강점
9. **티씨케이(064760)**: NAND 고단화가 부르는 SiC Ring 슈퍼사이클
10. **파크시스템스(140860)**: 선단공정 계측, 수율을 좌우하는 숨은 병목 기술
11. **이오테크닉스(039030)**: 마킹·어닐링·커팅, 세 공정이 동시에 열린다
12. **한미반도체(042700)**: HBM 고단화가 만든 TC 본더 장기 성장 공식
13. **하나마이크론(067310)**: 풀턴키 OSAT, AI 후공정 성장의 본격 수혜 구간
14. **테크윙(089030)**: 메모리 핸들러 1위에서 HBM 검사 플랫폼으로
15. **리노공업(058470)**: AI 반도체 시대, 테스트 소켓이 숨은 병목이다



AI PERSONAL FINANCIAL ROBOADVISOR

투자의견 / 적정주가 신규매수/417,000 원

Company Data

현재주가 (7/3 일)	309,500 원
시가총액	1,809.4 조원
자본금	897.5 십억
발행주식수	5,846 백만주
유동주식비율	75.7 %

Stock Data

52 주 최고가	374,500 원
52 주 최저가	60,200 원
일평균거래액(60 일)	88,445 억원
외국인 지분율	46.8 %

주가



005930 (KS) 반도체

삼성전자

범용 공급 부족과 HBM4 독주, 펀더멘털 재평가

- 투자의견 신규 매수, 목표주가 417,000 원 제시, +34.7% 상승여력
- 역대급 공급 부족, 메모리 1 위의 시간이 왔다
- HBM4 싹쓸이 예고, 비메모리까지 판이 바뀐다

투자의견 신규 매수, 목표주가 417,000 원 제시, +34.7% 상승 여력

동사의 대한 투자의견 신규 매수, 목표주가 417,000 원 제시하며, 현재주가 대비 +34.7% 상승 여력이 있다. 이는 경쟁사 대비 PER 5.5 배, PBR 2.2 배로 극심한 할인 국면이며, RIM 기준 431,779 원, DCF 기준 429,161 원으로 절대가치평가 모델에서도 상방 지지선이 확고하여 주가 상승 흐름은 여전히 매우 유효하다.

역대급 공급 부족, 메모리 1 위의 시간이 왔다

생성형 AI 확산과 데이터센터 증설로 메모리 수요가 폭발하는 반면, 공정 고도화 한계로 공급은 극히 제한적인 상황이다. 3분기도 판가 인상 등 판가 상승 모멘텀이 내년까지 확고한 만큼, 전 세계 1 위 생산 능력을 보유한 동사의 독점적 수혜와 압도적인 실적 성장이 증명되는 구간이다.

HBM4 싹쓸이 예고, 비메모리까지 판이 바뀐다

약점으로 지목되던 HBM 영역에서 첨단 공정 도입을 통해 하반기 최고속 HBM4 물량을 과점적으로 수주하며 기술적 락인 효과를 증명할 전망이다. 여기에 LPU 물량 유입에 따른 파운드리 적자 탈피까지 맞물리며 고부가 종합 반도체 기업으로의 체질 개선이 본격화되고 있다.

2분기 숫자가 말한다, 아직 실적 피크가 아니다

2Q26 전망은 매출 177.3 조원, 영업이익 85.9 조원, OPM 48.4%로 메모리 판가 상승과 반도체 레버리지가 격화되는 구간이다. 전분기 대비 이익 개선 폭이 크고 컨센서스 상향 여지가 남아 있어 다시한번 재평가의 직접 트리거가 될 수 있다. 또한 향후 3분기 100조원대 영업이익 진입 가능성을 미리 보여주는 선행 신호로도 해석할 수 있다.

투자지표	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (십억원)	258,935.5	300,870.9	333,605.9	721,690.5	938,169.1
영업이익 (십억원)	6,567.0	32,726.0	43,601.1	372,956.2	522,500.3
영업이익률 (%)	2.5	10.9	13.1	51.7	55.7
순이익 (십억원)	15,487.1	34,451.4	45,206.8	328,105.4	465,383.2
EPS (원)	2,131	4,950	6,564	55,427	78,617
PER (배)	36.8	10.7	18.3	5.6	3.9
PBR (배)	1.5	0.9	1.9	4.3	3.2
ROE (%)	4.3	9.0	10.8	54.9	49.3

자료: 핀릿 리서치센터

상장일: 19750611

[삼성전자 적정주가 산정]

목표주가 417,000 원
투자의견 매수(BUY)
신규 제시

삼성전자 투자 의견 매수, 목표주가 417,000 원을 신규로 제시하며 기준일인 7 월 3 일 종가 309,500 원 대비 34.7%의 상승여력을 보유하고 있다.

목표주가는 상대평가와 절대평가 4 개 방식을 평균 적용하여 산정했다. 상대 밸류에이션 관점에서 마이크론, 키옥시아, 샌디스크 등 메모리 경쟁사의 평균 선행 PER 은 7.2 배인 반면 삼성전자의 현재 PER 은 5.5 배로 경쟁사 대비 가치가 할인되어 있으며, 이에 따른 PER 기준 업사이드 수익률은 30.9%이다. 또한 높은 ROE(49.9%)가 반영된 적정 PBR 은 2.8 배 수준이나 현재 PBR 은 2.2 배에 불과하여, 향후 ROE 감안 시 PBR 재평가에 따른 업사이드 여력은 29.5%에 달한다.

절대 밸류에이션 평가 구조에서도 현재 주가 대비 뚜렷한 상방 가능성이 입증된다. 자기자본비용 (CoE) 8.6%, 영구성장률(g) 0.5%를 적용한 초과이익모형(RIM) 기준 주당가치는 431,779 원으로 39.5%의 업사이드를 나타낸다. 아울러 가중평균자본비용(WACC) 10.6%, 영구성장률(g) 0.5%를 가정한 현금흐름할인모형(DCF) 기준 주당가치는 429,161 원으로 38.7%의 업사이드를 확보하고 있다.

그래서 상대평가 상의 극심한 밸류에이션 할인과 절대가치 기준의 강력한 상방 지지선이 공존하고 있다는 점이다. 범용 메모리 가격 상승과 고수익 구조가 숫자로 증명되는 국면인 만큼, 4 개 방식을 정교하게 결합하여 도출한 적정 가치로의 회귀와 재평가 흐름은 매우 유효하다고 .

비교기업 기초자료

종목	시가총액(십억\$)	Fwd 12m PER	PBR	PSR	ROE	현재주가 기준일: 7/3일 종가	목표주가	상승여력
Micron Tech.	1,101.8	6.6	4.0	6.6	71.6	309,500원	417,000원	34.7%
Kioxia Holdings	282.7	8.0	5.9	8.0	145.8			
Sandisk	258.4	9.0	5.9	9.0	76.0			
SK하이닉스	1,112.1	6.2	3.2	6.2	78.0			
삼성전자	1,164.3	5.5	2.2	5.5	49.9			
Intel Corp.	604.9	89.1	5.1	89.1	5.6			
TSMC	2,251.8	23.4	7.4	23.4	36.1			
United Micro Elec.	61.7	35.2	4.6	35.2	14.0			

4개 방식 평균 적용

상대평가 PER	상대평가 PBR	절대평가 RIM	절대평가 DCF
메모리 경쟁사 평균 PER 7.2배 삼성전자 현재 PER 5.5배 업사이드 +30.9% 비교대상: 마이크론·키옥시아·샌디스크	ROE 반영 적정 PBR 2.8배 현재 PBR 2.2배 업사이드 +29.5%	초과이익모형 주당가치 431,779원 업사이드 +39.5% CoE 8.6% g 0.5%	현금흐름할인모형 주당가치 429,161원 업사이드 +38.7% WACC 10.6% g 0.5%

메모리 경쟁사 대비 밸류 할인

ROE 감안 시 PBR 재평가 가능

절대가치 기준도 현 주가 대비 상방

[참고: RIM, DCF 등 절대가치평가 모델]

RIM (Residual Income Model, 초과이익모형)

(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
Total Shareholder's Equity	402,192	436,320	759,920	1,126,872	1,450,613	1,775,563	1,955,974
Total Shareholder's Equity (Year average)	382,935	419,256	598,120	943,396	1,288,742	1,613,088	1,865,769
Net Income	34,451	45,207	328,105	465,383	463,356	463,957	418,103
Dividend (Total)	9,897	82,354	139,615	139,007	139,187	139,368	125,594
Payout ratio %	28.7%	182.2%	42.6%	29.9%	30.0%	30.0%	30.0%
FROE (Forecasted ROE)	9.0%	10.8%	54.9%	49.3%	36.0%	28.8%	22.4%
COE (Cost of Equity)	8.1%	7.6%	8.6%	8.3%	8.1%	7.8%	7.8%
ROE Spread (FROE-COE)	0.9%	3.2%	46.3%	41.0%	27.9%	20.9%	14.6%
Residual Income	3,408	13,482	276,787	386,798	359,225	337,652	272,013
PVIF (including Mid-year adj. Factor)	-	-	0.96	0.82	0.74	0.67	0.61
추정잔여이익의 현재가치	-	-	264,901	317,692	266,817	226,798	165,228

Continuing Value Calculation

RI 계속성장률 g (%)	0.5%
COE	8.6%



RIM 결과

적정주가 431,779원

추정RI 현재가치 1,241,435.6

계속가치 현재가치 912,345.7

Beginning Shareholder's Equity 402,192.1

Equity Value to Residual Income 2,555,973.3

발행주식수 (백만주) 5,919.6

추정주당가치 (원) 431,779

현재주가 309,500원

Potential (Upside) +39.5%

DCF (Discounted Cash Flow Model, 현금흐름할인모형)

(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
EBIT	32,726.0	43,601.1	372,956.2	522,500.3	509,065.0	500,555.6	442,969.6
EBIT에 대한 법인세	2,729.7	3,870.5	55,974.3	78,364.9	76,349.3	75,073.1	66,436.4
NOPLAT	29,996.2	39,730.6	316,981.9	444,135.4	432,715.6	425,482.5	376,533.2
유,무형 감가상각비	42,630.8	46,926.6	56,353.0	70,442.2	70,443.2	70,444.2	63,400.7
총현금유입	72,627.0	86,657.2	373,334.9	514,577.6	503,158.9	495,926.7	439,918.6
운전자본증감	-1,567.6	-9,613.9	-35,585.6	-53,096.9	-14,490.7	375.7	-8.8
유,무형,이연자산투자	-66,341.2	-66,632.3	-80,000.0	-100,000.0	-100,000.0	-100,000.0	-90,000.0
총투자	-67,908.7	-76,246.2	-115,585.6	-153,096.9	-114,490.7	-99,624.3	-78,019.4
Free Cash Flow	4,718.3	10,411.0	257,749.3	361,480.8	388,668.1	396,302.4	361,899.3
PVIF (Present Value Interest Factor)	-	-	0.96	0.82	0.74	0.67	0.61
추정FCF의 현재가치	-	-	246,681.3	296,898.2	288,685.3	266,192.6	219,826.6

Continuing Value Calculation

계속성장률 g (%)	0.5%
WACC (CoE+2%)	10.6%



DCF 결과

적정주가 429,161원

추정FCF 현재가치 1,318,284

계속가치 (2030년 이후) 976,536

Operating Value of FCFF 2,294,820

비영업용 투자자산 등 245,655

추정자기자본가치 2,540,475

발행주식수 (백만주) 5,920

추정주당가치 (원) 429,161

현재주가 309,500원

Potential (Upside) +38.7%



AI PERSONAL FINANCIAL ROBOARDVISOR

000660 (KS) 반도체

SK 하이닉스

AI 메모리 반도체 슈퍼사이클의 핵심 수혜주

투자의견 / 적정주가

신규매수/3,270,000 원

Company Data

현재주가 (7/3 일)	2,425,000 원
시가총액	1,7283 조원
자본금	3,657.7 십억
발행주식수	713 백만주
유동주식비율	742 %

Stock Data

52 주 최고가	2,987,000 원
52 주 최저가	245,000 원
일평균거래액(60 일)	105,711 억원
외국인 지분율	50.3 %

주가



- 투자의견 신규 매수, 목표주가 3,270,000 원 제시, +34.8% 여력
- AI 메모리 수요의 가장 중심축에 서 있다
- 미국 ADR 상장은 밸류에이션 리레이팅의 촉매이다

투자의견 신규 매수, 목표주가 3,270,000 원 제시, +34.8% 상승 여력

동사의 대한 투자의견 신규 매수, 목표주가 3,270,000 원 제시하며, 현재주가 대비 +34.8% 상승 여력이 있다. 이는 경쟁사 대비 PER 6.2 배, PBR 3.2 배로 극심한 할인 국면이며, RIM 기준 3,642,311 원, DCF 기준 3,294,045 원으로 절대가치평가 모델에서도 상방 지지선이 확고하여 향후 주가 상승 흐름은 매우 유효하다.

AI 메모리 수요의 가장 중심축에 서 있다

동사는 HBM 을 기반으로 AI 가속기 시장에서의 주도권을 굳건히 다지고 있으며, 에이전트 AI 의 확산은 고용량 서버 DRAM 과 eSSD 수요를 동시에 폭발시키는 구조이다. 메모리가 AI 인프라의 성능을 결정짓는 핵심 자원으로 격상된 만큼, 동사는 과거의 단순한 사이클 기업과는 전혀 다른 차원으로 재평가받아야 한다.

미국 ADR 상장은 밸류에이션 리레이팅의 촉매이다

7 월 10 일 예정된 나스닥 ADR 상장은 글로벌 투자자들의 접근성을 높이고 마이크로 등 현지 경쟁사들과 직접 비교되는 계기를 마련한다. 그동안 국내 공급 한계로 짓눌려 있던 할인 요인이 해소된다면, 독보적인 ROE 와 장기공급계약(LTA) 기반의 압도적인 이익 체력이 주가에 더 빠르게 반영될 전망이다.

2Q26 전망 _ 영업이익률 77%, 수익성의 레벨이 달라졌다

2Q26 전망은 AI 메모리 수요 확대가 숫자로 확인되는 구간이다. 매출액은 82.9 조원, 영업이익은 64.1 조원으로 전년 대비 각각 272.8%, 596.3% 증가가 예상된다. 영업이익률은 77.4%까지 상승하며, 영업이익 변화율도 지난 3 개월 전 보다 96.8%에서 1 개월 전 13.4%, 1 주 전 7.0%로 상향 흐름이 이어지고 있어 실적 모멘텀은 여전히 유효한 국면이다.

투자지표	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (십억원)	32,765.7	66,193.0	97,146.7	345,465.3	510,160.7
영업이익 (십억원)	-7,730.3	23,467.3	47,206.3	274,481.9	397,626.1
영업이익률 (%)	-23.6	35.5	48.6	79.5	77.9
순이익 (십억원)	-9,137.6	19,796.9	42,947.9	222,455.3	326,198.3
EPS (원)	-12,517	27,182	58,955	306,469	449,393
PER (배)	-11.3	6.4	11.0	7.9	5.4
PBR (배)	1.8	1.6	3.7	5.1	2.7
ROE (%)	-15.6	31.1	44.1	96.0	65.6

자료: 핀릿 리서치센터

상장일: 19961226

[SK 하이닉스 적정주가 산정]

목표주가 3,270,000 원
투자의견 매수(BUY) 신규
제시

SK 하이닉스 투자의견 매수, 목표주가 3,270,000 원을 신규로 제시하며 기준일인 7월 3일 종가 2,425,000 원 대비 34.8%의 상승여력을 보유하고 있다.

목표주가는 상대평가와 절대평가 4개 방식을 평균 적용하여 산정했다. 상대 밸류에이션 관점에서 마이크론, 키옥시아, 샌디스크 등 메모리 경쟁사의 평균 선행 PER은 7.2배인 반면 SK하이닉스 현재 PER은 6.2배로 경쟁사 대비 가치가 할인되어 있으며, 이에 따른 PER 기준 업사이드 수익률은 16.9%이다. 또한 높은 ROE(78.0%)가 반영된 적정 PBR은 4.4배 수준이나 현재 PBR은 3.2배에 불과하여, 향후 ROE 감안 시 PBR 재평가에 따른 업사이드 여력은 36.2%에 달한다.

절대 밸류에이션 평가 구조에서도 현재 주가 대비 뚜렷한 상방 가능성이 입증된다. 자기자본비용(CoE) 8.7%, 영구성장률(g) 0.5%를 적용한 초과이익모형(RIM) 기준 주당가치는 3,642,311 원으로 50.2%의 업사이드를 나타낸다. 아울러 가중평균자본비용(WACC) 10.7%, 영구성장률(g) 0.5%를 가정한 현금흐름할인모형(DCF) 기준 주당가치는 3,294,045 원으로 35.8%의 업사이드를 확보하고 있다.

그래서 상대평가 상의 극심한 밸류에이션 할인과 절대가치 기준의 강력한 상방 지지선이 공존하고 있다는 점이다. 범용 메모리 가격 상승과 고수익 구조가 숫자로 증명되는 국면인 만큼, 4개 방식을 정교하게 결합하여 도출한 적정 가치로의 회귀와 재평가 흐름은 매우 유효하다고.

비교기업 기초자료

종목	시가총액(십억\$)	Fwd 12m PER	PBR	PSR	ROE
Micron Tech.	1,101.8	6.6	4.0	6.6	71.6
Kioxia Holdings	282.7	8.0	5.9	8.0	145.8
Sandisk	258.4	9.0	5.9	9.0	76.0
SK하이닉스	1,112.1	6.2	3.2	6.2	78.0
삼성전자	1,164.3	5.5	2.2	5.5	49.9
Intel Corp.	604.9	89.1	5.1	89.1	5.6
TSMC	2,251.8	23.4	7.4	23.4	36.1
United Micro Elec.	61.7	35.2	4.6	35.2	14.0

현재주가

기준일: 7/3일 종가

2,425,000원

목표주가

3,270,000원

상승여력

34.8%

4개 방식 평균 적용

상대평가 | PER

메모리 경쟁사 평균 PER 7.2배
SK하이닉스 현재 PER 6.2배

업사이드

+16.9%

비교대상: 마이크론 · 키옥시아 · 샌디스크

상대평가 | PBR

ROE 반영 적정 PBR 4.4배
현재 PBR 3.2배

업사이드

+36.2%

절대평가 | RIM

초과이익모형
주당가치 3,642,311원

업사이드

+50.2%

CoE 8.7%

절대평가 | DCF

현금흐름할인모형
주당가치 3,294,045원

업사이드

+35.8%

WACC 10.7%



메모리 경쟁사 대비 밸류 할인



ROE 감안 시 PBR 재평가 가능



절대가치 기준도 현 주가 대비 상방

[참고: RIM, DCF 등 절대가치평가 모델]

RIM (Residual Income Model, 초과이익모형)

(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
Total Shareholder's Equity	73,916	120,667	342,569	651,253	952,209	1,268,812	1,521,617
Total Shareholder's Equity (Year average)	63,710	97,291	231,618	496,911	801,731	1,110,510	1,395,214
Net Income	19,797	42,948	222,455	326,198	332,916	350,136	331,422
Dividend (Total)	1,681	10,856	25,683	32,619	35,267	37,091	35,108
Payout ratio %	8.5%	25.3%	11.5%	10.0%	10.6%	10.6%	10.6%
FROE (Forecasted ROE)	31.1%	44.1%	96.0%	65.6%	41.5%	31.5%	23.8%
COE (Cost of Equity)	8.1%	7.6%	8.7%	8.5%	8.3%	8.1%	8.1%
ROE Spread (FROE-COE)	23.0%	36.6%	87.3%	57.1%	33.2%	23.4%	15.7%
Residual Income	14,632	35,586	202,305	283,961	266,373	260,185	218,409
PVIF (including Mid-year adj. Factor)	-	-	0.96	0.82	0.74	0.67	0.60
추정잔여이익의 현재가치	-	-	193,521	232,745	197,226	174,023	131,962

Continuing Value Calculation

RI 계속성장률 g (%)	0.5%
COE	8.7%

RIM 결과

추정RI 현재가치	929,477.6
계속가치 현재가치	1,464,237.1
Beginning Shareholder's Equity	250,110.0
Equity Value fo Residual Income	2,643,824.7
발행주식수 (백만주)	725.9
추정주당가치 (원)	3,642,311
현재주가	2,425,000원
Potential (Upside)	+50.2%

DCF (Discounted Cash Flow Model, 현금흐름할인모형)

(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
EBIT	23,467.3	47,206.3	274,481.9	397,626.1	398,786.0	413,929.3	386,682.9
EBIT에 대한 법인세	4,035.6	7,588.3	55,115.9	79,831.0	80,164.1	83,138.9	77,601.7
NOPLAT	19,431.7	39,618.0	219,366.0	317,795.1	318,621.9	330,790.4	309,081.3
유,무형 감가상각비	12,581.5	13,930.1	26,005.2	43,343.0	43,344.0	43,345.0	39,011.4
총현금유입	32,013.3	53,548.2	245,371.2	361,138.1	361,965.9	374,135.4	348,042.7
운전자본증감	-5,599.8	-2,881.0	-31,286.2	-46,077.5	-17,699.1	-3,785.0	-728.5
유,무형,이연자산투자	-20,040.5	-32,154.8	-60,000.0	-100,000.0	-100,000.0	-100,000.0	-90,000.0
총투자	-25,640.4	-35,035.8	-91,286.2	-146,077.5	-117,699.1	-103,785.0	-82,364.2
Free Cash Flow	6,372.9	18,512.4	154,085.0	215,060.6	244,266.8	270,350.4	265,678.5
PVIF (Present Value Interest Factor)	-	-	0.96	0.82	0.74	0.67	0.60
추정FCF의 현재가치	-	-	147,395.4	176,271.6	180,858.2	180,822.8	160,522.1

Continuing Value Calculation

계속성장률 g (%)	0.5%
WACC (CoE+2%)	10.7%

DCF 결과

추정FCF 현재가치	845,870
계속가치 (2030년 이후)	1,354,490
Operating Value of FCFF	2,200,360
비영업용 투자자산 등	190,670
추정자기자본가치	2,391,031
발행주식수 (백만주)	726
추정주당가치 (원)	3,294,045
현재주가	2,425,000원
Potential (Upside)	+35.8%

자료: 핀릿 리서치센터(7/3 일 종가 기준), ChatGPT 5.5 로 재구성



AI PERSONAL FINANCIAL ROBOADVISOR

투자의견 / 적정주가
Not Rated (미제시)

357780 (KQ) 반도체

솔브레인

반도체 소재에서 유리기판까지 성장판이 열린다

- 반도체 소재 수요의 구조적 성장 수혜주
- 선단 파운드리 공정 진입이 재평가의 핵심으로 부상
- 중장기 성장 옵션인 유리기판과 해외 고객 확장

Company Data

현재주가 (7/3 일)	322,500 원
시가총액	2,508.6 십억
자본금	39 십억
발행주식수	8 백만주
유동주식비율	53.7 %

Stock Data

52 주 최고가	530,000 원
52 주 최저가	176,000 원
일평균거래액(60 일)	325 억원
외국인 지분율	29.2 %

주가



반도체 소재 수요의 구조적 성장 수혜주

솔브레인은 NAND 식각액을 중심으로 반도체 매출 비중이 높은 소재 기업이며, 메모리 가동률 회복과 고단화 전환이 진행될수록 투입량이 함께 늘어나는 구조이다. 제품 가격보다 생산량과 공정 난이도가 실적을 결정하는 기업이라는 점에서 업황 회복의 직접 수혜주이다. 특히 소재는 장비와 달리 라인이 돌아갈수록 반복적으로 소비되기 때문에 실적의 지속성이 높다.

선단 파운드리 공정 진입이 재평가의 핵심으로 부상

GAA(Gate-All-Around, 차세대 트랜지스터 구조) 공정 확대와 고객사의 신규 Fab 가동은 초산계 식각액 수요를 키우는 요인이다. 이는 단순한 범용 소재 공급이 아니라 미세공정에서 필요한 특수 소재 공급 능력이 부각되는 구간이며, 고객사 공정 전환이 본격화될수록 성장 가시성과 수익성 정상화가 함께 높아지는 구조이다.

중장기 성장 옵션인 유리기판과 해외 고객 확장

동사는 기존 화학 소재 기술을 기반으로 유리기판용 식각·도금·CMP 소재까지 사업 영역을 넓히고 있다. 여기에 미국 투자와 해외 고객 확대 가능성이 더해지면서 특정 고객 의존도를 낮추고, 소재 기업에서 첨단 패키징 소재 기업으로 밸류에이션이 확장될 수 있는 국면으로 장기 성장의 폭이 넓은 구간에 들어섰다.

영업이익률 17%, 수익성 정상화가 확인되는 2분기

2Q26 전망은 반도체 소재 수요 회복이 이익으로 연결되는 구간으로, 매출액은 2,665 억원으로 전년 대비 16.5%, 영업이익은 462 억원으로 129.0% 증가할 전망이다. 영업이익률은 17.3%로 개선되고, 순이익도 374 억원까지 확대된다. 다만 영업이익 변화율이 최근 3 달 전 대비 5.9%로 완만해 추세 확인 점검이 필요하다.

투자지표	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (십억원)	844.0	863.4	923.4	1,089.9	1,276.9
영업이익 (십억원)	133.5	168.0	133.6	195.3	254.0
영업이익률 (%)	15.8	19.5	14.5	17.9	19.9
순이익 (십억원)	130.4	118.4	79.1	150.4	193.1
EPS (원)	16,759	15,226	10,164	19,332	24,829
PER (배)	18.1	10.9	25.8	16.7	13.0
PBR (배)	2.6	1.3	1.9	2.1	1.8
ROE (%)	15.6	12.5	7.7	13.4	15.2

자료: FnGuide(Quantwise) 컨센서스, 핀릿 리서치센터

상장일: 20200806



AI PERSONAL FINANCIAL ROBOADVISOR

투자 의견 / 적정주가

Not Rated (미제시)

Company Data

현재주가 (7/3 일)	262,500 원
시가총액	2,890.9 십억
자본금	56.9 십억
발행주식수	11 백만주
유동주식비율	78.2 %

Stock Data

52 주 최고가	346,500 원
52 주 최저가	158,600 원
일평균거래액(60 일)	244 억원
외국인 지분율	41.0 %

주가



014860 (KS) 화학

한솔케미칼

반도체 소재 성장 모드가 다시 커졌다

- 과산화수소, P 와 Q 가 함께 개선되는 소재 기업
- 프리커서가 성장의 중심축으로 올라서고 있다
- 주주환원과 실적 성장의 조합이 재평가 요인

과산화수소, P 와 Q 가 함께 개선되는 소재 기업

한솔케미칼은 반도체 세정용 과산화수소를 중심으로 고객사 메모리·파운드리 가동률 상승의 수혜를 받는 구조이다. 원재료 가격 상승은 단기 부담이나 판가 인상이 완료되면 마진 훼손은 완화될 수 있다. 여기에 M15X 등 신규 Fab 가동과 향후 증설 효과가 더해지면 반복 매출의 안정성이 높아지는 국면이다. 소재는 장비와 달리 라인이 돌아갈수록 계속 소비되는 구조라는 점도 투자 매력이다.

프리커서가 성장의 중심축으로 올라서고 있다

TSA 소재는 선단 파운드리와 2nm 램프업에서 수요가 확대되는 핵심 제품이며, High-K 계열 소재의 고객사 확대 가능성도 열려 있다. QD 소재 둔화는 부담이나 프리커서와 바인더, 테이팩스 회복이 이를 보완하면서 전자소재 포트폴리오의 질을 높이는 구조로 변모하고 있다.

주주환원과 실적 성장의 조합이 재평가 요인

자사주 매입과 소각은 주당가치 개선에 직접적이며, 2026~2027 년 영업이익 성장 흐름과 맞물려 밸류에이션 신뢰도를 높이고 있다. 단기 주가 변동성보다 소재 포트폴리오 확장, 현금흐름 개선, 주주환원 강화가 함께 진행되는 기업으로 볼 필요가 있다.

과산화수소·프리커서가 지키는 실적 방어력

2Q26 전망은 원가 상승분을 판가 인상으로 흡수하며 수익성이 회복되는 구간이다. 매출액은 전분기 대비 5.9% 증가한 2,455억 원, 영업이익은 500억 원으로 영업이익률 20.4% 달성이 예상된다. QD 소재 감소에도 과산화수소와 프리커서가 실적을 견인하며, 순이익 역시 전분기 대비 반등할 것으로 전망된다.

투자지표	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (십억원)	771.7	776.4	884.0	998.3	1,157.0
영업이익 (십억원)	124.1	128.8	156.2	187.0	236.7
영업이익률 (%)	16.1	16.6	17.7	18.7	20.5
순이익 (십억원)	105.4	122.7	147.3	169.6	210.6
EPS (원)	9,294	10,823	12,993	15,370	19,507
PER (배)	24.4	9.0	17.5	17.1	13.5
PBR (배)	2.9	1.1	2.3	2.3	2.0
ROE (%)	13.1	13.5	14.3	14.9	16.5

자료: FnGuide(Quantwise) 컨센서스, 핀릿 리서치센터

상장일: 19890520



AI PERSONAL FINANCIAL ROBOADVISOR

403870 (KQ) 반도체

HPSP

AI·메모리 미세화가 확대시키는 고압 어닐링 수요

투자의견 / 적정주가
Not Rated (미제시)

- 선단공정의 병목을 해결하는 핵심 장비
- 로직·파운드리에서 메모리로 확장되는 성장 구조
- 높은 수익성과 신규 장비 로드맵이 재평가 요인

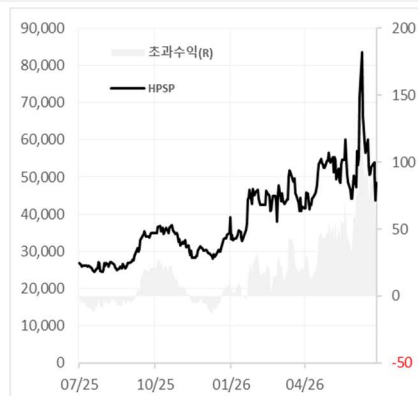
Company Data

현재주가 (7/3 일)	48,500 원
시가총액	3,991.6 십억
자본금	420 십억
발행주식수	82 백만주
유동주식비율	78.4 %

Stock Data

52 주 최고가	92,000 원
52 주 최저가	24,300 원
일평균거래액(60 일)	2,974 억원
외국인 지분율	33.1 %

주가



선단공정의 병목을 해결하는 핵심 장비

고압 수소 어닐링은 High-K 절연막과 메탈 게이트 적용이 늘어날수록 중요해지는 계면 결함 개선 공정이다. 미세화가 진행될수록 누설전류와 신뢰성 문제가 커지기 때문에, 낮은 온도에서 높은 수소 농도를 구현하는 기술력은 선단공정 고객사 입장에서 선택이 아니라 필수에 가까운 경쟁력이다.

로직·파운드리에서 메모리로 확장되는 성장 구조

AI 가속기 수요는 2~3~4nm 선단공정 투자 확대를 자극하고, DRAM 과 NAND 역시 고단화와 미세화 과정에서 어닐링 수요가 커지고 있다. 기존 파운드리 중심 매출이 메모리 고객 다변화로 넓어지면 실적의 계단식 성장이 가능하다. 북미와 대만, 일본 투자 확대도 중장기 수주 가시성을 높이는 변수이다.

높은 수익성과 신규 장비 로드맵이 재평가 요인

비수기에도 50%대 영업이익률을 유지한 점은 가격 경쟁이 아닌 기술 장벽 기반 사업임을 보여준다. 향후 고압 산화막, Toxic 가스, Hybrid Bonding 공정까지 적용처가 확대될 경우 단순 장비주가 아니라 선단공정 병목 장비 플랫폼으로 평가받을 수 있는 구간이다. 결국 성장의 폭과 질이 동시에 개선되는 구조이다.

2Q26E 영업이익률 52%, 기술 장벽이 만든 수익성

2Q26 전망은 1 분기 비수기 저점 이후 회복되는 흐름이다. 매출액은 447 억원으로 전분기 대비 39.8%, 영업이익은 233 억원으로 44.1% 늘어날 전망이다. 영업이익률은 52.1%로 고압 어닐링 장비의 기술 장벽과 가격 경쟁력을 확인시키는 수치이다. 또한 추정치 상향 속도는 둔화됐지만 하반기 수주 확대 기대는 여전히 유효하다.

투자지표	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (십억원)	179.1	181.4	173.0	238.7	311.8
영업이익 (십억원)	95.2	94.0	89.9	127.1	171.2
영업이익률 (%)	53.2	51.8	52.0	53.3	54.9
순이익 (십억원)	80.4	86.3	72.7	118.5	144.7
EPS (원)	989	1,040	870	1,435	1,758
PER (배)	44.3	25.1	38.5	33.8	27.6
PBR (배)	13.1	7.5	8.8	10.4	8.2
ROE (%)	34.1	31.1	24.8	34.5	33.7

자료: FnGuide(Quantiwise), 핀릿 리서치센터

상장일: 20200715



AI PERSONAL FINANCIAL ROBOADVISOR

240810 (KQ) 반도체

원익 IPS

전공정 장비 슈퍼사이클, 진짜 성장은 이제 시작

투자의견 / 적정주가
Not Rated (미제시)

- 전공정 증착 국산화의 대표 축이자 수혜주
- 메모리와 파운드리 투자가 동시에 열리는 구간
- 수주잔고와 제품 믹스가 실적 레버리지의 근거

Company Data

현재주가 (7/3 일)	133,100 원
시가총액	6,533.1 십억
자본금	245 십억
발행주식수	49 백만주
유동주식비율	662 %

Stock Data

52 주 최고가	187,800 원
52 주 최저가	26,950 원
일평균거래액(60 일)	1,768 억원
외국인 지분율	182 %

주가



전공정 증착 국산화의 대표 축이자 수혜주

동사는 반도체 CVD-ALD 증착 장비와 열처리 장비를 공급하며 DRAM, NAND, LOGIC 핵심 공정에 들어가는 기술 포트폴리오를 보유하고 있다. 미세화와 고단화가 진행될수록 균일한 박막 형성과 공정 안정성이 중요해지기 때문에 장비 국산화 경쟁력은 단순 수주가 아니라 고객의 투자 사이클과 함께 커지는 구조이다.

메모리와 파운드리 투자가 동시에 열리는 구간

AI 서버 확산은 DRAM 전환투자, NAND 업그레이드, 미국 파운드리 공사 재개를 동시에 자극하고 있다. 동사는 특정 장비나 단일 고객에만 의존하기보다 메모리와 파운드리 양쪽에서 수혜가 가능한 종합 장비사라는 점이 차별점이다.

수주잔고와 제품 믹스가 실적 레버리지의 근거

장비사업은 납품 시점에 따라 분기 변동성이 크지만 수주잔고가 쌓이면 매출 가시성이 높아진다. 제품과 부품-서비스를 함께 공급하는 구조도 고객 락인 효과를 높인다. 반도체 장비 비중 확대는 디스플레이 부진을 상쇄하고 이익률 개선으로 연결될 수 있다. 주가는 이미 빠르게 반영됐지만 장기 투자 사이클이 이어진다면 현재 국면의 재평가 여지는 아직 충분히 남아 있다.

2Q26E 영업이익의 154% 반등, 수익성 회복의 첫 확인 구간

2Q26 예상은 1 분기 저점 이후 회복 강도를 확인하는 구간이다. 매출액은 2,416 억 원으로 전분기 대비 46.5% 증가하고, 영업이익은 272 억원으로 153.7% 늘어날 전망이다. 전년 대비 이익 감소는 남아 있지만 반도체 장비 매출 회복과 제품 믹스 개선으로 영업이익률은 11.3%까지 반등하는 흐름이다. 하반기 파운드리와 NAND 전환투자 반영 여부가 핵심 변수이다.

투자지표	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (십억원)	690.3	748.2	909.8	1,309.7	1,571.9
영업이익 (십억원)	-18.1	10.6	73.8	187.2	267.3
영업이익률 (%)	-2.6	1.4	8.1	14.3	17.0
순이익 (십억원)	-13.5	20.8	84.0	172.7	230.2
EPS (원)	-275	423	1,712	3,519	4,690
PER (배)	N/A(-123.37)	52.9	39.7	37.8	28.4
PBR (배)	1.9	1.2	3.4	5.7	4.8
ROE (%)	-1.6	2.4	9.1	16.4	18.5

자료: FnGuide(Quantiwise), 핀릿 리서치센터

상장일: 20160502



AI PERSONAL FINANCIAL ROBOADVISOR

투자의견 / 적정주가
Not Rated (미제시)

036930 (KQ) 반도체

주성엔지니어링

ALD 기술 하나로 반도체·태양광·유리기판까지 간다

- ALD·ALG 기술이 만든 전공정 확장성
- 태양광과 디스플레이는 선택지가 아닌 성장 옵션
- 유리기판과 DTC는 장기 재평가의 핵심

Company Data

현재주가 (7/3 일)	192,600 원
시가총액	8,9523 십억
자본금	241 십억
발행주식수	46 백만주
유동주식비율	67.0 %

Stock Data

52 주 최고가	283,000 원
52 주 최저가	26,050 원
일평균거래액(60 일)	5,172 억원
외국인 지분율	7.6 %

주가



ALD·ALG 기술이 만든 전공정 확장성

동사는 DRAM 캐패시터용 High-k ALD와 원자층성장 기술을 기반으로 메모리 미세화와 공정 전환의 핵심 장비 수요를 흡수하는 구조이다. AI 수요 확대가 DRAM 투자와 CXMT·국내 고객사의 전환투자를 자극하고 있어, 장비 발주는 단기 회복을 넘어 기술 채택 확대의 문제로 해석된다. 특히 연구개발과 고객 공동평가가 누적된 장비사는 사이클 회복기에 수주 탄력이 커지는 특성이 있다.

태양광과 디스플레이는 선택지가 아닌 성장 옵션

HJT와 페로브스카이트 탠덤 태양전지, OLED 봉지·TFT 장비는 기존 증착 기술을 다른 산업으로 확장한 결과이다. 반도체 사이클에만 의존하지 않고 태양광·디스플레이 매출이 붙으면 이익 변동성은 낮아지고 성장 프리미엄은 높아질 수 있다. 이는 장비 포트폴리오가 넓은 기업만이 가질 수 있는 방어력이다.

유리기판과 DTC는 장기 재평가의 핵심

첨단 패키징에서 인터포저, TGV, 내장 캐패시터 수요가 커질수록 초박막 증착 능력은 병목 기술이 된다. 다만 주가가 미래 기대를 빠르게 반영한 만큼, 지금은 성장성보다 실제 수주와 양산 검증 속도를 확인해야 하는 구간이다.

2Q26E, 반도체 장비 수주 재개가 만든 하반기 기대감

동사 2Q26 전망은 흑자 전환을 확인하는 회복 구간이다. 매출액은 전분기 대비 20.1% 증가한 659 억 원, 영업이익은 61 억 원으로 흑자전환이 예상된다. 영업이익률은 9.3%로 회복되며, 반도체 장비 수주 재개와 ALD·ALG 신기술 기대가 하반기 실적의 핵심이며, 지난 4Q25를 저점으로 분기 개선 흐름이 뚜렷하다.

투자지표	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (십억원)	284.8	409.4	310.7	351.4	601.3
영업이익 (십억원)	28.9	97.2	31.3	60.2	153.5
영업이익률 (%)	10.2	23.7	10.1	17.1	25.5
순이익 (십억원)	34.0	106.8	35.7	58.5	134.0
EPS (원)	705	2,235	755	1,255	2,883
PER (배)	48.5	13.2	36.7	153.4	66.8
PBR (배)	3.1	2.4	2.1	13.6	11.3
ROE (%)	6.8	19.8	6.2	9.5	18.8

자료: FnGuide(Quantiwise), 핀릿 리서치센터

상장일: 19991224



AI PERSONAL FINANCIAL ROBOADVISOR

투자의견 / 적정주가
Not Rated (미제시)

319660 (KQ) 반도체

피에스케이

전공정 CAPEX 슈퍼사이클, 넓은 고객 저변 강점

- 글로벌 고객 저변이 만든 CAPEX 레버리지
- Dry Strip 1 위와 Bevel Etch 침투가 이익률을 높이는 축
- 부품·서비스 반복 매출이 실적 안정성을 보장

Company Data

현재주가 (7/3 일)	182,300 원
시가총액	5,280.6 십억
자본금	14.6 십억
발행주식수	29 백만주
유동주식비율	67.1 %

Stock Data

52 주 최고가	219,500 원
52 주 최저가	18,100 원
일평균거래액(60 일)	687 억원
외국인 지분율	23.5 %

주가



글로벌 고객 저변이 만든 CAPEX 레버리지

동사는 Dry Strip 을 삼성전자, SK 하이닉스, Micron 등 메모리 3사와 북미 파운드리, 중화권 고객에 공급하는 전공정 장비사이다. 2026년 글로벌 WFE는 1,260억달러, 한국 장비 시장은 254억달러로 확대될 전망이며, 고객 투자가 동시에 열릴수록 특정 고객 의존 리스크는 낮아지고 수주 탄력은 커지는 구조이다.

Dry Strip 1 위와 Bevel Etch 침투가 이익률을 높이는 축

Dry Strip 세계 점유율은 2025년 39%로 최상위권이며, 장비 매출 내 Strip 비중은 약 75%로 핵심이다. 여기에 Dry Cleaning과 Bevel Etch가 미세화 공정에서 함께 확대되면 단일 장비주가 아니라 공정 저변을 넓히는 플랫폼 장비사로 재평가될 수 있다.

부품·서비스 반복 매출이 실적 안정성을 보장

1Q26 기준 제품 매출 비중은 54.8%, 기타 매출 비중은 45.2%로 장비 납품 이후에도 유지보수와 부품 매출이 이어지는 구조이다. 순현금 재무구조와 낮은 부채비율은 투자 사이클 확장기에 변동성을 견딜 체력을 높이는 장점이다. 이익의 질도 개선 중이다.

2Q26E, 영업이익률 28%, 장비 경쟁력이 만든 수익성

동사 2Q26 전망은 글로벌 고객사의 CAPEX 확대 수혜가 숫자로 입증되는 구간이다. 매출액은 전년 대비 51.2% 급증한 1,640억 원, 영업이익은 125.5% 폭증한 464억 원을 기록할 전망이다. 전분기 대비로는 이익이 소폭 둔화되나, 28.3%의 고영업 이익률은 Dry Strip 장비 경쟁력과 고객 다변화를 증명하며 실적 추정치 상향 흐름을 지지하고 있다.

투자지표	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (십억원)	351.9	398.1	457.2	673.4	815.9
영업이익 (십억원)	54.1	83.9	88.5	178.9	220.0
영업이익률 (%)	15.4	21.1	19.4	26.6	27.0
순이익 (십억원)	52.5	79.1	78.6	152.5	190.2
EPS (원)	1,813	2,732	2,712	5,265	6,565
PER (배)	11.6	6.0	13.6	34.6	27.8
PBR (배)	1.6	1.0	2.0	7.9	6.3
ROE (%)	14.1	18.3	15.5	25.2	25.2

자료: FnGuide(Quantiwise) 컨센서스, 핀릿 리서치센터

상장일: 20190510



AI PERSONAL FINANCIAL ROBOADVISOR

투자의견 / 적정주가

Not Rated (미제시)

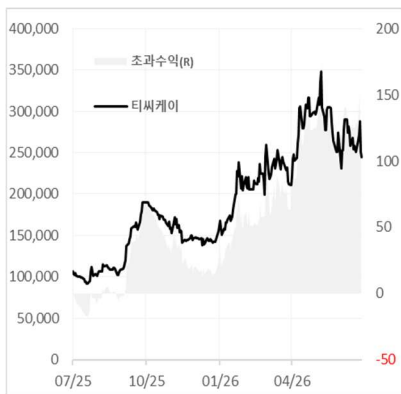
Company Data

현재주가 (7/3 일)	245,000 원
시가총액	2,739.0 십억
자본금	58 십억
발행주식수	11 백만주
유동주식비율	47.4 %

Stock Data

52 주 최고가	348,500 원
52 주 최저가	90,400 원
일평균거래액(60 일)	232 억원
외국인 지분율	67.2 %

주가



064760 (KQ) 반도체

티씨케이

NAND 고단화가 부르는 SiC Ring 슈퍼사이클

- NAND 고단화가 견인하는 SiC Ring 수요 증가
- 압도적인 가동률과 견조한 수주잔고 기반의 증설 모멘텀
- 마진 정상화와 플랫폼화에 따른 수익성 재평가 국면

NAND 고단화가 견인하는 SiC Ring 수요 증가

동사는 식각 공정 핵심 소모품인 SiC Ring 분야에서 비포마켓 기준 약 80%의 독보적인 점유율을 확보한 기업이며, 1Q26 매출의 89.6%가 Solid SiC 부문에서 발생했다. 최근 NAND 공정이 V8 및 V9 으로 급격히 전환되고 적층 수가 고도화될수록 플라즈마 내구성과 파티클 억제력이 뛰어난 포커스 링의 중요성이 커진다. 이는 교체 주기가 지속적으로 반복되는 소모품 구조적 특성을 지녀 일반 장비사 대비 실적의 연속성과 지속성이 현저히 높다. 특히 부품 특성상 전방 고객사 라인의 가동률 상승이 출하량 증가로 즉각 연결되는 선순환 구조를 갖추었다.

압도적인 가동률과 견조한 수주잔고 기반의 증설 모멘텀

1Q26 안성공장 가동률은 95.8%에 달해 사실상 풀캐파에 근접한 수준으로 구동 중이며, 전체 수주잔고 974 억 원 중 Solid SiC 가 819 억 원을 차지해 강력한 대기 수요를 입증하고 있다. 글로벌 하이퍼스케일 NAND 증설 수요와 더불어 중국 및 일본향 신규 Fab 투자가 활발히 전개되는 업황을 고려할 때, 향후 추가적인 생산능력 확장은 선택이 아닌 구조적 성장을 유지하기 위한 필수 조건으로 작용할 전망이다.

마진 정상화와 플랫폼화에 따른 수익성 재평가 국면

2026 년 연간 매출액은 3,900 억~3,980 억 원, 영업이익은 1,200 억~1,300 억 원 규모로 추정된다. 특히 2027 년 글로벌 판매지원 수수료 계약 종료 시 매출총이익률(GPM)이 약 2%p 추가 개선될 여지가 있어 구조적인 이익 레버리지 극대화가 기대된다. 향후 HBM 및 첨단 파운드리 영역으로의 전방 산업 확장성까지 결합된다면, 단순 소모품 공급사를 넘어 고부가 반도체 공정부품 기업으로 재평가될 가능성이 높다.

투자지표	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (십억원)	226.7	275.7	301.3	393.5	479.3
영업이익 (십억원)	66.7	80.8	83.9	125.9	166.1
영업이익률 (%)	29.4	29.3	27.8	32.0	34.7
순이익 (십억원)	61.2	72.0	69.9	110.0	143.0
EPS (원)	5,246	6,167	5,996	9,842	12,794
PER (배)	21.2	11.5	23.7	24.9	19.2
PBR (배)	2.8	1.6	3.1	4.5	3.8
ROE (%)	14.0	14.8	13.5	19.5	21.4

자료: FnGuide(Quantiwise) 컨센서스, 핀릿 리서치센터

상장일: 20030818



AI PERSONAL FINANCIAL ROBOADVISOR

투자의견 / 적정주가
Not Rated (미제시)

140860 (KQ) IT 하드웨어

파크시스템스

선단공정 계측, 수율을 좌우하는 숨은 병목 기술

- 선단공정 계측의 필수 장비화이다
- 신장비 포트폴리오가 성장의 폭을 넓힌다
- 수주잔고와 투자 재원이 하반기 레버리지의 근거이다

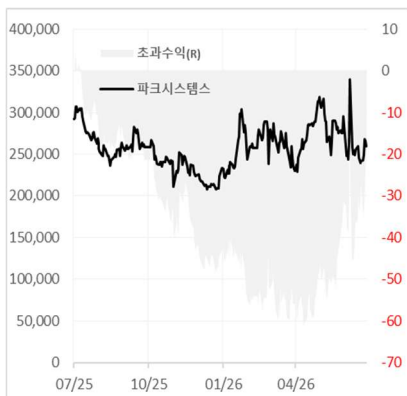
Company Data

현재주가 (7/3 일)	260,000 원
시가총액	1,8206 십억
자본금	35 십억
발행주식수	7 백만주
유동주식비율	665 %

Stock Data

52 주 최고가	350,500 원
52 주 최저가	205,000 원
일평균거래액(60 일)	144 억원
외국인 지분율	36.4 %

주가



선단공정 계측의 필수 장비화

동사는 비접촉 AFM 기술을 기반으로 산업용 원자현미경에서 80%를 웃도는 독점적 지위를 보유한 기업이다. 반도체가 GAA, EUV, HBM, 첨단 패키징으로 갈수록 표면 거칠기와 단차, 결함을 나노 단위로 확인해야 하며, 이는 단순 검사 장비가 아니라 수율을 좌우하는 공정 제어 장비로의 재평가를 의미한다.

신장비 포트폴리오가 성장의 폭을 넓힌다

NX-Wafer와 NX-Mask가 선단공정 수요를 담당하고, NX-Hybrid WLI와 NX-TSH는 광학계측 속도와 AFM 정밀도를 결합해 후공정 칩렛-RDL 계측까지 확장하는 축이다. 전공정과 후공정을 동시에 커버하는 구조는 중장기 성장성을 유지시키는 힘이자 동사의 투자포인트이다.

수주잔고와 투자 재원이 하반기 레버리지의 근거

1Q26 수주잔고는 871 억원, 사업보고서 제출일 기준은 978 억원으로 늘었고 신규 수주 중 산업용 비중은 73%이다. 1,000 억원 BW 조달은 400 억원 생산능력 확대, 400 억원 M&A, 200 억원 운영자금으로 배정되어 성장 재원 확보 성격이 크다. Accurion과 Lyncée Tec 인수로 광학계측 포트폴리오까지 넓어지며 종합 나노계측 플랫폼으로 진화하는 구간이다.

2Q26E, 영업이익 374% 반등 및 수익성 회복의 첫 신호

2Q26 실적은 1 분기 장비 인도 지연 이후 회복이 확인되는 구간이다. 매출액은 525 억원으로 전분기 대비 33.4%, 영업이익은 100 억원으로 374.3% 반등할 전망이다. 영업이익률은 19.0%까지 회복된다. 수주잔고 확대와 산업용 AFM 출하 재개가 하반기 실적 반전의 핵심 근거이며, 상저하고 흐름을 확인하는 분기이다.

투자지표	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (십억원)	144.8	175.1	205.6	242.5	291.6
영업이익 (십억원)	27.6	38.5	42.2	56.3	74.1
영업이익률 (%)	19.0	22.0	20.5	23.2	25.4
순이익 (십억원)	24.6	42.8	34.5	52.4	65.8
EPS (원)	3,530	6,134	4,931	7,481	9,391
PER (배)	49.2	34.5	42.4	34.8	27.7
PBR (배)	8.4	7.8	6.5	6.0	5.2
ROE (%)	18.7	25.8	16.7	19.8	20.1

자료: FnGuide(Quantiwise) 컨센서스, 핀릿 리서치센터

상장일: 20151217



AI PERSONAL FINANCIAL ROBOADVISOR

투자의견 / 적정주가
Not Rated (미제시)

039030 (KQ) 반도체

이오테크닉스

마킹·어닐링·커팅, 세 공정이 동시에 열린다

- AI 칩렛이 여는 마킹 수요 확장
- 어닐링은 미세화의 병목을 푸는 전공정 장비
- HBM 그루빙과 FC-BGA가 후공정 성장축

Company Data

현재주가 (7/3 일)	392,500 원
시가총액	4,835.4 십억
자본금	62 십억
발행주식수	12 백만주
유동주식비율	68.9 %

Stock Data

52 주 최고가	623,000 원
52 주 최저가	179,200 원
일평균거래액(60 일)	787 억원
외국인 지분율	29.1 %

주가



AI 칩렛이 여는 마킹 수요 확장

동사는 반도체 레이저 마커에서 국내 95%, 해외 60% 내외의 점유율을 가진 기업이며, 2025 년 레이저마커 및 응용기기 비중도 74.5%에 달한다. AI 가속기가 칩렛 구조로 전환되면서 방열판과 EMI 쉴드까지 식별 추적 마킹이 필요해졌고, 북미 GPU 생태계 표준 장비 채택은 OSAT 와 조립업체 수요 확산의 출발점이다.

어닐링은 미세화의 병목을 푸는 전공정 장비

DRAM 1 세대 이후 1c nm 전환, EUV 적용 확대, 400 단 이상 NAND 진입은 열 예산을 낮추면서 결함을 복원해야 하는 공정 난도를 높인다. 레이저 어닐링은 필요한 영역만 짧게 가열해 수율을 개선하므로 고객사와 적용처 확대가 밸류에이션 프리 미어의 핵심이다.

HBM 그루빙과 FC-BGA가 후공정 성장축

HBM 고단화와 웨이퍼 박막화는 기계식 절단보다 열 손상이 작은 Ultra Short Pulse 레이저의 필요성을 키운다. FC-BGA 빌드업 기반용 레이저 드릴 수요까지 붙으면 전공정·후공정·기판을 아우르는 레이저 플랫폼으로 재평가될 수 있다. 2026 년 매출 4,948 억원, 영업이익 1,309 억원 전망은 이 변화가 숫자로 전환되는 과정이다.

2Q26E, 레이저 장비 수요가 만든 이익 레버리지 구간

2Q26 전망은 레이저 장비 수요가 이익으로 전환되는 구간이다. 매출액은 1,111 억 원으로 전년 대비 30.9%, 전분기 대비 9.6% 증가하고, 영업이익은 306 억원으로 111.1% 늘어날 전망이다. 영업이익률 27.5%는 마커·어닐링·커팅 장비 믹스 개선 효과를 보여준다. 향후 12개월 영업이익 추정치 전망도 1 주 전 5.3%, 1 달 전 4.6%로 상향되면서 견조해 실적 모멘텀도 여전히 유효하다.

투자지표	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (십억원)	316.3	321.0	380.9	508.0	624.1
영업이익 (십억원)	30.9	31.2	80.8	140.2	178.7
영업이익률 (%)	9.8	9.7	21.2	27.6	28.6
순이익 (십억원)	36.6	42.8	57.2	127.1	160.0
EPS (원)	2,973	3,478	4,644	10,320	12,985
PER (배)	51.4	40.0	58.6	38.0	30.2
PBR (배)	3.3	2.8	4.9	6.1	5.2
ROE (%)	6.7	7.4	8.9	17.1	18.5

자료: FnGuide(Quantiwise) 컨센서스, 핀릿 리서치센터

상장일: 20000824



AI PERSONAL FINANCIAL ROBOADVISOR

042700 (KS) 반도체

한미반도체

HBM 고단화가 만든 TC 본더 장기 성장 공식

투자의견 / 적정주가
Not Rated (미제시)

- HBM 고단화가 만든 TC 본더 독점성
- 후공정 플랫폼 확장이 실적의 질을 높인다
- 생산능력과 고객 확장이 재평가의 근거

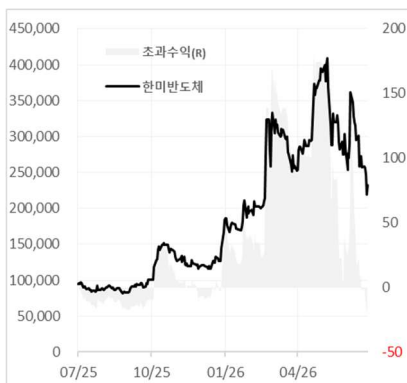
Company Data

현재주가 (7/3 일)	232,500 원
시가총액	22,160.1 십억
자본금	12.7 십억
발행주식수	95 백만주
유동주식비율	43.7 %

Stock Data

52 주 최고가	426,000 원
52 주 최저가	81,400 원
일평균거래액(60 일)	4,109 억원
외국인 지분율	75 %

주가



HBM 고단화가 만든 TC 본더 독점성

동사의 HBM TC 본더는 열과 압력으로 12 단·16 단 HBM 을 정밀 적층하는 핵심 장비이며, 하이브리드 본더 상용화 지연 속에서 TC 본딩의 대체 흐름은 당분간 유지 될 가능성이 높다. Wide TC 본더와 HBM 용 하이브리드 본더 병행 개발은 HBM4 이후 구조 변화까지 선제 대응하는 전략이다.

후공정 플랫폼 확장이 실적의 질을 높인다

6-Side Inspection 은 적층 전후 HBM 수율을 관리하고, MSVP 는 절단·세척·검사·적재를 일괄 처리하는 장비이다. Conversion Kit 매출 비중 34.4%는 장비 설치 이후 반복 매출 기반을 보여주며, EMI Shield 와 BOC COB 본더까지 더해지면 단일 본더 기업이 아니라 후공정 플랫폼 기업으로 해석된다.

생산능력과 고객 확장이 재평가의 근거

수출 비중 89.9%, 약 320 개 고객 기반은 글로벌 후공정 장비사로서의 지위를 보여 주며, 7 공장과 하이브리드 본더 전용 투자는 HBM2.5D 패키징 수요 확대에 대응하는 성장 인프라이다. 2026 년 매출 7,850 억원, 영업이익 3,694 억원 전망은 이러한 변화가 주주와 이익으로 전환되는 과정이다.

2Q26E, 영업이익률 48.5%, HBM 장비주의 수익성 회복

동사의 2Q26 전망은 HBM4 투자 재개와 TC 본더 출하가 맞물리며 V 자 반등을 확인하는 구간이다. 매출액은 2,276 억원으로 전년 대비 54.4%, 전분기 대비 174.2% 증가하고, 영업이익은 1,103 억원으로 58.4% 늘어날 전망이다. 영업이익률 48.5%는 고부가 본더 매출 재개와 MSVP 확대가 만든 수익성 회복의 증거이다. 여전히 실적 모멘텀은 매우 뚜렷하게 성장하고 있다.

투자지표	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (십억원)	159.0	558.9	576.7	785.0	1,098.5
영업이익 (십억원)	34.6	255.4	251.4	369.4	571.9
영업이익률 (%)	21.7	45.7	43.6	47.1	52.1
순이익 (십억원)	267.2	152.6	214.0	337.3	523.8
EPS (원)	2,745	1,573	2,233	3,539	5,496
PER (배)	22.5	52.5	57.1	65.7	42.3
PBR (배)	10.5	14.5	17.5	23.6	15.9
ROE (%)	55.5	27.4	34.8	41.6	45.1

자료: FnGuide(Quantiwise) 컨센서스, 핀릿 리서치센터

상장일: 20050722



AI PERSONAL FINANCIAL ROBOADVISOR

투자의견 / 적정주가
Not Rated (미제시)

067310 (KQ) 반도체

하나마이크론

풀턴키 OSAT, AI 후공정 성장의 본격 수혜 구간

- 풀턴키 OSAT의 구조적 성장
- 해외 법인이 이익 체질을 바꾸고 있다
- 첨단 패키징과 소재가 장기 옵션

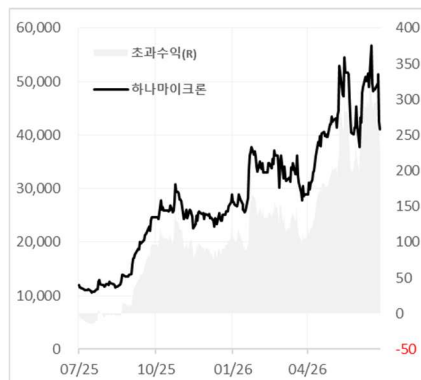
Company Data

현재주가 (7/3 일)	41,050 원
시가총액	2,729.0 십억
자본금	332 십억
발행주식수	66 백만주
유동주식비율	742 %

Stock Data

52 주 최고가	58,500 원
52 주 최저가	10,400 원
일평균거래액(60 일)	1,168 억원
외국인 지분율	204 %

주가



풀턴키 OSAT의 구조적 성장

동사는 패키징, 테스트, 모듈까지 후공정을 한 번에 제공하는 사업구조를 갖고 있으며, 삼성전자·SK 하이닉스 등 IDM과 팹리스 고객을 동시에 보유한 점이 강점이다. 메모리 고부가 제품 확대와 비메모리 테스트 외주 증가는 단순 물량 회복을 넘어 가동률 개선과 제품 믹스 개선으로 연결되는 구조이다. 특히 테스트 가동률 상승과 대면적 패키지 대응력은 수익성 회복의 선행지표이다.

해외 법인이 이익 체질을 바꾸고 있다

베트남 법인은 서버 DRAM과 SSD 물량 확대, 600 억원 규모 CAPEX 이후 매출 Capa 1.2 조원 이상으로 성장 여지가 크다. 브라질 법인은 메모리 판가 상승과 현지 고객 확대가 맞물리며 수익성 레버리지가 커지는 구간이다. 이는 과거 설비 효율성 우려를 낮추는 변화이다.

첨단 패키징과 소재가 장기 옵션

2.5D 패키징, HIC, UCIe 기반 칩렛 연결 기술은 AI 반도체의 후공정 난도를 높이는 핵심 변화이다. 여기에 하나메모리얼즈의 Si-SiC 식각 부품이 더해져 후공정 서비스와 공정부품을 함께 보유한 복합 플랫폼으로 재평가될 수 있는 국면이다. 성장의 폭과 이익의 질이 동시에 개선되고 있다.

2Q26E 이익 추정치 수직 상승과 뚜렷한 저평가 매력

2Q26E 전망은 매출액 582.1 억 원, 영업이익 83.3 억 원으로 전년 대비 175.7% 폭증하며 강력한 턴어라운드를 증명할 전망이다. 서버 D램 수요 호조가 이익 레버리지로 이어져 14.3%의 높은 영업이익률 전망과, 실적 눈높이가 3 달 전 대비 33.0%나 가파르게 상향되는 구간인 만큼 주가의 중기적 재평가 흐름은 유효하다.

투자지표	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (십억원)	968.0	1,250.7	1,534.4	2,247.5	2,586.0
영업이익 (십억원)	57.9	106.8	127.7	315.5	378.6
영업이익률 (%)	6.0	8.5	8.3	14.0	14.6
순이익 (십억원)	-13.5	-23.8	38.1	162.0	178.5
EPS (원)	-239	-382	575	2,437	2,685
PER (배)	N/A(-103.4)	N/A(-24.2)	44.8	16.9	15.3
PBR (배)	4.6	1.7	4.3	4.8	3.6
ROE (%)	-4.7	-7.0	9.9	33.4	26.9

자료: FnGuide(Quantwise) 컨센서스, 핀릿 리서치센터

상장일: 20051011



AI PERSONAL FINANCIAL ROBOADVISOR

투자의견 / 적정주가
Not Rated (미제시)

089030 (KQ) 반도체

테크윙

메모리 핸들러 1위에서 HBM 검사 플랫폼으로

- HBM 검사 장비의 새 시장을 여는 큐브 프로버
- 본업 회복과 부품 매출이 만드는 실적 안정성
- 기술 장벽과 고객 다변화가 밸류에이션을 끌어올린다

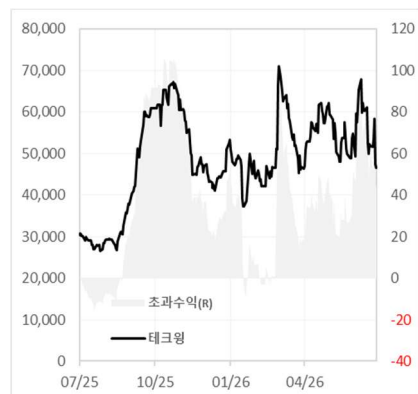
Company Data

현재주가 (7/3 일)	46,600 원
시가총액	1,726.7 십억
자본금	190 십억
발행주식수	37 백만주
유동주식비율	72.3 %

Stock Data

52 주 최고가	74,000 원
52 주 최저가	26,050 원
일평균거래액(60 일)	1,176 억원
외국인 지분율	11.9 %

주가



HBM 검사 장비의 새 시장을 여는 큐브 프로버

동사는 메모리 테스트 핸들러 세계 1 위 기반 위에 HBM Cube Prober 를 더해 패키징 테스트에서 웨이퍼 테스트로 영역을 확장하고 있다. IR 기준 Cube Prober 는 개별 HBM 전수검사 솔루션이며, 경쟁업체가 없는 신규 시장으로 제시된다. HBM 고단화가 진행될수록 불량 검출 정확도와 검사 안정성이 수율을 좌우한다는 점에서 성장의 질이 높다.

본업 회복과 부품 매출이 만드는 실적 안정성

Memory Test Handler 시장점유율은 약 70%이며, C.O.K와 Parts-Board 는 장비 교체와 가동률 상승 때 반복 매출로 붙는 구조이다. 글로벌 메모리 Fab 투자 확대와 고객사 전환투자는 신규 장비뿐 아니라 소모성 부품 수요까지 동시에 키운다.

기술 장벽과 고객 다변화가 밸류에이션을 끌어올린다

동사는 2026 년 1 분기 기준 반도체 장비 수주잔고 471 억원을 보유하고, 등록 특허도 867 건에 이른다. SK 하이닉스, 마이크론, 삼성전자 등 메모리 빅 3 로 고객 저변이 넓어질 경우 단순 핸들러 업체가 아니라 HBM 검사 솔루션 플랫폼으로 재평가될 수 있는 구간이며, 이익 방향도 분명하다.

2Q26E, 2 분기, HBM 핸들러 중심의 고부가 믹스 개선 효과 본격화

테크윙의 2Q26E 전망은 매출액 702 억 원, 영업이익 133 억 원으로 전년 대비 각각 43.6%, 109.1% 급증하며 외형과 수익성의 동반 성장을 증명할 전망이다. 전구체 및 고부가 장비 부문의 견조한 수요가 이익 레버리지로 이어져 영업이익률은 18.9%로 한 단계 격상된다. 실적 추정치 변화율 역시 3 달 전 대비 21.1% 상향되며 눈높이가 가파르게 올라가는 구간인 만큼 향후 주가 흐름이 양호할 전망이다.

투자지표	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (십억원)	133.6	185.5	159.1	371.8	559.7
영업이익 (십억원)	3.2	23.4	15.8	98.5	172.9
영업이익률 (%)	2.4	12.6	10.0	26.5	30.9
순이익 (십억원)	-9.3	-20.9	9.4	71.4	129.8
EPS (원)	-249	-559	252	1,927	3,503
PER (배)	N/A(-45.9)	N/A(-68.8)	181.7	24.2	13.3
PBR (배)	1.9	7.2	7.6	6.0	4.3
ROE (%)	-4.2	-10.3	4.6	29.0	38.8

자료: FnGuide(Quantwise) 컨센서스, 핀릿 리서치센터

상장일: 20111110



AI PERSONAL FINANCIAL ROBOADVISOR

투자의견 / 적정주가
Not Rated (미제시)

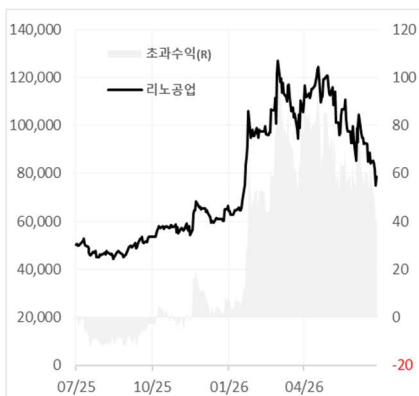
Company Data

현재주가 (7/3 일)	78,600 원
시가총액	5,990.3 십억
자본금	7.6 십억
발행주식수	76 백만주
유동주식비율	74.1 %

Stock Data

52 주 최고가	129,000 원
52 주 최저가	44,000 원
일평균거래액(60 일)	1,330 억원
외국인 지분율	31.2 %

주가



058470 (KQ) 반도체

리노공업

AI 반도체 시대, 테스트 소켓이 숨은 병목이다

- AI 반도체가 만드는 고부가 소켓 사이클
- P와 Q가 동시에 오르는 드문 구조
- 무차입 재무와 증설이 장기 성장의 안전판

AI 반도체가 만드는 고부가 소켓 사이클

동사는 리노핀과 IC Test Socket 을 자체 개발한 테스트 인터페이스 전문기업이며, AI 추론·ASIC·HPC 칩이 늘수록 핀 수와 전력, 주파수, 발열 조건이 까다로워져 고사양 소켓 수요가 커진다. 1Q26 기준 IC Test Socket 매출 비중은 64.1%, 리노핀은 24.7%로 핵심 사업 집중도가 높고, 40 년 이상 축적한 다품종·단납기 생산능력이 진입장벽이다.

P와 Q가 동시에 오르는 드문 구조

1Q26 리노소켓 생산량은 전년 대비 50%, 리노핀은 10% 증가했고 리노핀 가격도 약 11% 오른 것으로 추정된다. 수요가 공급을 웃도는 환경에서는 물량 증가가 단가 하락으로 이어지기보다 제품 믹스 개선과 마진 확대를 만든다. 고객 맞춤형 주문제작 구조도 가격 방어력을 높이는 핵심이다.

무차입 재무와 증설이 장기 성장의 안전판

동사는 차입금 0 원 수준의 무차입 구조와 2026 년 순현금 4,788 억원 전망을 보유했으며, 971 억원 규모 부산 에코델타시티 신공장은 생산능력과 R&D 역량을 동시에 높이는 투자이다. 의료기기 부품도 매출의 10% 안팎을 차지해 변동성을 낮추는 보완책이다.

2Q26E, 영업이익률 49%대 고마진 레버리지가 증명하는 독점적 지위

2Q26A 전망은 매출액 1,307 억 원, 영업이익 643 억 원으로 전년 대비 각각 66.7%, 84.1% 증가할 전망이다. 또한 온디바이스 AI 칩 테스트 핀 수요 폭증에 힘입어 영업이익률도 49.2% 달성할 전망이다. 실적 눈높이가 3 달 전 대비 9.5% 상향되며 이익 지속성이 입증되는 만큼 주가의 우상향 흐름도 유효하다.

투자지표	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (십억원)	255.6	278.2	372.5	450.4	548.3
영업이익 (십억원)	114.4	124.2	177.0	217.8	268.0
영업이익률 (%)	44.8	44.6	47.5	48.3	48.9
순이익 (십억원)	110.9	113.3	152.0	186.7	229.4
EPS (원)	1,455	1,486	1,994	2,450	3,009
PER (배)	27.8	25.8	30.2	32.1	26.1
PBR (배)	5.5	4.7	6.3	7.1	6.1
ROE (%)	21.1	19.2	22.5	23.7	25.1

자료: FnGuide(Quantiwise), 핀릿 리서치센터

상장일: 20011218

[투자의견 (변동) 내역]

종 목 명	투자의견/목표주가	2026. 07. 06			
삼성전자(005930)	매수(신규)	417,000 원			
SK 하이닉스(000660)	매수(신규)	3,270,000 원			
솔브레인(357780)	Not rated	-			
한솔케미칼(014680)	Not rated	-			
HPSP(403870)	Not rated	-			
원익 IPS(240810)	Not rated	-			
주성엔지니어링(036930)	Not rated	-			
피에스케이(319660)	Not rated	-			
티시케이(064760)	Not rated	-			
파크시스템스(140860)	Not rated	-			
이오테크닉스(039030)	Not rated	-			
한미반도체(042700)	Not rated	-			
하나마이크론(067310)	Not rated	-			
테크윙(089030)	Not rated	-			
리노공업(058470)	Not rated	-			

[투자의견 (변동) 내역]

당사는 개별 종목에 대해 향후 1 년간 +15%이상의 절대수익률이 기대되는 종목에 대해 Buy(매수) 의견을 제시합니다. 또한 절대수익률 -15% ~ +15%가 예상되는 종목에 대해 Hold(보유) 의견을, -15% 이하가 예상되는 종목에 대해 Sell(매도) 의견을 제시합니다. 또한 목표주가를 산정하지 않을 시에는 투자의견을 "Not Rated"로 제시합니다. 밸류에이션 방법 등 절대수익률 산정은 개별 종목을 커버하는 애널리스트의 추정치에 따르며, 목표주가 산정이나 투자의견 변경 주기는 종목별로 다릅니다



Analyst 김영진

現 독립리서치 핀릿 대표 & 연구위원

금융투자분석사, 투자자산운용사

헤지펀드 운용전문인력

부동산투자 자산운용사

매경, 한경 등 주요 언론사 Best Analyst 출신

미래에셋자산운용 리서치/자산배분 본부장

하이자산운용 헤지펀드 운용실장

KB 투자증권 리서치센터장 대행

NH 투자증권 / LG 투자증권 / 한화투자증권

리서치센터 연구위원 등 역임

Compliance Notice

- 이 자료는 투자를 유도할 목적이 아니라 개인투자자의 투자 판단에 참고가 되는 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다.
- 이 자료 작성자 김영진은 자료 제공일 현재 이 자료에 언급된 해당 기업의 주식 및 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 작성자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」이 금지하는 선행매매를 하고 있지 않습니다.
- 작성자는 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가능합니다.
- 이 자료에 언급된 종목의 경우, 투자결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 당사는 이 자료를 전문투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 이 자료는 당사 저작물로서 모든 지식재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 이 자료를 당사 임직원 외의 자로부터 입수하였을 경우, 자료 무단 제공 및 이용에 대한 책임은 전적으로 해당 제공자 및 이용자에게 있습니다.

고지사항

이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종 결정을 하시기 바랍니다. 또한 이 자료에 게재된 내용은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 증권투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.